

Latitude 3420

독립 그래픽이 있는 컴퓨터에 대한 서비스 매뉴얼



참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

목차 3

하드 디스크 드라이브 브래킷 설치.....	33
하드 디스크 드라이브 어셈블리 설치.....	34
WLAN 카드.....	35
WLAN 카드 제거.....	35
WLAN 카드 설치.....	36
WWAN 카드.....	38
WWAN 카드 제거.....	38
WWAN 카드 설치.....	39
시스템 팬.....	40
시스템 팬 제거.....	40
시스템 팬 설치.....	41
배터리.....	42
3셀 배터리 제거.....	42
3셀 배터리 설치.....	43
4셀 배터리 제거.....	45
4셀 배터리 설치.....	46
I/O 케이블.....	47
I/O 케이블 제거.....	47
I/O 케이블 설치.....	48
디스플레이 어셈블리.....	48
디스플레이 어셈블리 제거.....	48
디스플레이 어셈블리 설치.....	51
디스플레이 패널.....	53
디스플레이 패널 제거.....	53
디스플레이 패널 설치.....	56
디스플레이 베젤.....	59
디스플레이 베젤 제거.....	59
디스플레이 베젤 설치.....	60
방열판 조립품.....	61
방열판 어셈블리 제거.....	61
방열판 어셈블리 설치.....	61
전원 어댑터 포트.....	62
전원 어댑터 포트 제거.....	62
전원 어댑터 포트 설치.....	63
코인 셀 배터리.....	64
코인 셀 배터리 제거.....	64
코인 셀 배터리 설치.....	65
USB 케이블.....	66
USB 케이블 제거.....	66
USB 케이블 설치.....	67
이더넷 포트.....	68
이더넷 포트 제거.....	68
이더넷 포트 설치.....	69
I/O 보드.....	70
I/O 보드 제거.....	70
I/O 보드 설치.....	71
전원 버튼.....	72
지문 인식기가 없는 전원 버튼 제거.....	72
지문 인식기가 없는 전원 버튼 설치.....	72
지문 인식기가 탑재된 전원 버튼 제거.....	73

지문 인식기가 장착된 전원 버튼 설치.....	74
시스템 보드.....	75
시스템 보드 제거.....	75
시스템 보드 설치.....	78
스피커.....	82
스피커 제거.....	82
스피커 설치.....	83
터치패드.....	84
터치패드 제거.....	84
터치패드 설치.....	85
WWAN I/O 보드.....	86
WWAN I/O 보드 제거.....	86
WWAN I/O 보드 설치.....	86
팜레스트 어셈블리.....	87
팜레스트 어셈블리 제거.....	87
팜레스트 어셈블리 설치.....	88
카메라.....	90
카메라 분리.....	90
카메라 설치.....	90
디스플레이 케이블.....	91
디스플레이 케이블 제거.....	91
디스플레이 케이블 설치.....	92
디스플레이 후면 커버.....	94
디스플레이 후면 커버 제거.....	94
디스플레이 후면 커버 설치.....	94
장 3: 드라이버 및 다운로드.....	96
장 4: BIOS 설정.....	97
BIOS 개요.....	97
BIOS 설정 프로그램 시작하기.....	97
탐색 키.....	97
원타임 부팅 메뉴.....	98
시스템 설치 옵션.....	98
BIOS 업데이트.....	107
Windows에서 BIOS 업데이트.....	107
Linux 및 Ubuntu에서 BIOS 업데이트.....	108
Windows에서 USB 드라이브를 사용하여 BIOS 업데이트.....	108
F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS 업데이트.....	108
시스템 및 설정 암호.....	109
시스템 설정 암호 할당.....	109
기존 시스템 설정 암호 삭제 또는 변경.....	110
CMOS 설정 지우기.....	110
BIOS(시스템 설정) 및 시스템 암호 지우기.....	111
장 5: 문제 해결.....	112
부풀어 오른 리튬 이온 배터리 취급.....	112
Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단.....	112
SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 실행.....	113

BIST(Built-in Self Test).....	113
M-BIST.....	113
LCD 전원 레일 테스트(L-BIST).....	114
LCD BIST(Built-in Self Test).....	114
시스템 - 진단 표시등.....	114
운영 체제 복구.....	116
실시간 클럭(RTC 재설정).....	116
백업 미디어 및 복구 옵션.....	116
Wi-Fi 전원 주기.....	116
잔류 전원 방전(하드 리셋 수행).....	117
장 6: 도움말 보기 및 Dell에 문의하기.....	118

컴퓨터 내부 작업

안전 지침

전제조건

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 문서에 포함된 각 절차에서는 다음과 같은 조건을 전제하고 있음을 유의하십시오.

- 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
- 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성 요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.

이 작업 정보

경고: 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어보십시오. 추가 안전 모범 사례 정보는 [규정 준수 홈페이지](#)를 참조하십시오.

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술 지원 담당자가 수행해야 합니다. 사용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화 서비스 및 지원 팀에서 지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 정전기 방전을 방지하려면 손목 접지대를 사용하거나 주기적으로 컴퓨터 뒷면의 커넥터와 도색되지 않은 금속 표면을 동시에 만져서 접지하십시오.

주의: 구성 요소와 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성 요소나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금속 마운팅 브래킷을 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성 요소를 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.

주의: 케이블을 연결 해제할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 연결 해제하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 연결 해제합니다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 수평으로 잡아 당깁니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 방향이 올바르게 정렬되었는지도 확인합니다.

노트: 컴퓨터 덮개 및 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후에는 전원을 연결하기 전에 덮개, 패널 및 나사를 전부 장착합니다.

주의: 노트북의 리튬 이온 배터리를 다룰 때는 주의하십시오. 부풀어 오른 배터리는 사용하지 않아야 하고 적절하게 교체 및 폐기해야 합니다.

노트: 컴퓨터와 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

단계

1. 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.

2. 컴퓨터를 종료하십시오. **시작 > 전원 > 종료**를 클릭합니다.

노트: 다른 운영 체제를 사용하고 있는 경우 해당 운영 체제의 설명서에서 종료 지침을 참조하십시오.

3. 컴퓨터 및 모든 연결된 디바이스를 전원 콘센트에서 연결 해제하십시오.

4. 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 네트워크 디바이스 및 주변 장치를 컴퓨터에서 연결 해제합니다.

5. 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.

6. 컴퓨터를 콘센트에서 분리한 후 전원 버튼을 5초 정도 길게 눌러 시스템 보드를 접지합니다.

 **주의:** 컴퓨터를 평평하고 부드럽고 깨끗한 곳에 두어 디스플레이에 흠집이 생기는 것을 방지합니다.

7. 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.

서비스 모드 전환

서비스 모드를 사용하면 사용자가 배터리 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제하지 않고 즉시 컴퓨터에서 전력을 차단하고 수리를 진행할 수 있습니다.

서비스 모드 전환:

1. 컴퓨터를 종료하고 AC 어댑터를 연결 해제합니다.
 2. 키보드의 **** 키를 누르고 Dell 로고가 화면에 나타날 때까지 전원 버튼을 3초 동안 누릅니다.
 3. Press any key to continue(Dell 진단 유틸리티 파티션을 부팅 중입니다. 계속하려면 아무 키나 누르십시오).
-  **노트:** 전원 어댑터가 연결 해제되지 않은 경우 AC 어댑터를 제거하라는 프롬프트가 화면에 표시됩니다. AC 어댑터를 제거한 다음 아무 키나 눌러 **서비스 모드** 절차를 계속합니다.
-  **노트:** 제조업체에 의해 컴퓨터의 **소유자 태그**가 미리 설정되지 않은 경우 **서비스 모드** 절차가 다음 단계를 자동으로 건너뛰는니다.
4. 진행 준비 완료 메시지가 화면에 나타나면 아무 키나 눌러서 계속합니다. 컴퓨터가 세 번의 짧은 비프음을 내고 즉시 종료됩니다. 컴퓨터가 종료되면 배터리 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제하지 않고 교체 절차를 수행할 수 있습니다.

서비스 모드 종료

서비스 모드를 사용하면 사용자가 배터리 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제하지 않고 즉시 컴퓨터에서 전력을 차단하고 수리를 진행할 수 있습니다.

서비스 모드 종료:

1. AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 어댑터 포트에 연결합니다.
2. 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켵니다. 컴퓨터가 자동으로 정상 작동 모드로 돌아갑니다.

안전 지침

안전 지침 장에서는 분해 지침을 수행하기 전에 따라야 하는 기본 단계를 자세히 설명합니다.

설치를 진행하거나 분해 또는 재조립 단계를 거치는 고장 수리 절차를 진행하기 전에 다음 안전 지침을 준수하십시오.

- 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끕니다.
- 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 AC 전원에서 분리합니다.
- 모든 네트워크 케이블, 전화기 및 통신선을 시스템에서 분리합니다.
- 내부에서 작업할 때는 ESD 현장 서비스 키트를 사용하여 ESD(Electrostatic Discharge)를 방지해야 합니다.
- 시스템 구성 요소를 분리한 후에는 분리된 구성 요소를 정전기 방지 처리된 매트에 조심스럽게 둡니다.
- 비전도성 고무 밀창이 달린 신발을 신어서 감전 사고를 당할 가능성을 줄입니다.

대기 전력

대기 전력이 있는 Dell 제품은 케이스를 열기 전에 플러그를 뽑아야 합니다. 대기 전력이 있는 시스템은 기본적으로 시스템을 꺼도 전력이 공급됩니다. 내부 전원을 사용하면 시스템을 원격으로 켜고(LAN을 통해 재개) 절전 모드로 둘 수 있습니다. 다른 고급 전원 관리 기능도 있습니다.

플러그를 뽑고 전원 버튼을 15초 동안 누르고 있으면 시스템 보드에서 잔여 전력이 방전됩니다.

결합

결합은 2개 이상의 접지 전도체를 동일한 전위에 연결하는 방법으로, 현장 서비스 정전기 방전(ESD) 키트를 사용하여 수행합니다. 결합 와이어를 연결할 때는 베어 메탈에 와이어를 연결해야 하며, 페인트를 칠한 표면이나 비금속 표면에 와이어를 연결해서는 안 됩니다. 또한 손목 스트랩을 피부에 잘 고정하고 본인과 장비를 결합하기 전에 시계, 팔찌 또는 반지와 같은 모든 장신구를 빼야 합니다.

ESD(Electrostatic Discharge) 보호

ESD는 확장 카드, 프로세서, 메모리 DIMM, 시스템 보드와 같이 민감한 전자 구성 요소를 다룰 때 아주 중요한 부분입니다. 너무 짧은 시간으로 충전할 경우 간헐적인 문제 또는 제품 수명 단축 등 원인 불명으로 회로가 손상될 수 있습니다. 업계에서 전력 요구 사항의 완화와 집적도 향상을 요구함에 따라 ESD 보호에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 출시된 Dell 제품에서 반도체의 밀도가 증가하면서 정전기 손상에 대한 민감도가 이전 Dell 제품보다 더 높아졌습니다. 이러한 이유로, 일부 부품 처리에 승인된 이전 방법이 더 이상 적용되지 않게 되었습니다.

두 가지의 ESD 손상 유형은 치명적 장애와 간헐적 장애입니다.

- **치명적 장애** - 치명적 장애는 ESD 관련 장애에서 약 20%의 비율로 발생합니다. 이 유형의 손상이 발생하면 디바이스의 기능이 즉각적으로 완전히 손실됩니다. 정전기 충격을 받은 메모리 DIMM, 메모리가 누락되었거나 작동하지 않을 경우 경고음 코드와 함께 "POST 실행 안 됨/화면이 표시되지 않음(No POST/No Video)" 증상이 생성되는 오류 등이 치명적인 장애에 해당됩니다.
- **간헐적 장애** - 간헐적 장애는 ESD 관련 장애에서 약 80%의 비율로 발생합니다. 간헐적 장애가 이렇게 높은 비율로 발생하는 것은 이 유형의 손상이 발생해도 대부분 즉시 눈치채지 못하기 때문입니다. DIMM은 정전기로부터 충격을 받지만 그 배선은 단지 약화될 뿐이며 손상으로 인한 증상을 바로 나타내지는 않습니다. 몇 주 또는 몇 달이 지나면 흔적이 서서히 사라질 수 있으며 그러는 동안 메모리 무결성, 간헐적인 메모리 오류 등의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

ESD 손상을 방지하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 올바르게 접지된 유선 ESD 손목 스트랩을 사용합니다. 무선 정전기 방지 스트랩은 정전기 방지 기능이 충분하지 않기 때문에 더 이상 사용할 수 없습니다. 부품을 처리하기 전에 새시를 건드리면 ESD 손상에 대한 민감도가 증가하여 부품에 적절한 ESD 방지를 제공하지 않습니다.
- 정전기에 민감한 구성 요소는 모두 정전기 방지 공간에서 다룹니다. 가능하면 정전기 방지 바닥 패드와 작업 패드를 사용하십시오.
- 정전기에 민감한 구성 요소를 배송 상자에서 꺼낼 때에는 구성 요소를 설치할 준비가 될 때까지 해당 구성 요소를 정전기 방지 포장재에서 제거하지 않습니다. 정전기 방지 패키징을 풀기 전에 몸에 있는 정전기를 모두 제거해야 합니다.
- 정전기에 민감한 구성요소를 운반하는 경우 정전기 방지 상자나 포장재로 포장하십시오.

ESD 현장 서비스 키트

모니터링되지 않는 현장 서비스 키트가 가장 일반적으로 사용되는 서비스 키트입니다. 각 현장 서비스 키트에는 세 가지 기본 구성 요소인 정전기 방지 매트, 손목 접지대, 본딩 와이어가 포함되어 있습니다.

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.

- **정전기 방지 매트** - 정전기 방지 매트는 소산성이며 서비스 절차 중에 부품을 올려 놓을 수 있습니다. 정전기 방지 매트를 사용할 때 손목 접지대의 착용감이 좋아야 하며, 본딩 와이어가 작동 중인 시스템의 매트와 베어 메탈에 연결되어야 합니다. 적절히 배치하면 서비스 부품을 ESD 용기에서 분리하여 매트 위에 직접 놓을 수 있습니다. ESD에 민감한 구성 요소는 손 안, ESD 매트 위, 시스템 내부 또는 용기 안에서 안전합니다.
- **손목 접지대 및 본딩 와이어** - 손목 접지대 및 본딩 와이어는 ESD 매트가 필요하지 않을 경우에 하드웨어에서 손목 접지대와 베어 메탈 간에 직접 연결되거나 매트 위에 일시적으로 놓인 하드웨어를 보호하기 위해 정전기 방지 매트와 연결될 수 있습니다. 피부, ESD 매트 및 하드웨어 간에 손목 접지대와 본딩 와이어의 물리적인 연결을 본딩이라고 합니다. 손목 접지대, 매트, 본딩 와이어가 제공되는 현장 서비스 키트만 사용하십시오. 무선 손목 접지대는 사용하지 마십시오. 손목 접지대의 내부 전선은 일반적인 마모로 인해 손상되기 쉬우며 우발적인 ESD 하드웨어 손상을 방지하기 위해 손목 접지대 테스터를 사용하여 정기적으로 점검해야 합니다. 손목 접지대와 본딩 와이어는 최소 일주일에 한 번 점검하는 것이 좋습니다.
- **ESD 손목 접지대 테스터** - ESD 스트랩 내부의 전선은 시간이 경과하면 손상되기 쉽습니다. 모니터링되지 않는 키트를 사용하는 경우 각 서비스 쿨을 이용하기 전에 최소 일주일에 한 번 스트랩을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 손목 접지대 테스터는 이러한 테스트를 수행하는 가장 효과적인 방법입니다. 손목 접지대 테스터가 없는 경우 지역 사무소에 재고가 있는지 문의하십시오. 테스트를 수행하려면, 손목 접지대의 본딩 와이어를 테스터에 연결하고 단추를 눌러 테스트를 시작합니다. 녹색 LED가 켜질 경우 테스트가 성공한 것이고, 빨간색 LED가 켜지거나 경고 소리가 나면 테스트에 실패한 것입니다.
- **절연체 요소** - 플라스틱 방열판 케이지 등과 같은 ESD에 민감한 장치는 정전기가 매우 잘 발생하는 절연체인 내부 부품과 멀리 분리해 놓아야 합니다.

- **작업 환경** – ESD 현장 서비스 키트를 배포하기 전에 고객의 입장에서 상황을 평가합니다. 예를 들어 서버 환경용 키트를 배포하는 것은 데스크탑 또는 노트북 환경용 키트를 배포하는 것과 다릅니다. 서버는 일반적으로 데이터 센터 내 랙에, 데스크탑 또는 노트북은 사무실 책상이나 사무 공간 내에 설치됩니다. 복구하려는 시스템 유형을 수용할 수 있는 추가 공간과 함께 ESD 키트를 배포하기에 충분한 작업 영역을 항상 찾아야 합니다. 이러한 작업 영역은 장애물이 없으며 평평하고 개방형 공간이어야 합니다. 또한 ESD를 일으키는 절연체도 없어야 합니다. 작업 영역에서 모든 하드웨어 구성 요소를 실제로 다루기 전에 스티로폼이나 그 외 플라스틱과 같은 절연체와 민감한 부품의 거리를 최소 30cm(12인치) 이상 유지해야 합니다.
- **ESD 포장** – 모든 ESD에 민감한 장치는 정전기 방지 포장으로 배송 및 제공되어야 합니다. 금속 정전기 방지 가방을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 부품이 파손된 경우 항상 새 부품을 받은 것과 동일한 ESD 백 및 포장을 사용하여 해당 부품을 반품해야 합니다. ESD 백을 접은 후 테이프로 밀봉하고 들어 있던 것과 같은 포장 발포제와 함께 새 부품을 받은 원래 상자 안에 넣어야 합니다. ESD에 민감한 장치의 포장은 ESD 방지 작업대에서만 풀어야 하며, 부품을 절대 ESD 백 위에 놓아서는 안 됩니다. 백 안쪽에만 정전기 차폐 처리가 되어 있기 때문입니다. 부품은 항상 손에 잡고 있거나, ESD 매트 위에 놓거나, 시스템 또는 정전기 방지 가방 안에 넣으십시오.
- **민감한 구성 요소 운반** – ESD 민감한 구성 요소(예: 교체 부품 또는 Dell에 반환되는 부품)를 운반할 때는 안전한 운반을 위해 해당 부품을 정전기 방지 가방 안에 넣어야 합니다.

ESD 보호 요약

모든 현장 서비스 기사는 Dell 제품을 수리할 때 항상 기존의 유선 ESD 손목 접지선 및 정전기 방지 매트를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 기사는 서비스를 수행하는 동안 민감한 부품을 모든 절연체와 분리시켜 두어야 하며, 민감한 구성 요소를 운반할 때는 정전기 방지 가방을 사용해야 합니다.

민감한 구성 요소 운반

교체용 부품이나 Dell에 반품할 부품과 같이 ESD에 민감한 구성 요소를 운반할 때는 정전기 방지용 백에 넣어 운반하는 것이 안전합니다.

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

이 작업 정보

 **노트:** 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.

단계

1. 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.
2. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 디바이스, 주변 디바이스 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 장착합니다.
4. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 디바이스를 연결합니다.
5. 컴퓨터를 켭니다.

구성 요소 제거 및 설치

 **노트:** 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

권장 툴

이 문서의 절차를 수행하기 위해 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

- Phillips #0 스크루 드라이버
- 플라스틱 스크라이브

나사 목록

다음 표에는 나사 목록과 이미지가 나와 있습니다.

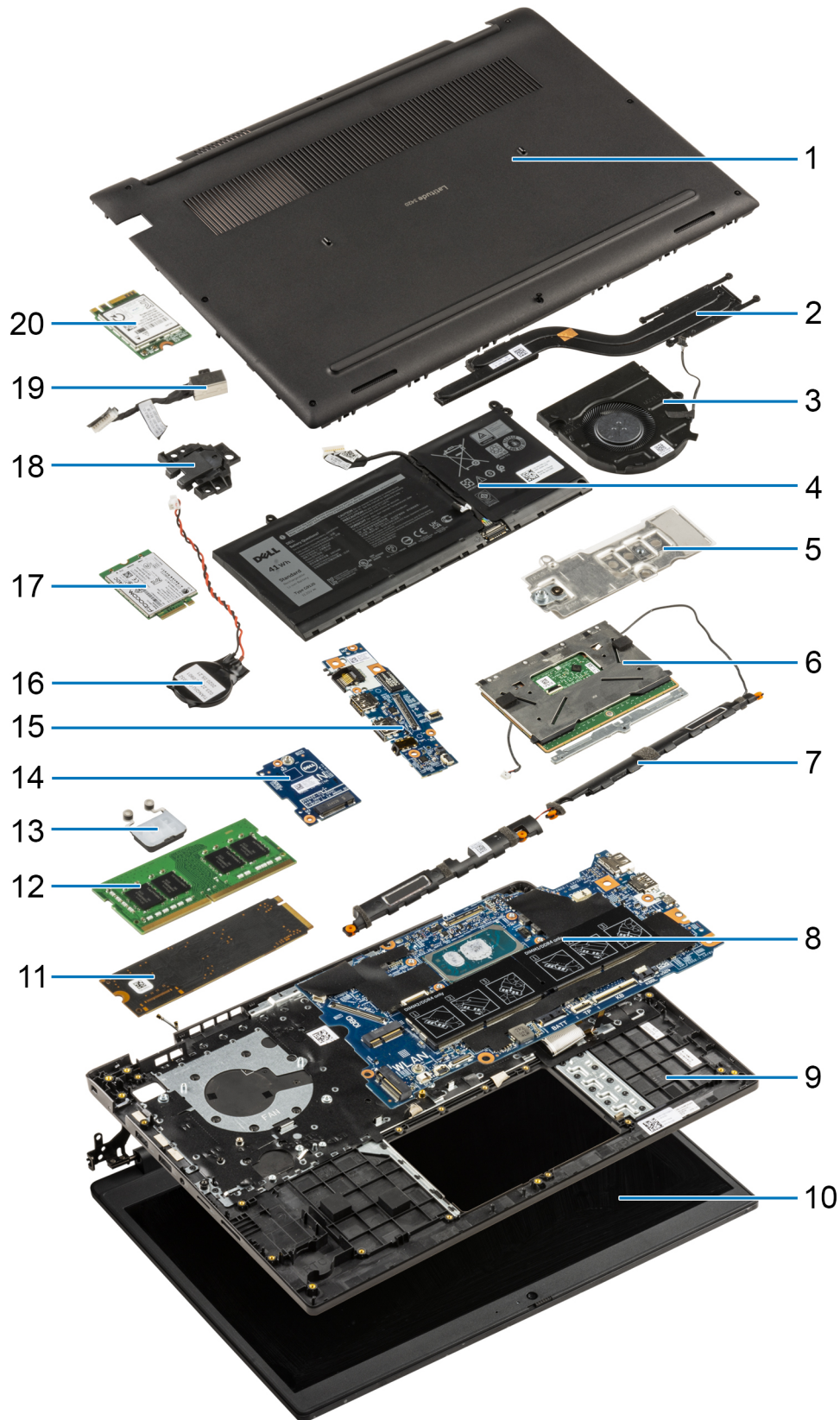
표 1. 나사 목록

구성 요소	나사 유형	수량	이미지
베이스 커버	조임 나사	8	
M.2 솔리드 스테이트 드라이브 브래킷	M2x3	1	
M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷	M2x3	1	
M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판	M2x3	2	
하드 디스크 드라이브 모듈	M2X4.5	3	
하드 디스크 드라이브	M3x3	4	
WLAN 카드	M2x3	1	
WWAN 카드	M2x3	1	
시스템 팬	M2x3	2	
3셀 배터리	M2x3	3	
4셀 배터리	M2x3	4	

표 1. 나사 목록 (계속)

구성 요소	나사 유형	수량	이미지
디스플레이 힌지	M2.5x6 M2.5x4	3 2	
힌지 브래킷	M2.5x2.5 M2.5x3	6 2	
방열판 어셈블리	조임 나사	7(독립 그래픽 카드 지원 시스템) 4(내장 그래픽 카드 지원 시스템)	
전원 어댑터 포트	M2x3	1	
이더넷 포트	M2x5	1	
I/O 보드	M2x3	2	
시스템 보드	M2x2	2	
터치패드 브래킷	M2x2.5	3	
터치패드 모듈	M2x2	4	
WWAN I/O 보드	M2x3	2	

주요 시스템 구성 요소



1. 베이스 커버

2. 방열판 어셈블리
3. 시스템 팬
4. 배터리
5. 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷
6. 터치패드
7. 스피커
8. 시스템 보드
9. 컴퓨터 샷시/팜레스트 어셈블리
10. 디스플레이 어셈블리
11. 솔리드 스테이트 드라이브
12. 메모리 모듈
13. 전원 버튼 보드
14. WWAN I/O 보드
15. I/O 보드
16. 코인 셀 배터리
17. WWAN 카드
18. 이더넷 포트
19. 전원 어댑터 포트
20. WLAN

노트: Dell은 구매한 원래 시스템 구성의 구성 요소 및 부품 번호 목록을 제공합니다. 이러한 부품은 고객이 구매한 보증 기간에 따라 사용할 수 있습니다. 구매 옵션은 Dell 영업 담당자에게 문의하십시오.

MicroSD 카드

microSD 카드 제거

전제조건

1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 microSD 카드 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. microSD 카드를 밀어 슬롯에서 꺼냅니다.
2. microSD 카드를 시스템에서 제거합니다.

MicroSD 카드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 microSD 카드 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 microSD 카드를 해당 슬롯에 삽입합니다.

다음 단계

1. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

SIM 카드 트레이

SIM 카드 트레이 제거

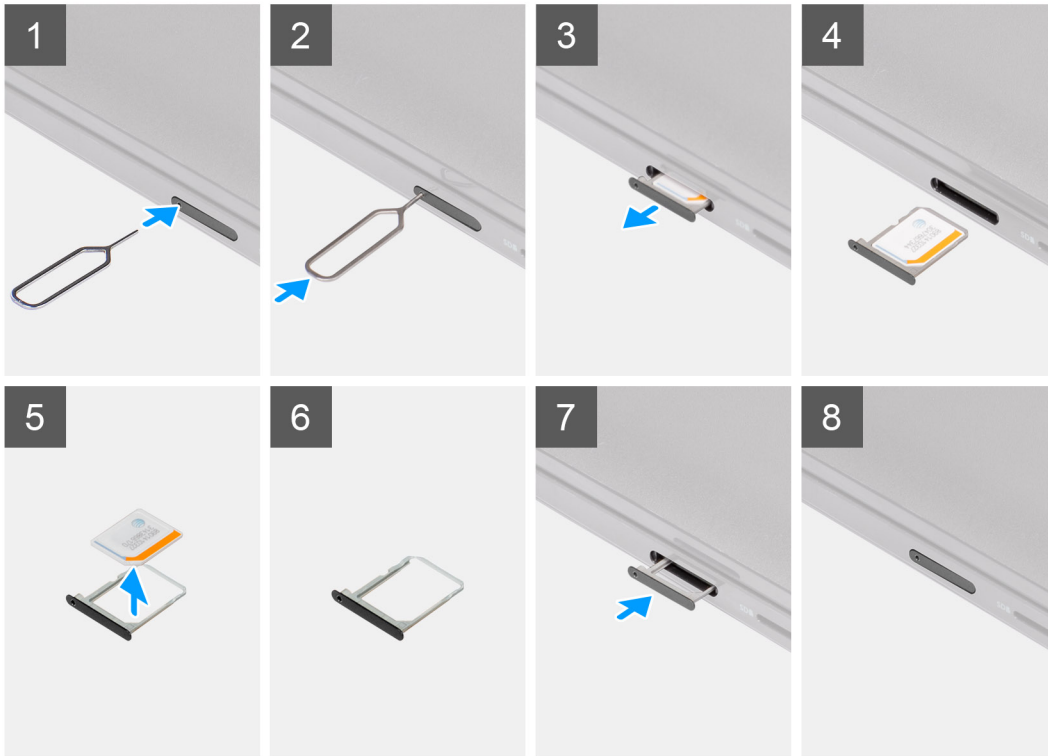
전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 **전에**의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.

이 작업 정보

이 노트: 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.

다음 이미지는 SIM 카드 트레이 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. SIM 카드 제거 핀을 분리 구멍에 삽입하여 SIM 카드 트레이를 분리합니다.
2. 핀을 밀어 잠금 장치를 분리하고 SIM 카드 트레이를 꺼냅니다.
3. SIM 카드 트레이를 밀어 컴퓨터의 슬롯에서 꺼냅니다.
4. MicroSIM 카드를 SIM 트레이에서 제거합니다.
5. SIM 카드 트레이를 컴퓨터의 슬롯에 다시 밀어 넣습니다.

SIM 카드 트레이 설치

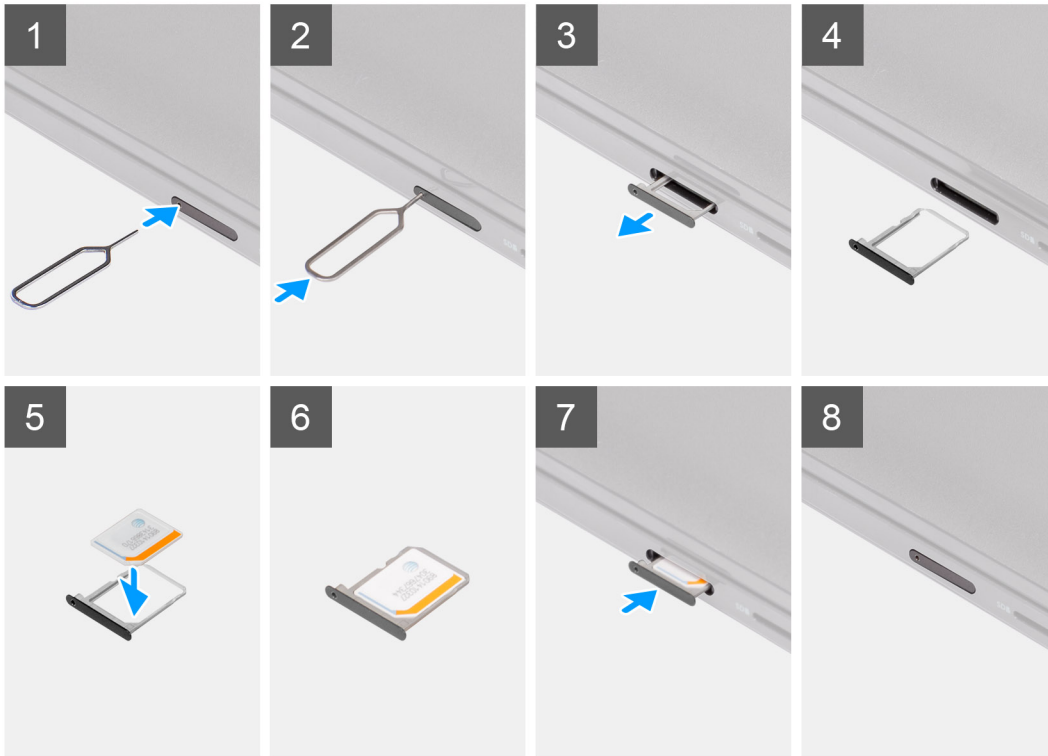
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차 전에 필수 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

이 노트: 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.

다음 이미지는 SIM 카드 트레이 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. SIM 카드 제거 핀을 분리 구멍에 삽입하여 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
2. 핀을 밀어 잠금 장치를 분리하고 SIM 카드 트레이를 꺼냅니다.
3. SIM 카드 트레이를 밀어 컴퓨터의 슬롯에서 꺼냅니다.
4. MicroSIM 카드를 SIM 카드 트레이의 전용 슬롯에 맞추어 넣습니다.
5. SIM 카드 트레이를 컴퓨터의 슬롯에 다시 밀어 넣습니다.

다음 단계

1. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
2. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

베이스 덮개

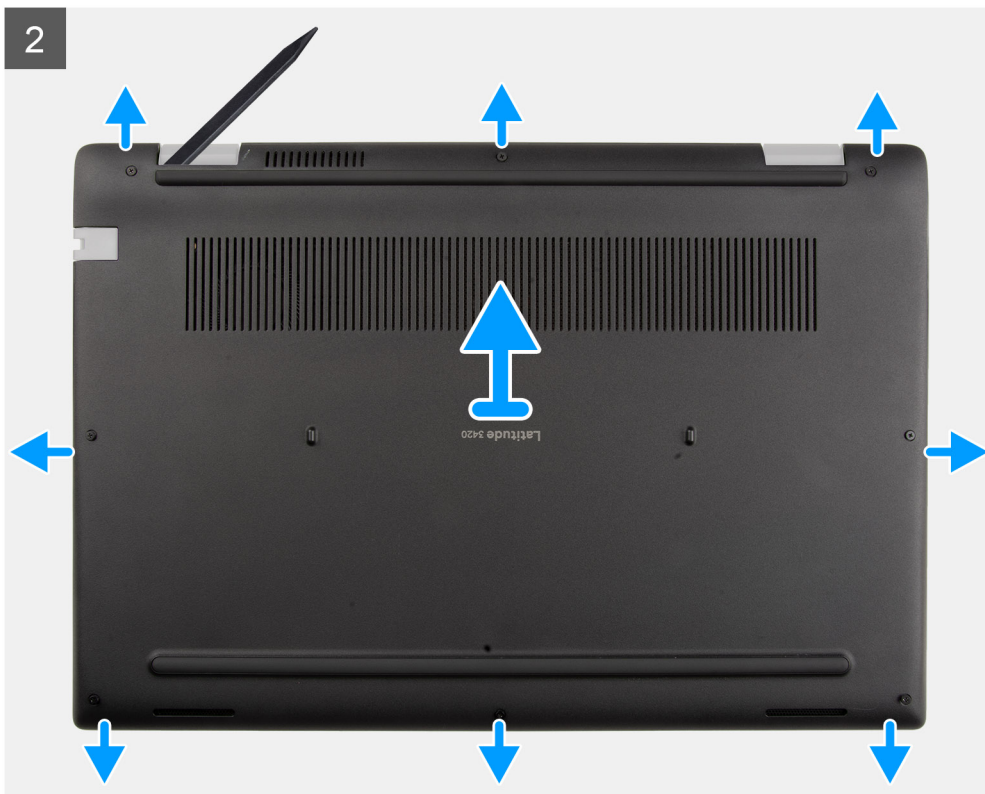
베이스 커버 제거

전제조건

1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 베이스 커버의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 베이스 커버를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 8개의 캡티브 나사를 풉니다.
2. 플라스틱 스크라이브를 사용하여 베이스 커버를 베이스 커버 상단 가장자리의 힌지 근처에 있는 U자형 움푹한 부분에 위치한 리세스부터 들어 올려 엽니다.
3. 베이스 커버를 조심스럽게 들어 올려 새시에서 제거합니다.

이 노트: 래치가 손상될 수도 있으니 베이스 커버를 제거할 때 래치에 유의하십시오.

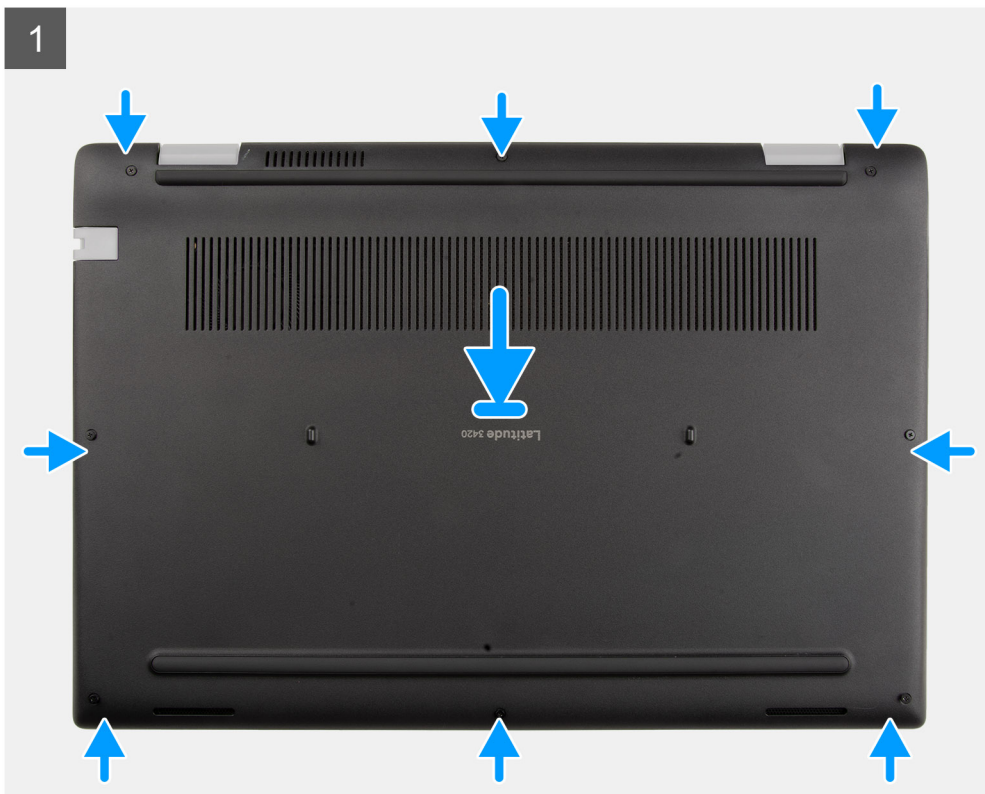
베이스 커버 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.





2



단계

1. 베이스 커버를 팜레스트 어셈블리에 맞추어 놓고 베이스 커버 래치를 제자리에 끼워 넣습니다.
2. 8개의 캡티브 나사를 조여 베이스 커버를 컴퓨터 새시에 고정합니다.

다음 단계

1. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
3. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
4. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

배터리 케이블

리튬 이온 배터리 예방 조치

△ 주의:

- 리튬 이온 배터리를 다룰 때는 주의하십시오.
- 배터리를 제거하기 전에 완전히 방전시키십시오. 시스템에서 AC 전원 어댑터의 연결을 해제하고 배터리 전원만으로 컴퓨터를 작동시킵니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 컴퓨터가 더 이상 켜지지 않으면 배터리가 완전히 방전된 것입니다.
- 배터리를 찌그러뜨리거나 떨어뜨리거나 훼손하거나 외부 개체로 배터리에 구멍을 뚫지 마십시오.
- 고온에 배터리를 노출하거나 배터리 팩과 셀을 분해하지 마십시오.
- 배터리 표면에 압력을 가하지 마십시오.
- 배터리를 구부리지 마십시오.

- 툴을 사용해 배터리를 꺼내려 하거나 배터리에 힘을 가하지 마십시오.
- 우발적인 평처 또는 배터리 및 기타 시스템 구성 요소에 대한 손상을 방지하기 위해 이 제품을 수리하는 동안 나사가 손실되지 않도록 하십시오.
- 배터리가 부풀어 컴퓨터에서 분리되지 않을 경우, 위험할 수 있으니 리튬 이온 배터리에 구멍을 뚫거나 배터리를 구부리거나 찌그러뜨려 분리하려고 하지 마십시오. 이러한 경우 Dell 기술 지원에 문의하여 지원을 받으십시오. www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.
- 항상 www.dell.com 또는 공인 Dell 파트너 및 리셀러로부터 정품 배터리를 구입하십시오.
- 부풀어 오른 배터리는 사용하지 않아야 하고 적절하게 교체 및 폐기해야 합니다. 부풀어 오른 리튬 이온 배터리를 취급하고 교체하는 방법에 대한 지침은 [부풀어 오른 리튬 이온 배터리 취급](#) 섹션을 참조하십시오.

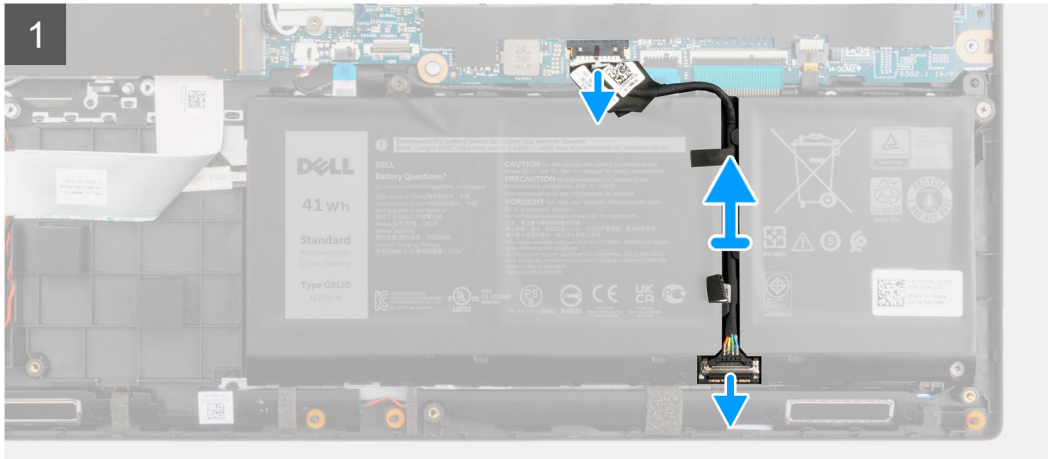
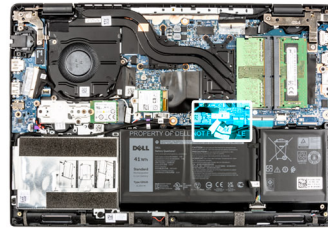
배터리 케이블 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리 케이블의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 시스템 보드의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.
2. 잠금을 해제하려면 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣습니다.
3. 접착 테이프를 떼어내고 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널에서 라우팅 해제합니다.
4. 배터리의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.

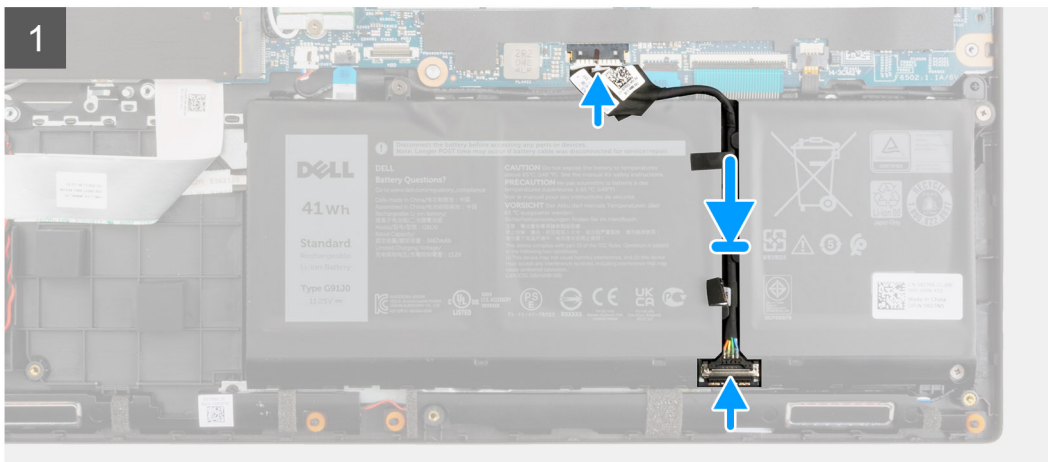
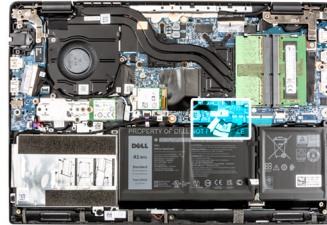
배터리 케이블 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리 케이블의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 배터리 케이블을 배터리의 커넥터에 연결합니다.
2. 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣어 잠급니다.
3. 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널을 통해 라우팅하고 접착 테이프를 부착합니다.
4. 배터리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
3. **microSD 카드**를 설치합니다.
4. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

메모리 모듈

메모리 모듈 제거

전제조건

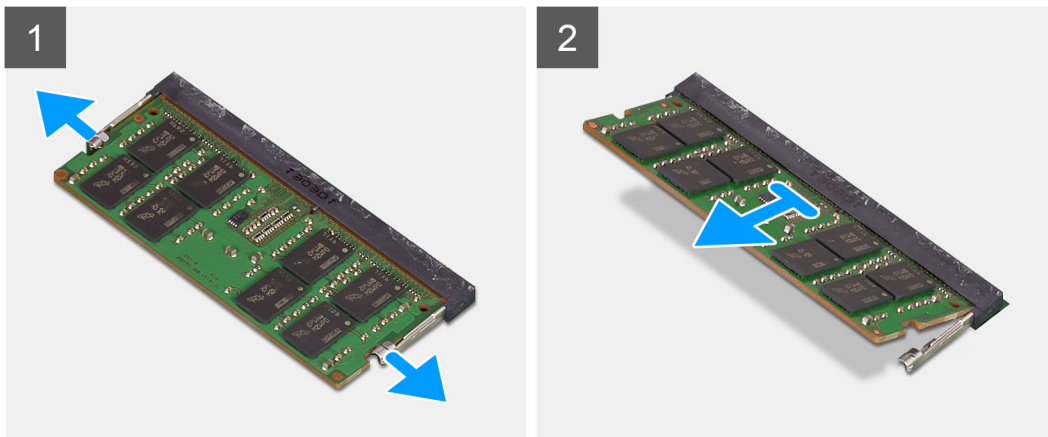
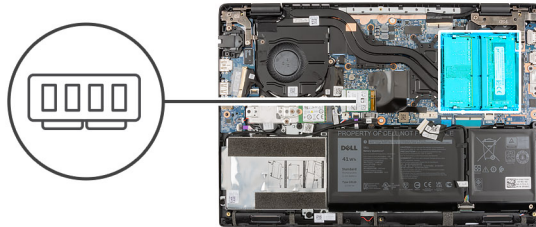
1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.

4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 메모리 모듈의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.

 **노트:** 메모리 모듈의 위치는 시스템에 따라 다를 수 있습니다.



단계

1. 마일라를 들어 올려 메모리 모듈을 엽니다.
2. 메모리 모듈이 튀어나올 때까지 메모리 모듈 슬롯을 고정하는 고정 클립을 들어 올립니다.
3. 메모리 모듈 슬롯에서 메모리 모듈을 제거합니다.

메모리 모듈 설치

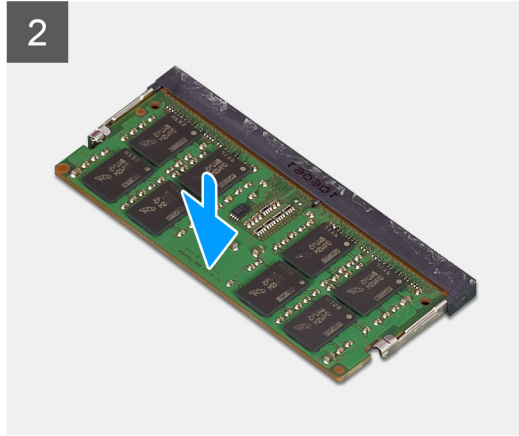
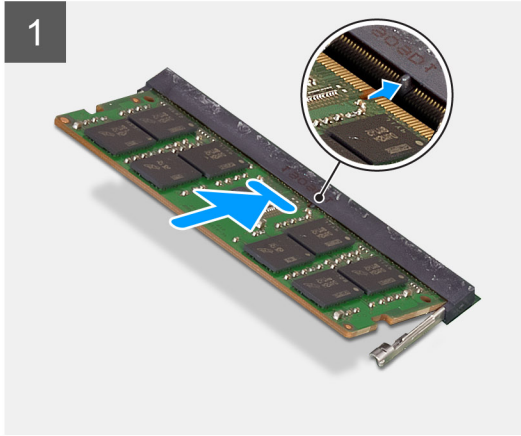
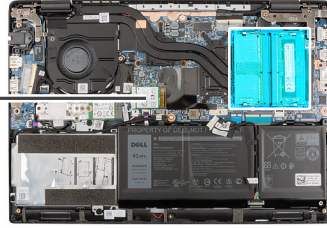
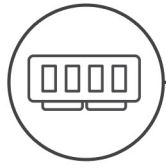
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 메모리 모듈의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.

 **노트:** 메모리 모듈의 위치는 시스템에 따라 다를 수 있습니다.



단계

1. 마일라를 들어 올려 메모리 모듈 슬롯을 찾습니다.
2. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.
3. 메모리 모듈을 일정한 각도로 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다.
4. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

이 노트: 소리가 나지 않으면 메모리 모듈을 제거했다가 다시 설치합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 서비스 모드를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
4. microSD 카드를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

M.2 솔리드 스테이트 드라이브

M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

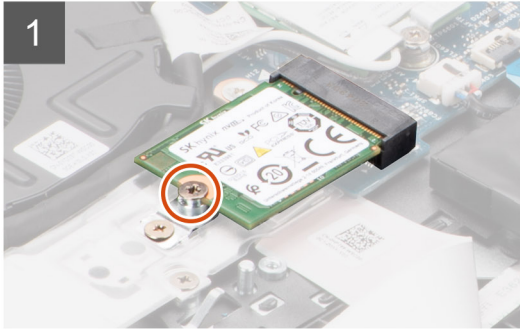
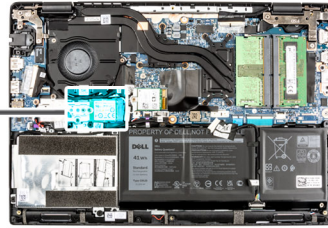
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드의 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯에서 밀어 제거합니다.

M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

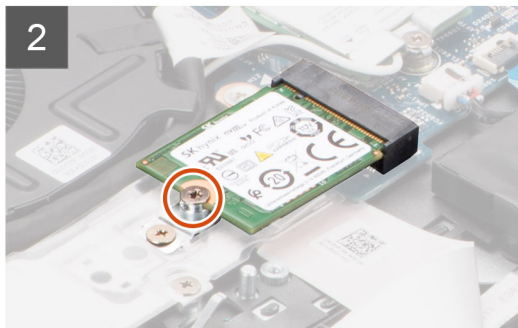
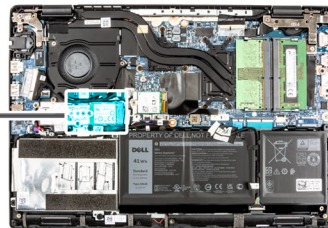
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드의 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯으로 밀어 넣습니다.

3. M2x3 나사를 장착하여 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정합니다.

다음 단계

1. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
2. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
4. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
5. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

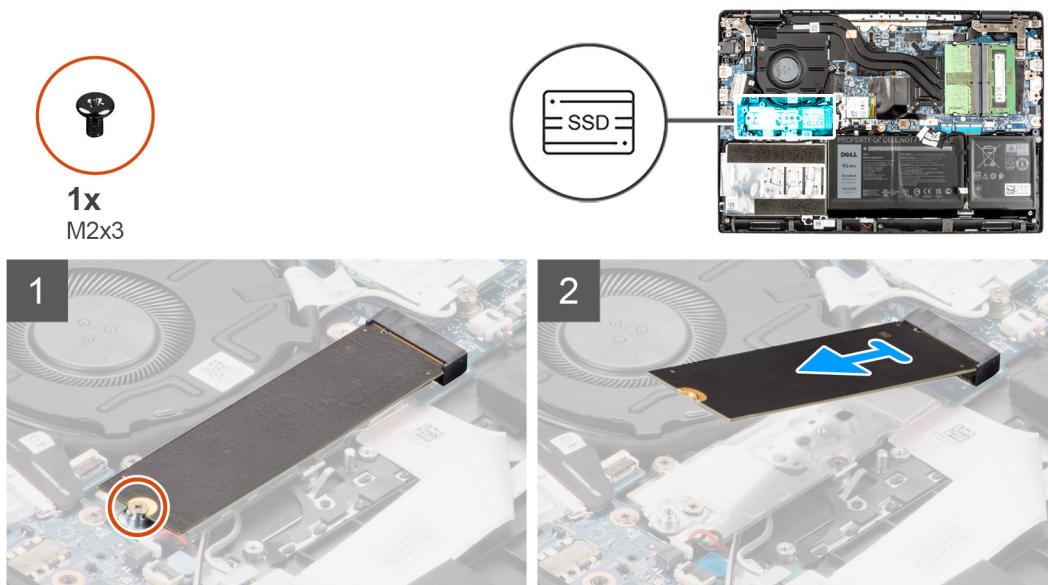
M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.
5. [베이스 커버](#)를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드의 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯에서 밀어 제거합니다.

M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

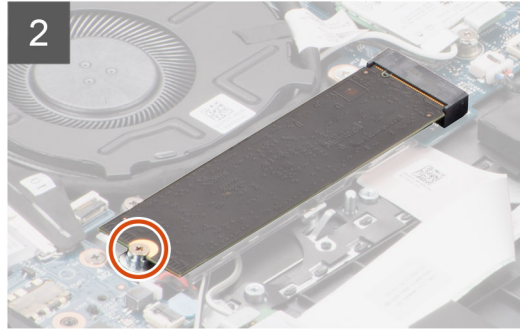
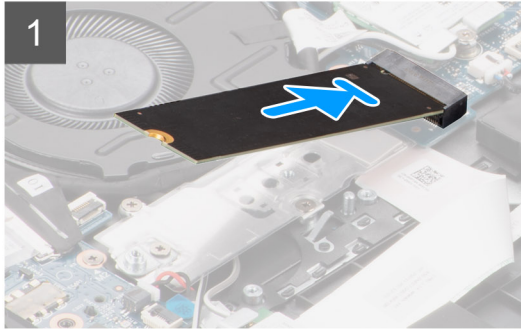
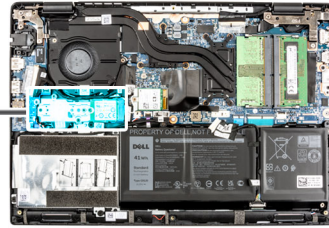
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드의 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯으로 밀어 넣습니다.
3. M2x3 나사를 장착하여 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정합니다.

다음 단계

1. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
2. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
4. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
5. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷

M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷 교체

전제조건

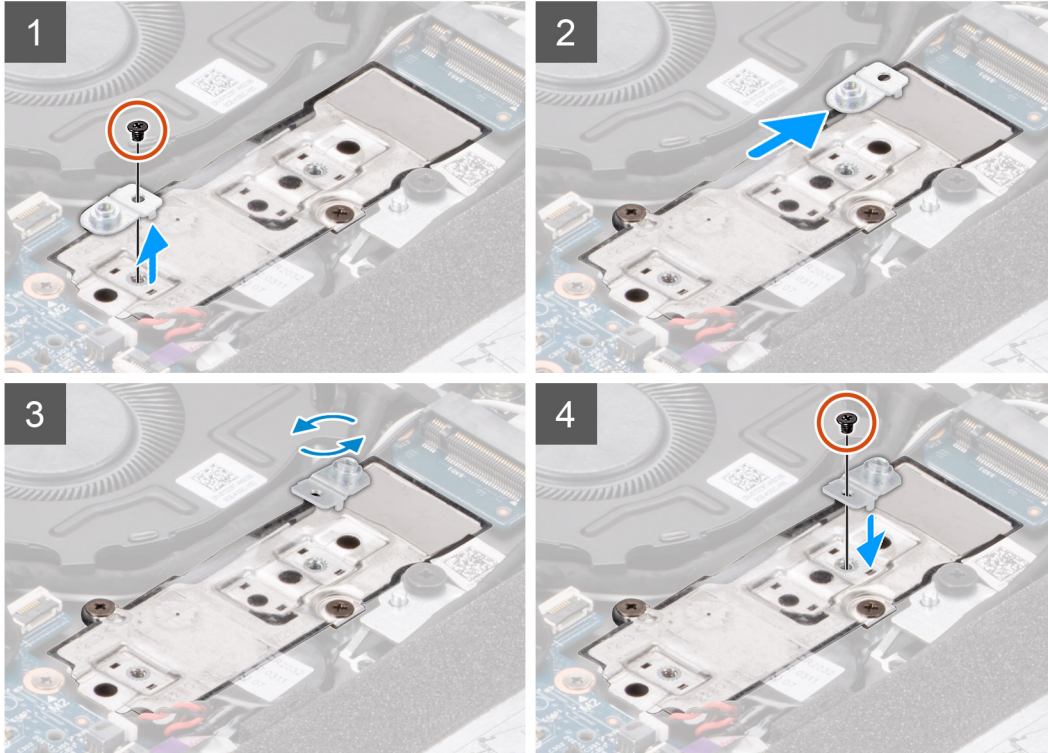
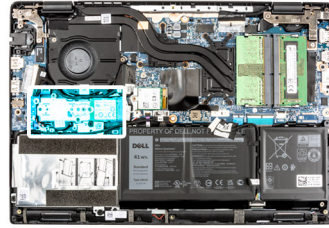
1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.
5. [베이스 커버](#)를 제거합니다.
6. [M.2 SSD](#)를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷의 위치와 길이가 다른 솔리드 스테이트 드라이브를 장착하는 데 사용할 수 있는 방법을 나타냅니다.



1x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷을 솔리드 스테이트 드라이브 변환판에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브 유형(M.2 2230/M.2 2280)에 따라 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷을 돌려서 맞추어 슬롯에 넣습니다.
3. 솔리드 스테이트 드라이브 변환 브래킷을 솔리드 스테이트 드라이브 변환판에 고정하는 M2x3 나사를 설치합니다.

M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판

M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판 제거

전제조건

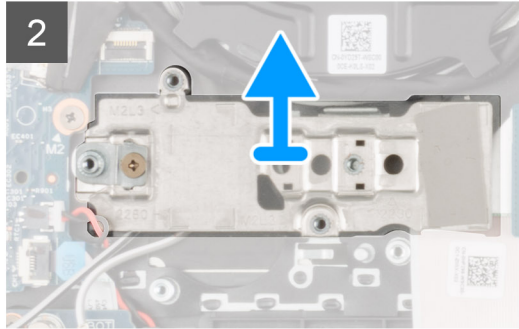
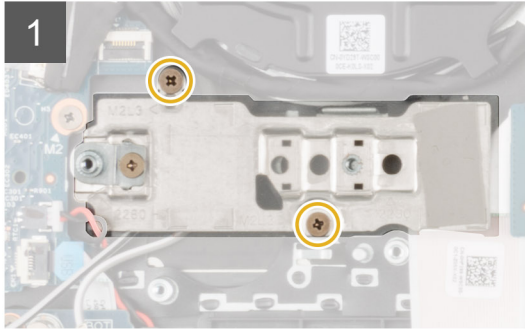
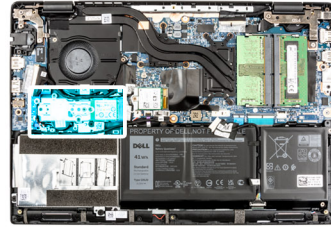
1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.
4. **서비스 모드**로 전환합니다.
5. **베이스 커버**를 제거합니다.
6. **M.2 SSD**를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



2x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 변환판을 시스템 보드에 고정하는 2개의 M2x3 나사를 제거합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브 변환판을 들어 올려 시스템 보드의 솔리드 스테이트 드라이브 슬롯에서 제거합니다.

M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판 설치

전제조건

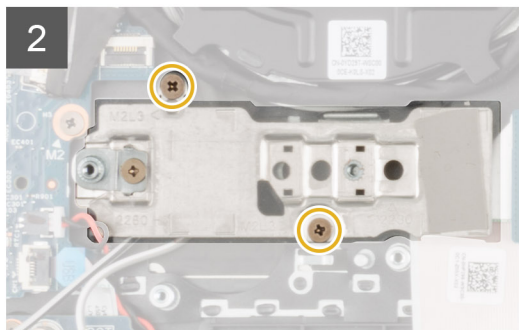
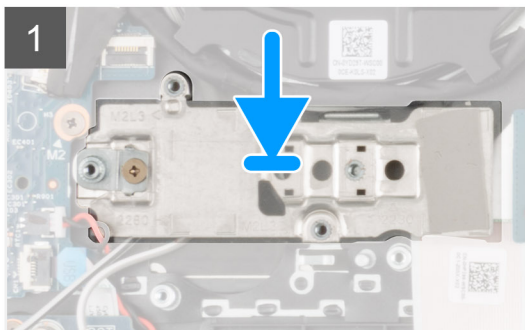
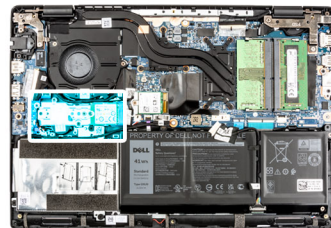
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 M.2 솔리드 스테이트 드라이브 변환판의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



2x
M2x3



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 변환판을 시스템 보드에 맞추어 놓습니다.
2. 2개의 M2x3 나사를 설치하여 솔리드 스테이트 드라이브 변환판을 시스템 보드에 고정합니다.

다음 단계

1. M.2 SSD를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 서비스 모드를 종료합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
5. microSD 카드를 설치합니다.
6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

하드 디스크 드라이브 어셈블리

하드 디스크 드라이브 어셈블리 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.

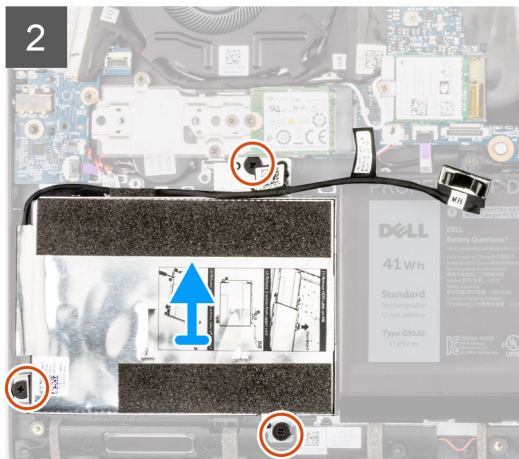
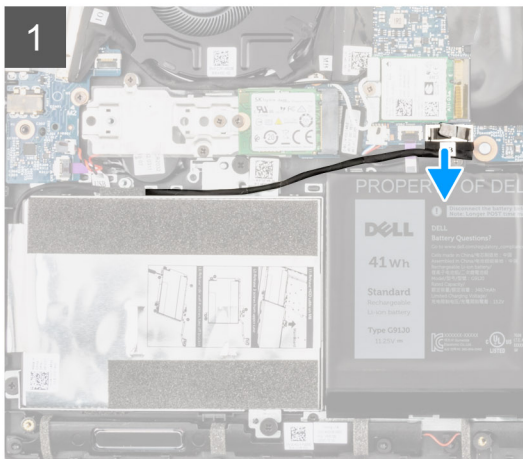
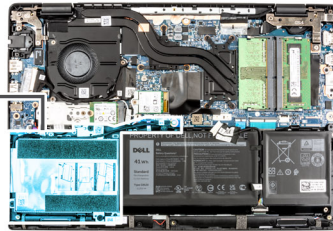
이 작업 정보

다음 이미지는 하드 디스크 드라이브 어셈블리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

 **노트:** 다음 단계는 3셀 배터리와 함께 제공되는 시스템에만 적용됩니다.



3x
M2x4.5



단계

1. 하드 디스크 드라이브 케이블을 들어 올려 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 하드 디스크 드라이브 어셈블리를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 3개의 (M2X4.5) 나사를 풀니다.
3. 하드 디스크 드라이브 어셈블리를 들어 올려 팜레스트 어셈블리의 슬롯에서 제거합니다.

하드 디스크 드라이브 브래킷 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. 하드 디스크 드라이브를 제거합니다.

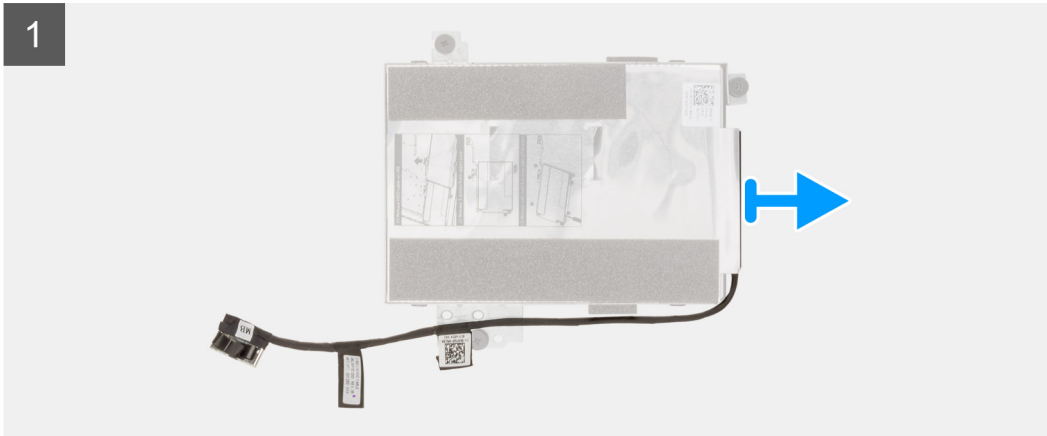
이 작업 정보

다음 이미지는 하드 디스크 드라이브 브래킷의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



4x
M3x3

1



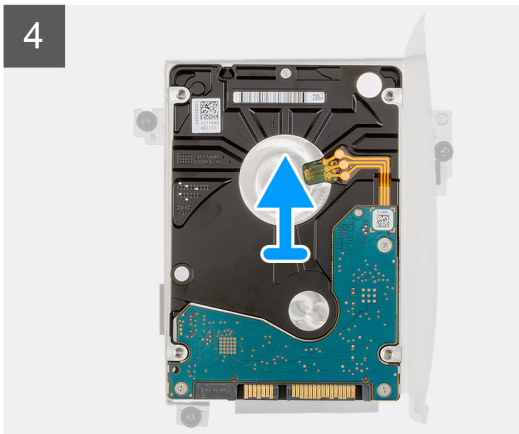
2



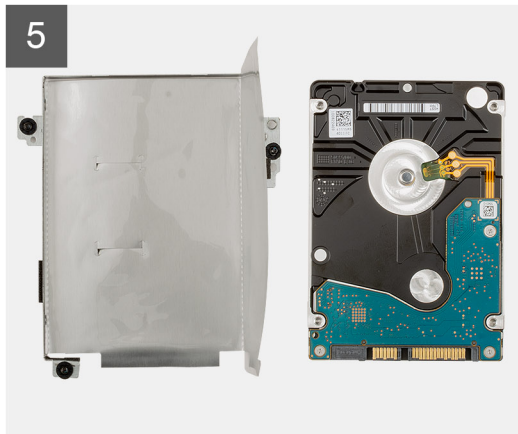
3



4



5



단계

1. 하드 디스크 드라이브 케이블을 하드 디스크 드라이브 브래킷의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 하드 디스크 드라이브를 하드 디스크 드라이브 브래킷에 고정하는 4개의 M3x3 나사를 제거합니다.
3. 하드 디스크 드라이브 브래킷을 뒤집고, 은박지를 들어 올린 다음 하드 디스크 드라이브를 하드 디스크 드라이브 브래킷에서 제거합니다.

하드 디스크 드라이브 브래킷 설치

전제조건

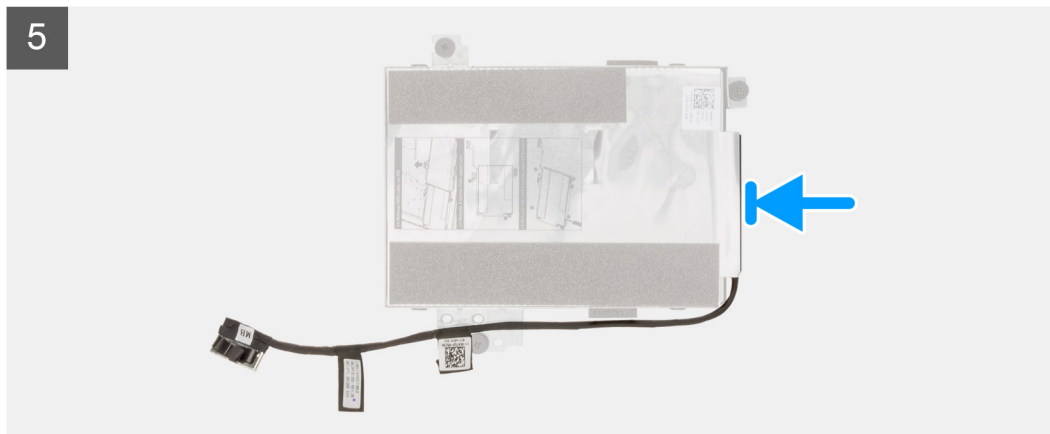
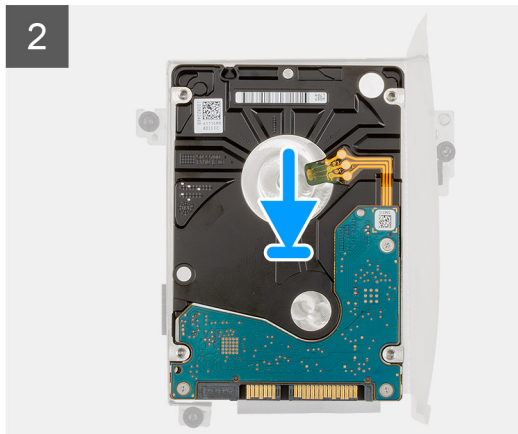
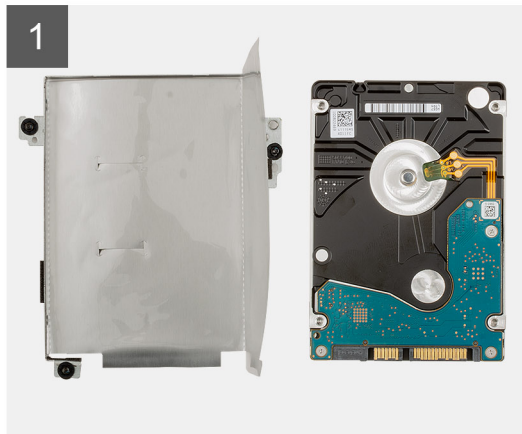
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 하드 디스크 드라이브 브래킷의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



4x
M3x3



단계

1. 은박지를 들어 올리고 하드 디스크 드라이브를 하드 디스크 드라이브 브래킷에 맞추어 넣습니다.
2. 4개의 M3x3 나사를 설치하여 하드 디스크 드라이브를 하드 디스크 드라이브 브래킷에 고정합니다.
3. 하드 디스크 드라이브 케이블을 하드 디스크 드라이브 브래킷의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. [하드 디스크 드라이브](#)를 설치합니다.
2. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
3. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
5. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
6. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

하드 디스크 드라이브 어셈블리 설치

전제조건

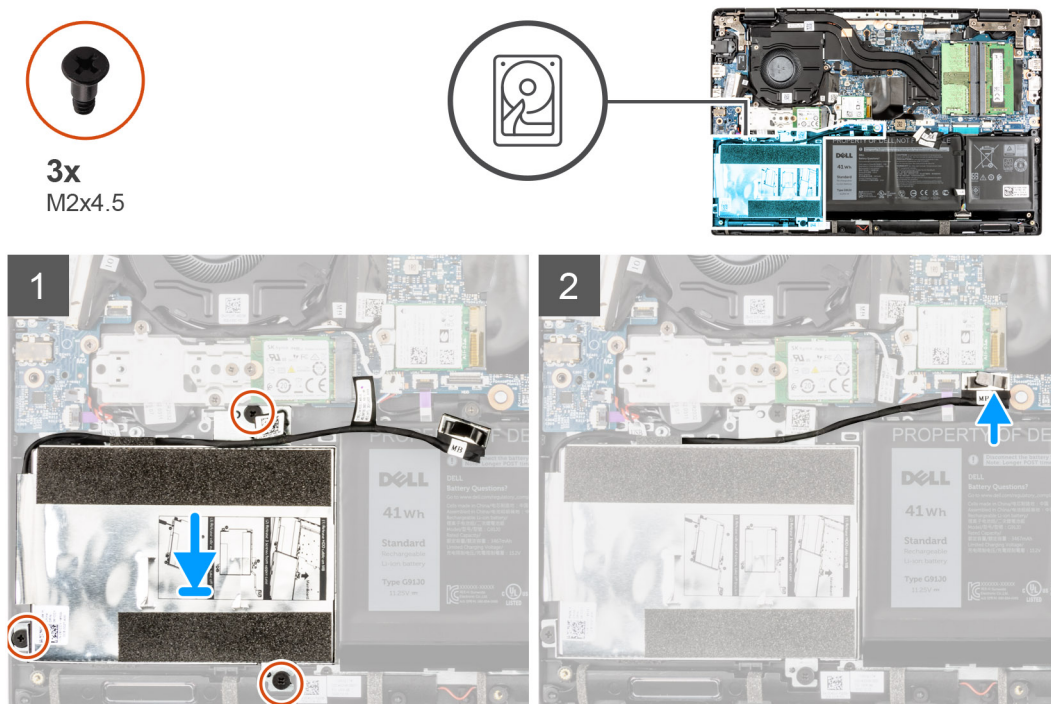
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 하드 디스크 드라이브 어셈블리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

이 노트: 다음 단계는 3셀 배터리와 함께 제공되는 시스템에만 적용됩니다.

이 노트: 3셀 배터리와 함께 제공되는 시스템에는 하드 디스크 드라이브 어셈블리를 설치하기 전에 수동으로 제거해야 하는 고무 범퍼가 포함되어 있습니다.



단계

1. 하드 디스크 드라이브 어셈블리를 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 3개의 M2X4.5 나사를 조여 하드 디스크 드라이브 어셈블리를 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.
3. 하드 디스크 드라이브 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
2. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
4. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
5. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

WLAN 카드

WLAN 카드 제거

전제조건

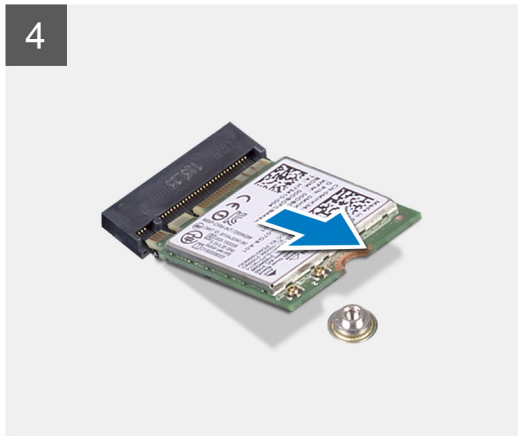
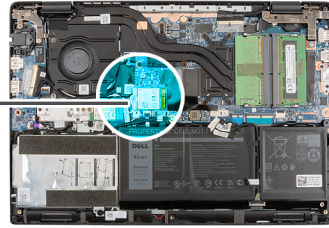
1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.
5. [베이스 커버](#)를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 WLAN 카드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x
M2x3



단계

1. WLAN 카드 브래킷을 시스템 보드의 WLAN 카드에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
2. 2개의 안테나 케이블을 고정하는 WLAN 카드 브래킷을 들어 올려 WLAN 카드에서 제거합니다.
3. 안테나 케이블을 WLAN 카드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. WLAN 카드를 WLAN 카드 슬롯에서 연결 해제하여 제거합니다.

WLAN 카드 설치

전제조건

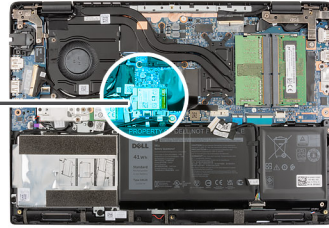
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 WLAN 카드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



1x
M2x3



단계

1. 2개의 안테나 케이블을 WLAN 카드의 커넥터에 연결합니다.

이 노트: 안테나 케이블 커넥터는 부러지기 쉬우므로 교체 시 매우 주의해야 합니다.

표 2. 안테나 케이블 가이드

케이블 색상	커넥터
흰색 케이블(기본)	시스템 보드의 WLAN 모듈에 있는 흰색 삼각형(△)
검은색 케이블(보조)	시스템 보드의 WLAN 모듈에 있는 단색 삼각형(▲)

2. WLAN 카드의 노치를 WLAN 카드 슬롯의 탭에 맞춥니다.
3. WLAN 카드를 WLAN 카드 슬롯에 비스듬하게 밀어 넣습니다.
4. WLAN 카드 브래킷을 WLAN 카드에 맞추어 놓습니다.
5. M2x3 나사를 설치하여 WLAN 카드의 WLAN 카드 브래킷을 시스템 보드에 고정합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 서비스 모드를 종료합니다.

3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
4. **microSD 카드**를 설치합니다.
5. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

WWAN 카드

WWAN 카드 제거

전제조건

1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.
4. **서비스 모드**로 전환합니다.
5. **베이스 커버**를 제거합니다.

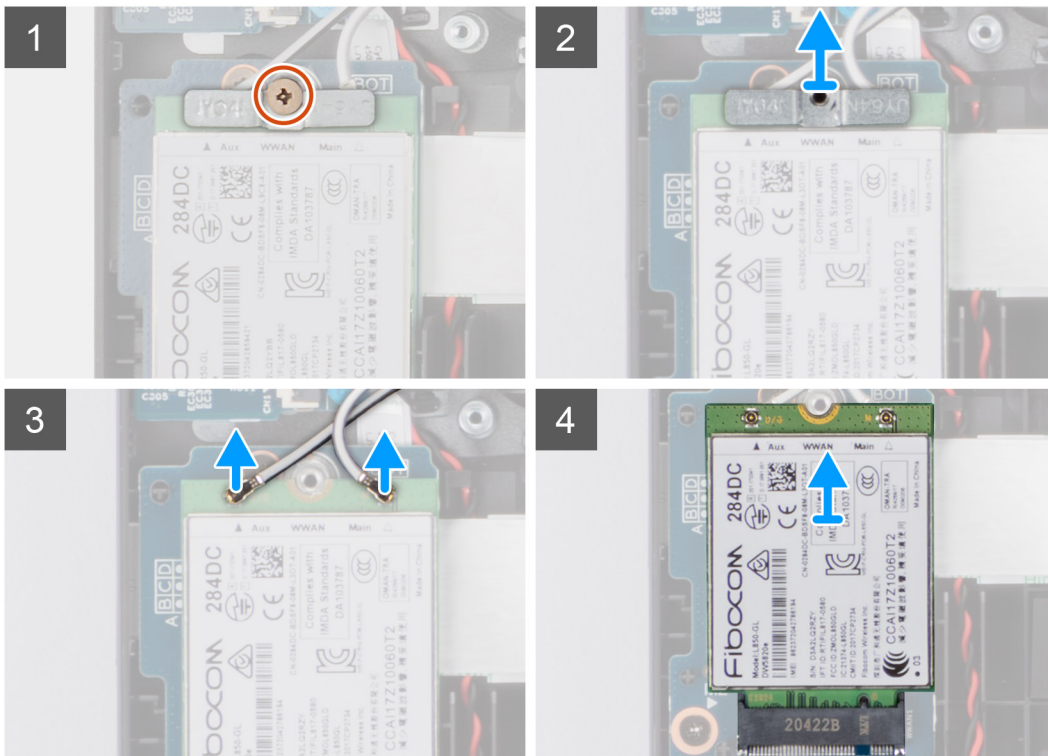
이 작업 정보

다음 이미지는 WWAN 카드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

이 노트: 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.



1x
M2x3



단계

1. WWAN 카드를 덮는 마일라 시트를 엽니다.
2. WWAN 카드 브래킷을 시스템 보드의 WWAN 카드에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
3. 2개의 안테나 케이블을 고정하는 WWAN 카드 브래킷을 들어 올려 WWAN 카드에서 제거합니다.
4. 안테나 케이블을 WWAN 카드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
5. WWAN 카드를 WWAN 카드 슬롯에서 연결 해제하여 제거합니다.

WWAN 카드 설치

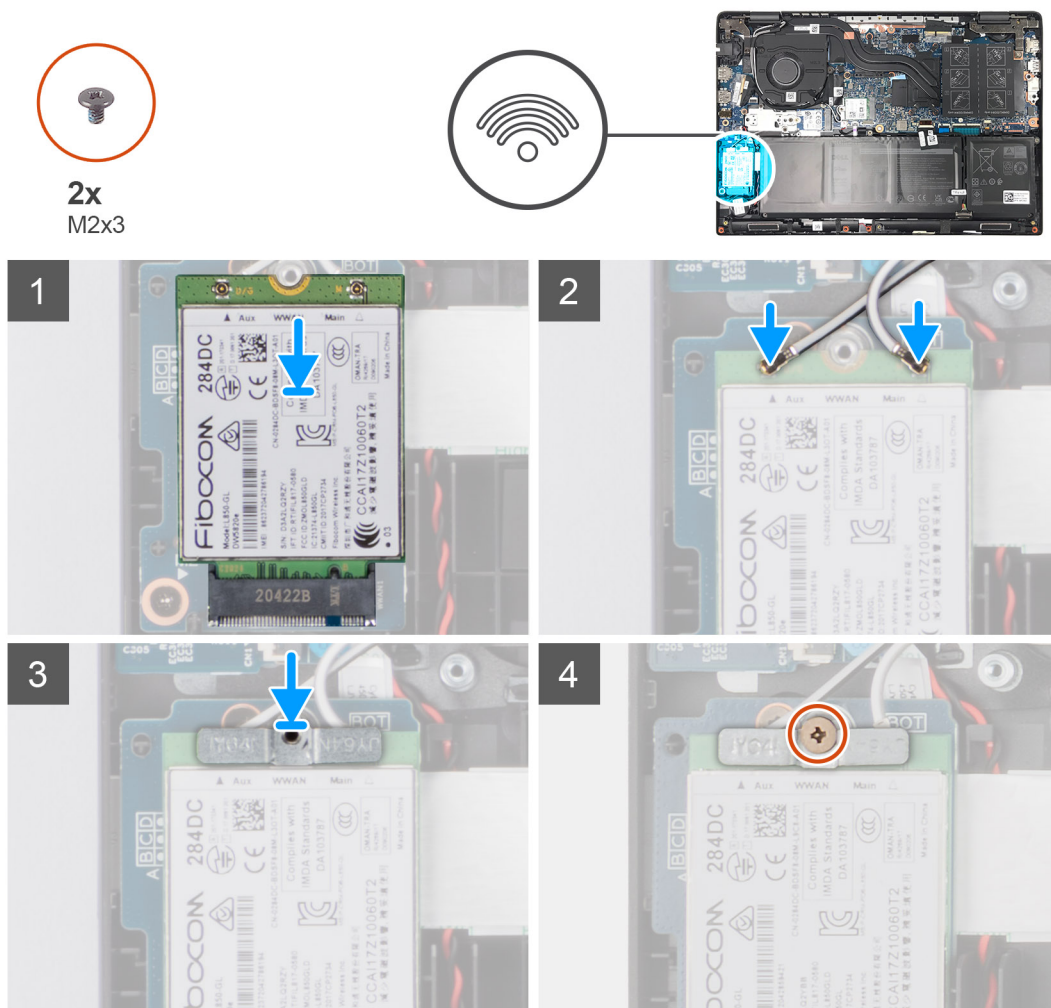
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 WWAN 카드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

 **노트:** 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.



단계

1. 2개의 안테나 케이블을 WWAN 카드의 커넥터에 연결합니다.

 **노트:** 안테나 케이블 커넥터는 부러지기 쉬우므로 교체 시 매우 주의해야 합니다.

표 3. 안테나 케이블 가이드

케이블 색상	커넥터
흰색 케이블(기본)	시스템 보드의 WWAN 모듈에 있는 흰색 삼각형(△)
검은색 케이블(보조)	시스템 보드의 WWAN 모듈에 있는 단색 삼각형(▲)

2. WWAN 카드의 노치를 WWAN 카드 슬롯의 탭에 맞춥니다.
3. WWAN 카드를 WWAN 카드 슬롯에 비스듬하게 밀어 넣습니다.
4. WWAN 카드에 WWAN 카드 브래킷을 맞추어 놓습니다.
5. M2x3 나사를 설치하여 WWAN 카드의 WWAN 카드 브래킷을 시스템 보드에 고정합니다.
6. 마일라 시트를 닫아 WWAN 카드를 덮습니다.

다음 단계

1. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
2. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
4. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
5. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

시스템 팬

시스템 팬 제거

전제조건

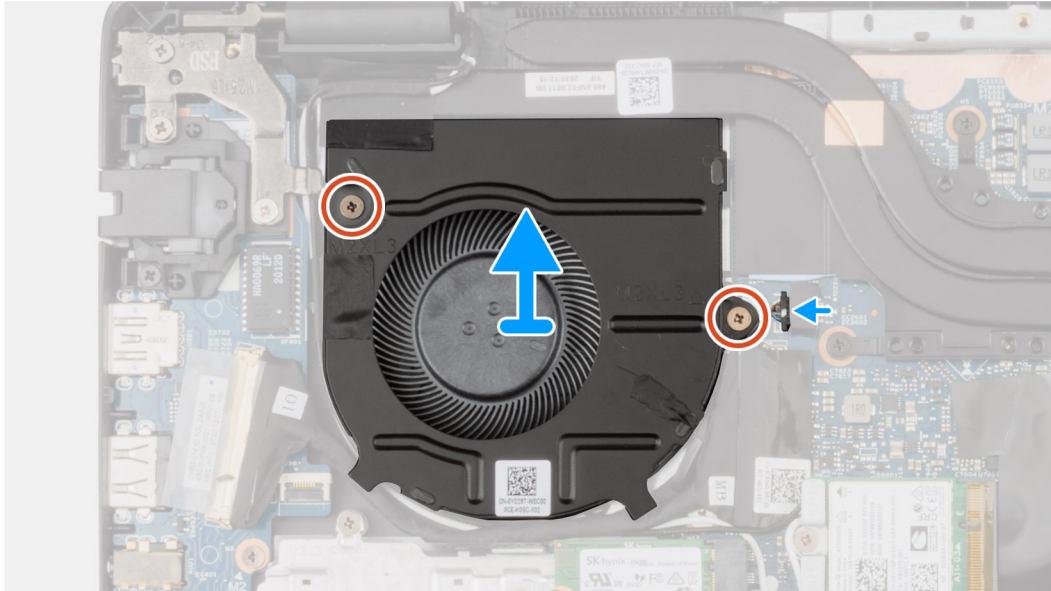
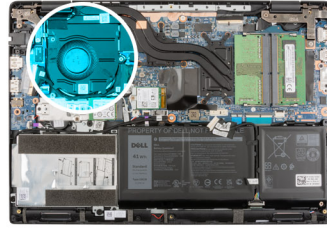
1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.
5. [베이스 커버](#)를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 팬의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



2x
M2x3



단계

1. 시스템 팬 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 시스템 팬을 팜레스트 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x3 나사를 제거합니다.
3. 시스템 팬을 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

시스템 팬 설치

전제조건

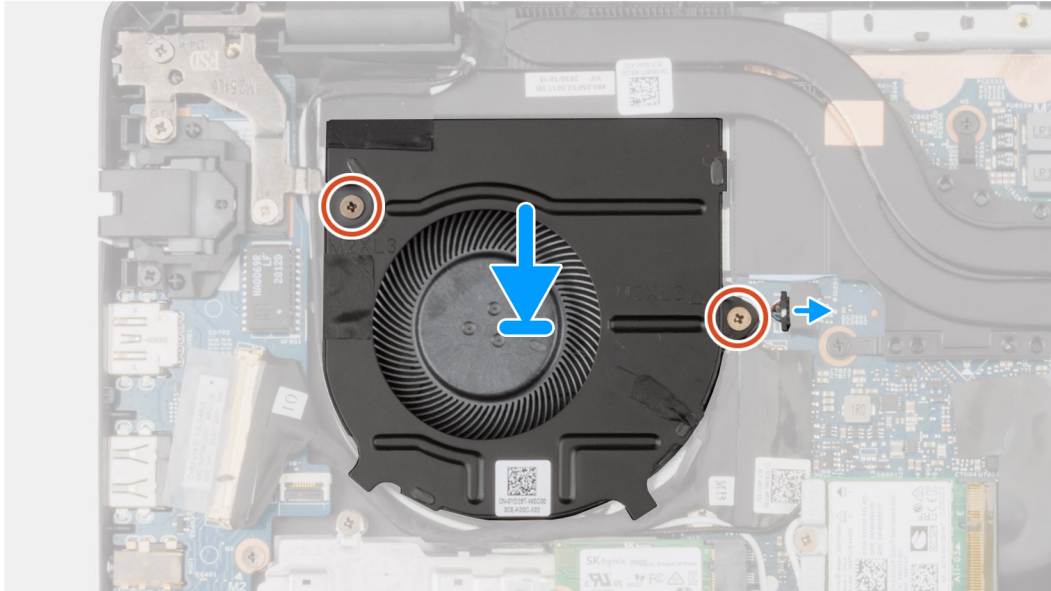
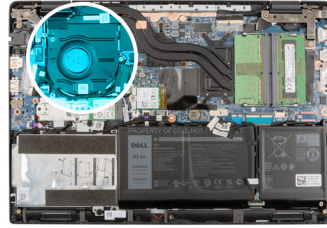
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 팬의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



2x
M2x3



단계

1. 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 시스템 팬을 맞추어 놓습니다.
2. 2개의 M2x3 나사를 설치하여 시스템 팬을 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.
3. 시스템 보드의 커넥터에 시스템 팬 케이블을 연결합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. **서비스 모드**를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
4. **microSD 카드**를 설치합니다.
5. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

배터리

3셀 배터리 제거

전제조건

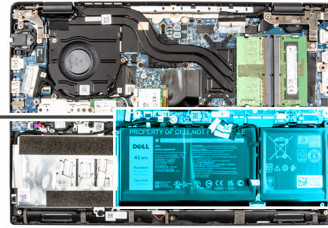
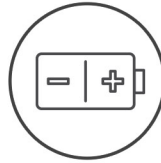
1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.
4. **베이스 커버**를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



3x
M2x3



단계

1. 시스템 보드의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.
2. 배터리를 제자리에 고정하는 3개의 M2X3 나사를 제거합니다.
3. 배터리를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.
4. 잠금을 해제하려면 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣습니다.
5. 접착 테이프를 떼어내고 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널에서 라우팅 해제합니다.
6. 배터리의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.

3셀 배터리 설치

전제조건

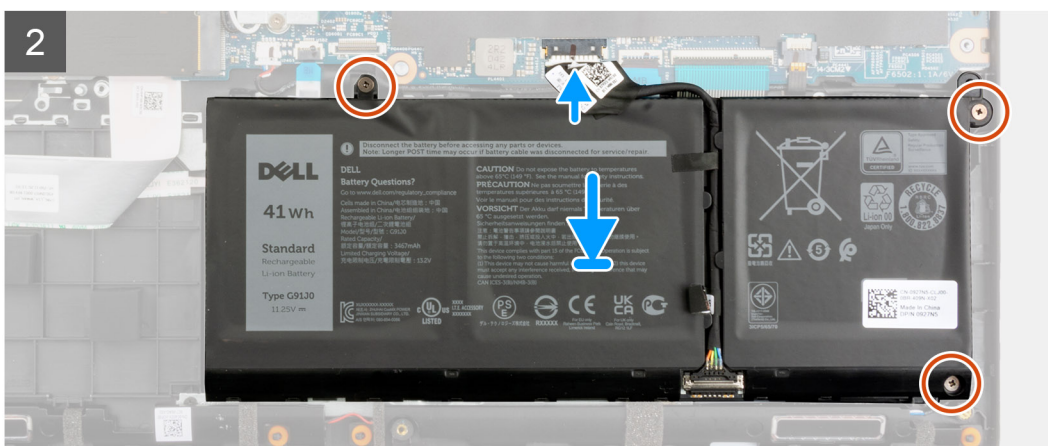
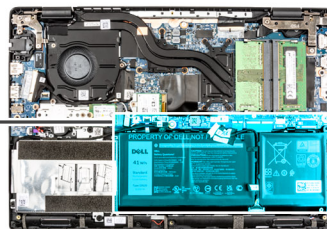
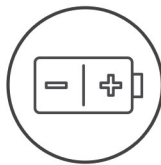
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



3x
M2x3



단계

1. 배터리 케이블을 배터리의 커넥터에 연결합니다.
2. 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣어 잠급니다.
3. 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널을 통해 라우팅하고 접착 테이프를 부착합니다.
4. 배터리를 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
5. 3개의 M2X3 나사를 설치하여 배터리를 제자리에 고정합니다.
6. 배터리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
3. **microSD 카드**를 설치합니다.
4. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후**의 절차를 따릅니다.

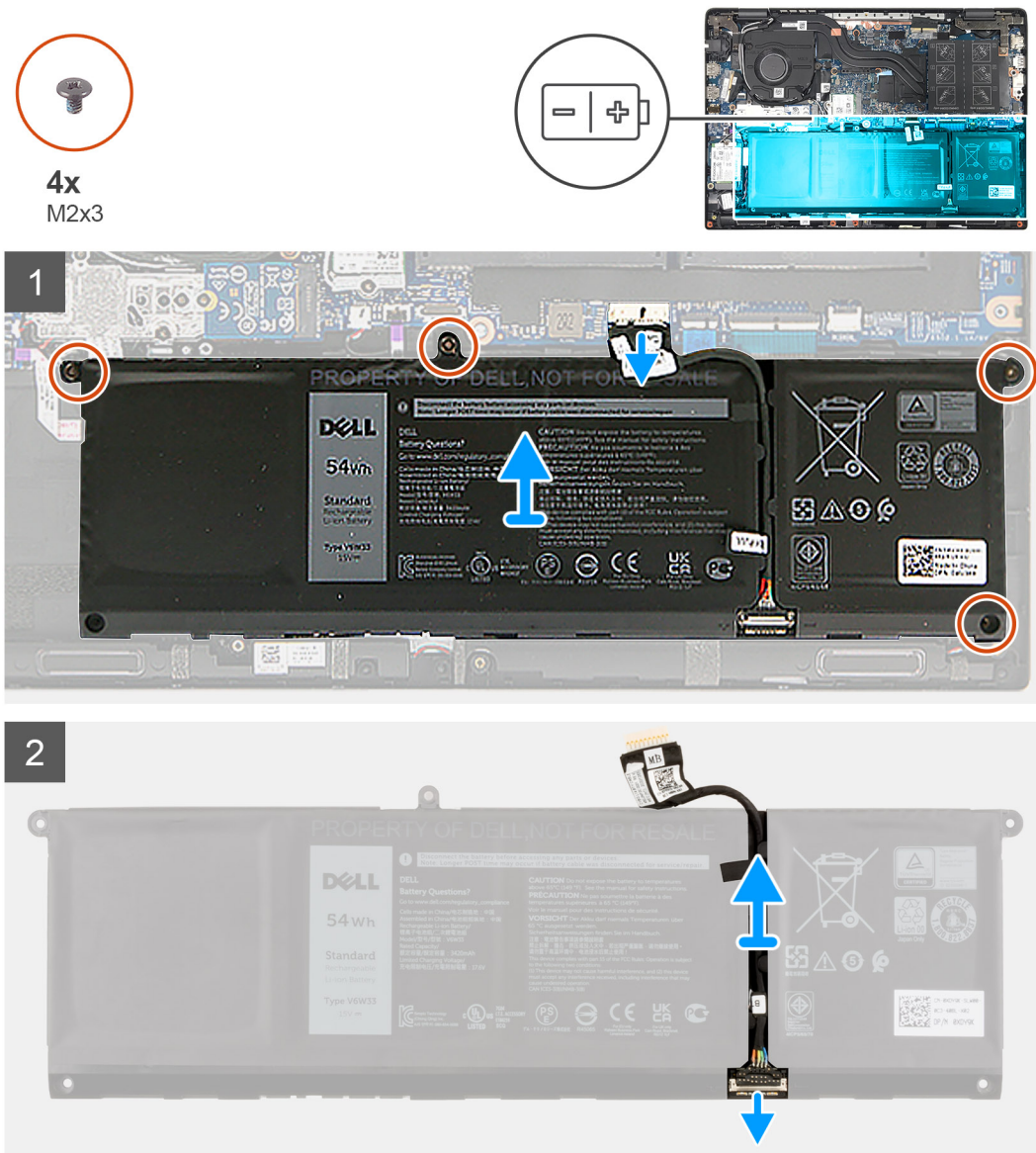
4셀 배터리 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 시스템 보드의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.
2. 배터리를 제자리에 고정하는 4개의 M2X3 나사를 제거합니다.
3. 배터리를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.
4. 잠금을 해제하려면 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣습니다.
5. 접착 테이프를 떼어내고 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널에서 라우팅 해제합니다.

6. 배터리의 커넥터에서 배터리 케이블을 연결 해제합니다.

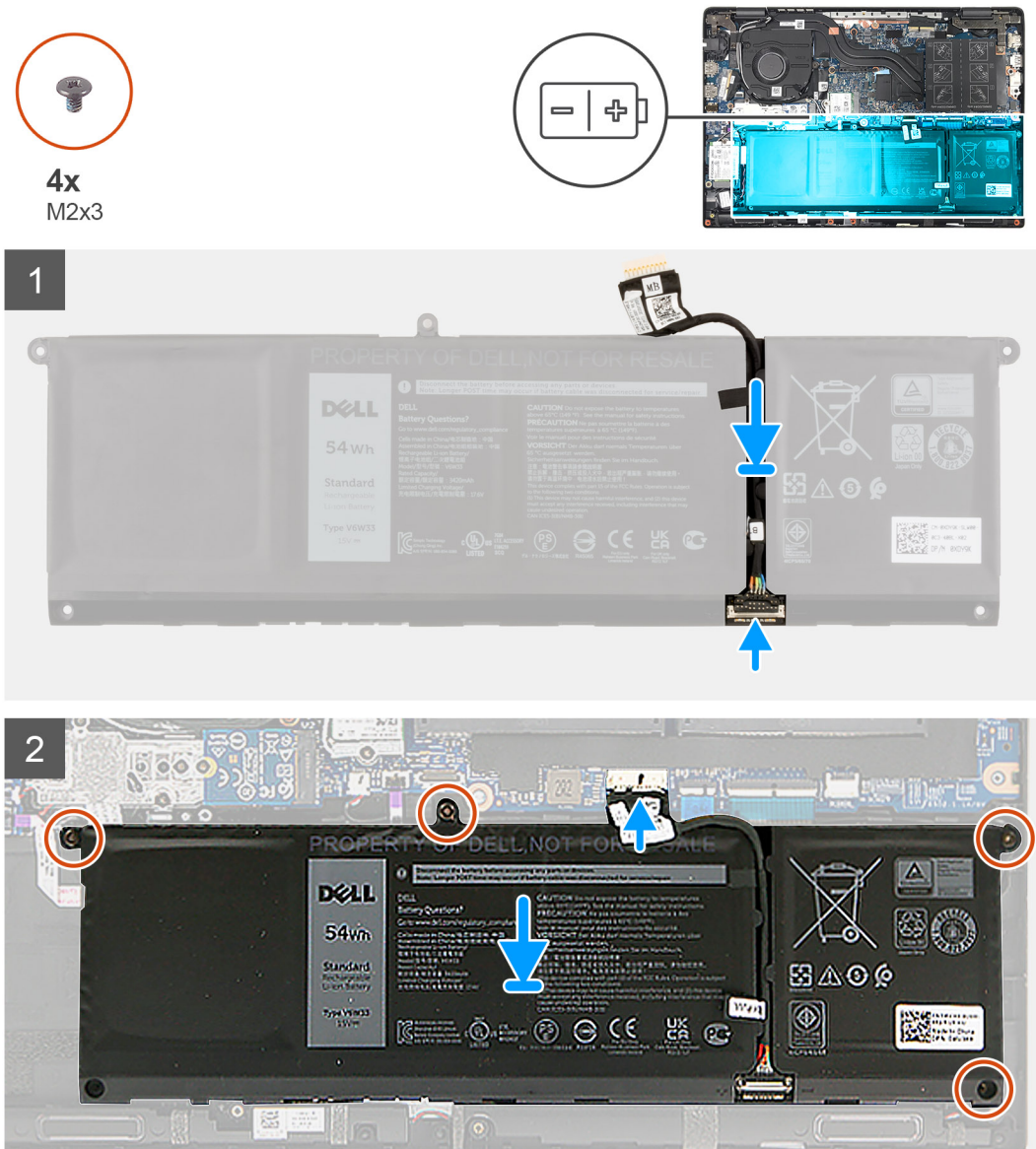
4셀 배터리 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 배터리 케이블을 배터리의 커넥터에 연결합니다.
2. 배터리의 커넥터 위에 금속을 밀어 넣어 잠급니다.
3. 배터리 케이블을 배터리의 라우팅 채널을 통해 라우팅하고 접착 테이프를 부착합니다.
4. 배터리를 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
5. 4개의 M2X3 나사를 설치하여 배터리를 제자리에 고정합니다.
6. 배터리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
3. microSD 카드를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

I/O 케이블

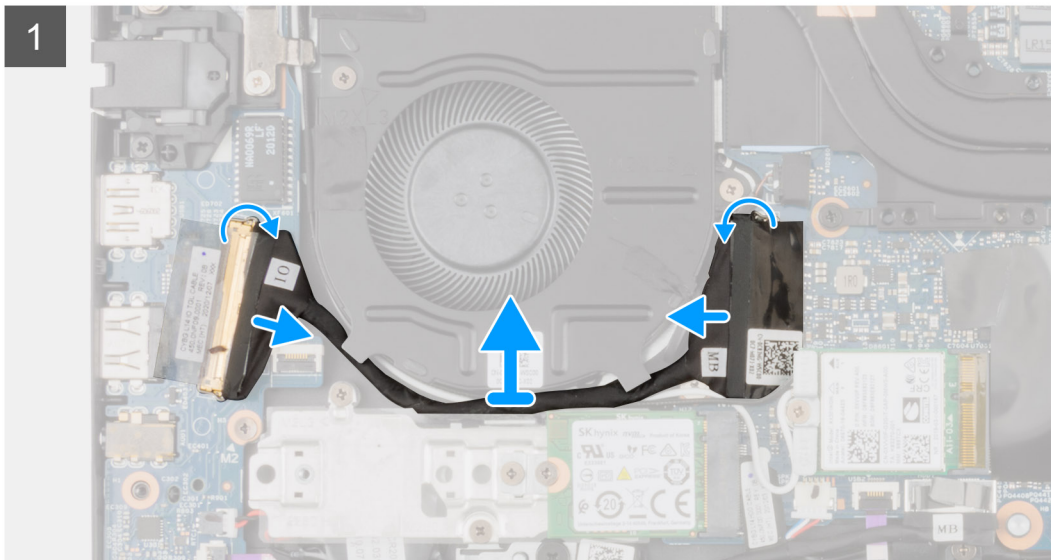
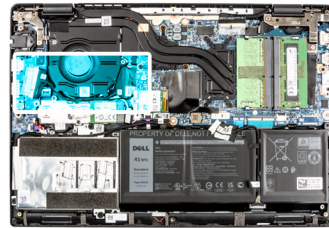
I/O 케이블 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
3. 서비스 모드로 전환합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 I/O 케이블의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 접착 테이프를 떼어내고 래치를 연 다음 I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 접착 테이프를 떼어내고 I/O 케이블을 팜레스트 어셈블리의 라우팅 가이드에서 라우팅 해제합니다.
3. 접착 테이프를 떼어내고 래치를 연 다음 I/O 케이블을 I/O 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. I/O 케이블을 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

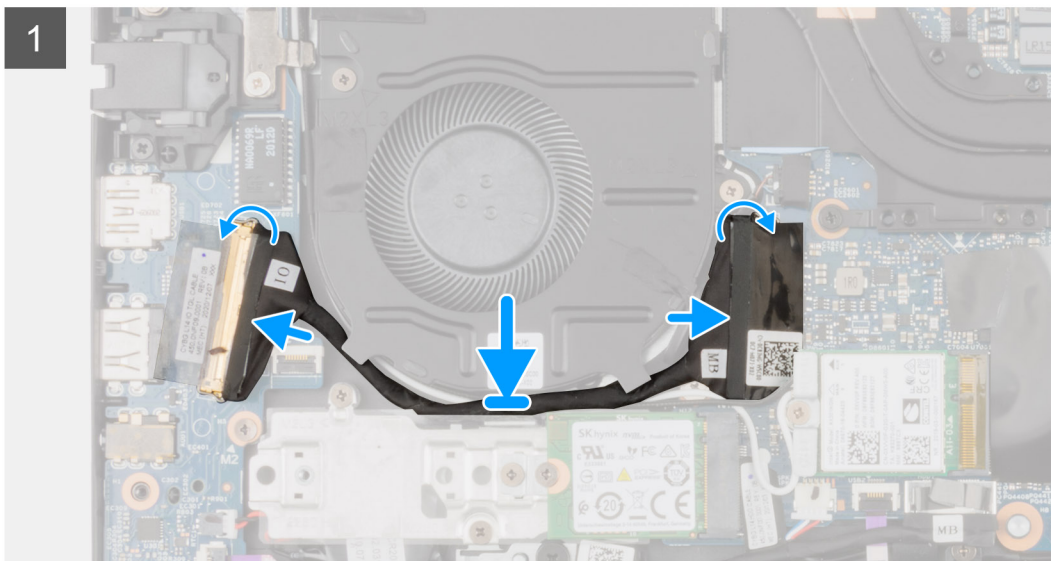
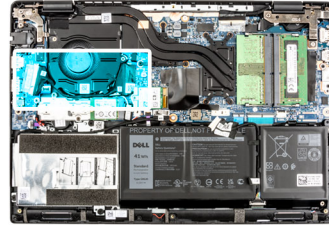
I/O 케이블 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 I/O 케이블의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. I/O 케이블을 라우팅 가이드를 통해 라우팅하고 접착 테이프를 부착하여 I/O 케이블을 제자리에 고정합니다.
2. I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 접착 테이프를 부착한 다음 래치를 닫습니다.
3. I/O 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 연결하고, 접착 테이프를 부착한 다음 래치를 닫습니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 서비스 모드를 종료합니다.
3. microSD 카드를 설치합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 어셈블리

디스플레이 어셈블리 제거

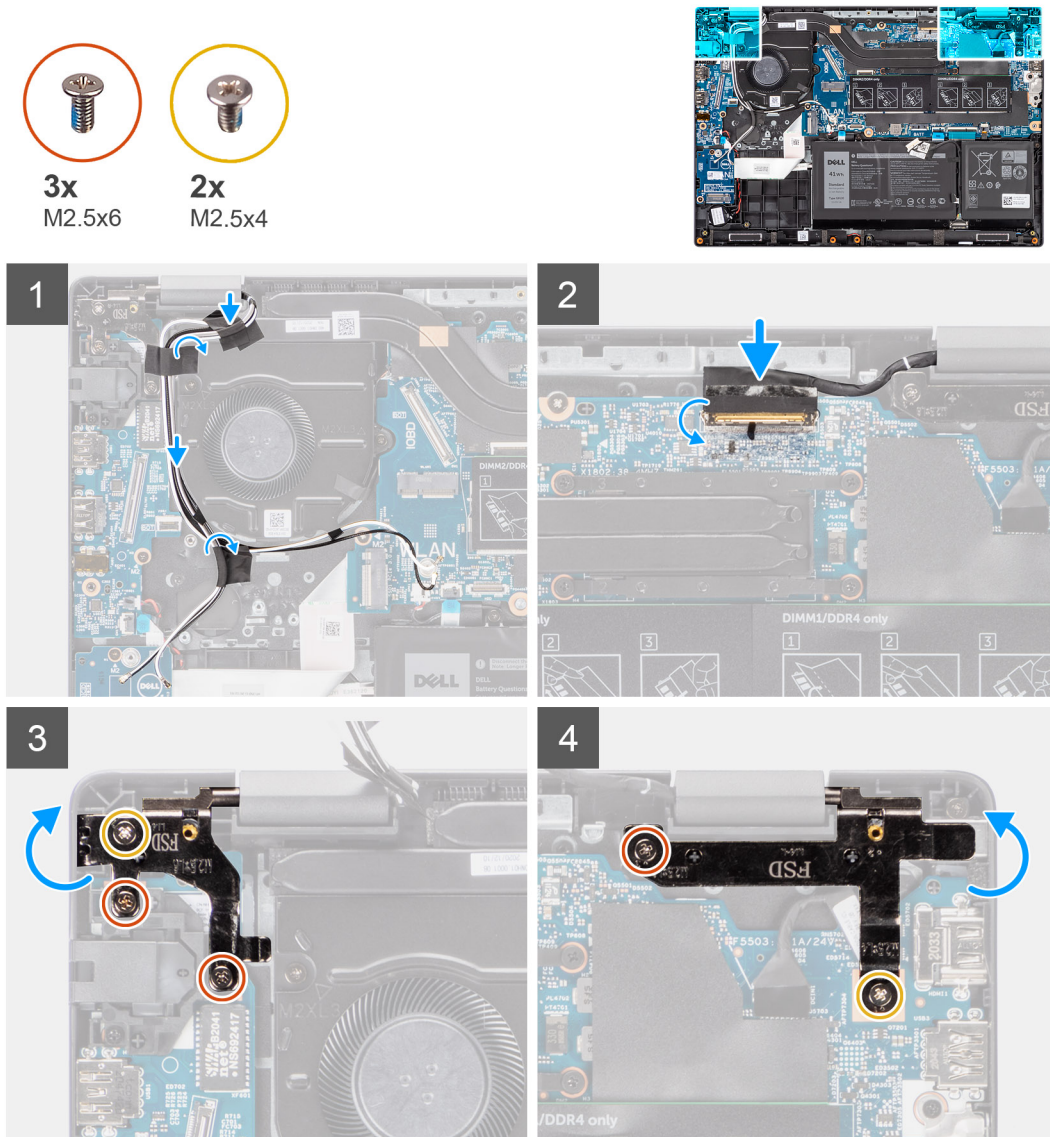
전제조건

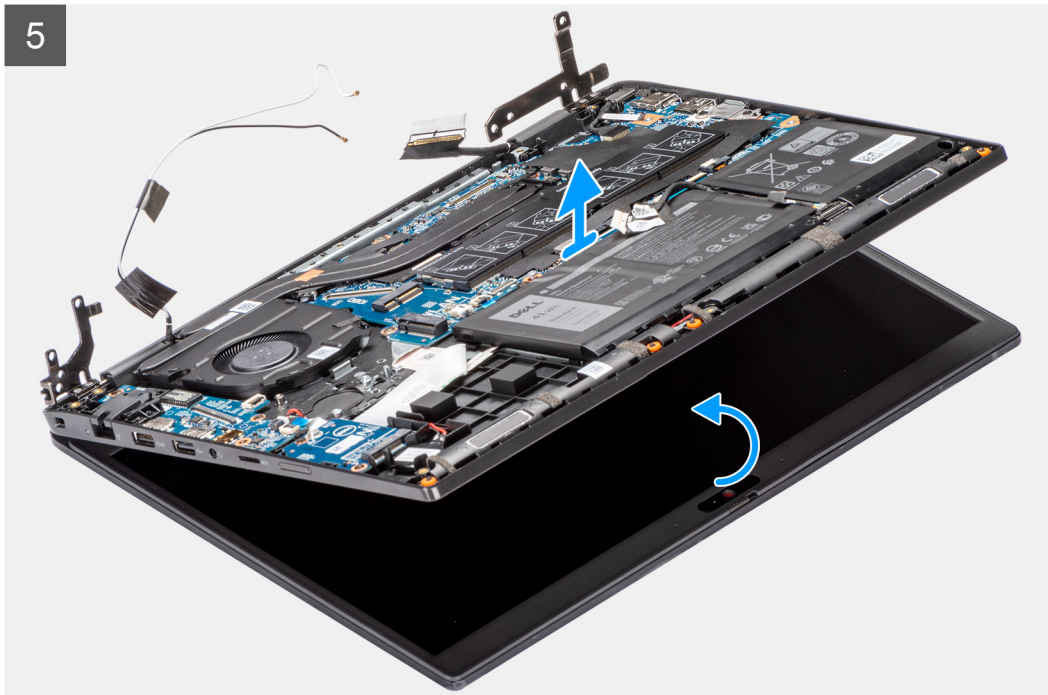
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD 변환 브래킷을 제거합니다.
8. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD 변환판을 제거합니다.
9. WLAN 카드를 제거합니다.
10. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
11. I/O 케이블을 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 디스플레이 어셈블리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.





단계

1. 디스플레이 케이블을 팜레스트 어셈블리의 라우팅 가이드에서 라우팅 해제합니다.
2. 디스플레이 케이블을 제자리에 고정하는 접착 테이프를 떼어냅니다.
3. 래치를 열고 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. 디스플레이 힌지를 시스템에 고정하는 3개의 M2.5x6 및 2개의 M2.5x4 나사를 제거합니다.
5. 왼쪽 및 오른쪽 힌지를 위로 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 분리합니다.
6. 팜레스트 어셈블리를 들어올려 디스플레이 어셈블리에서 분리합니다.

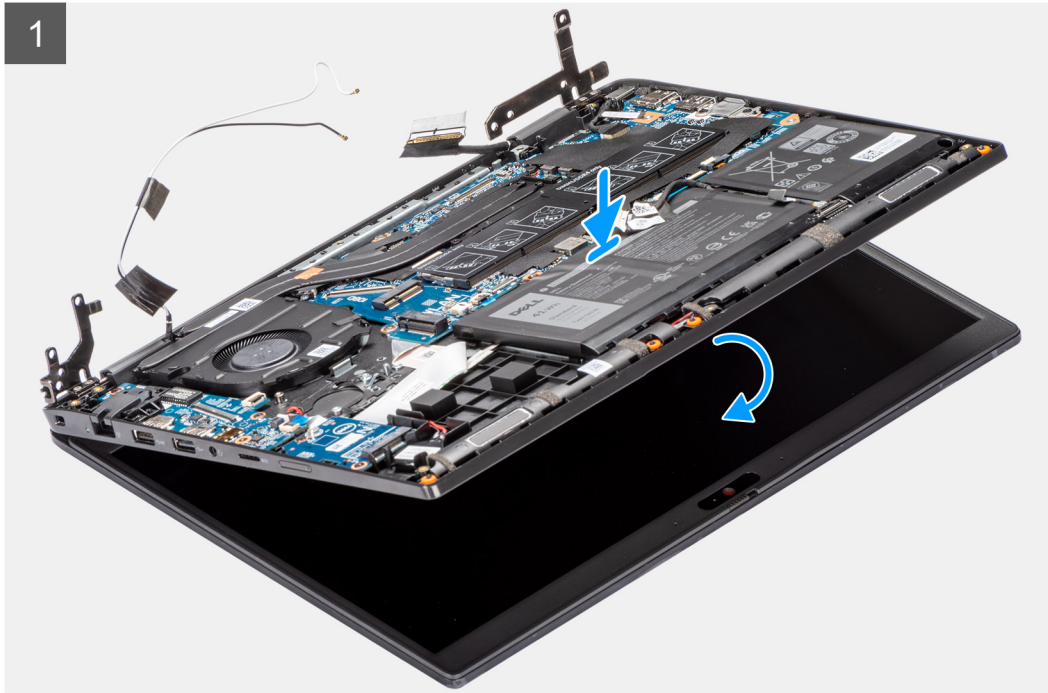
디스플레이 어셈블리 설치

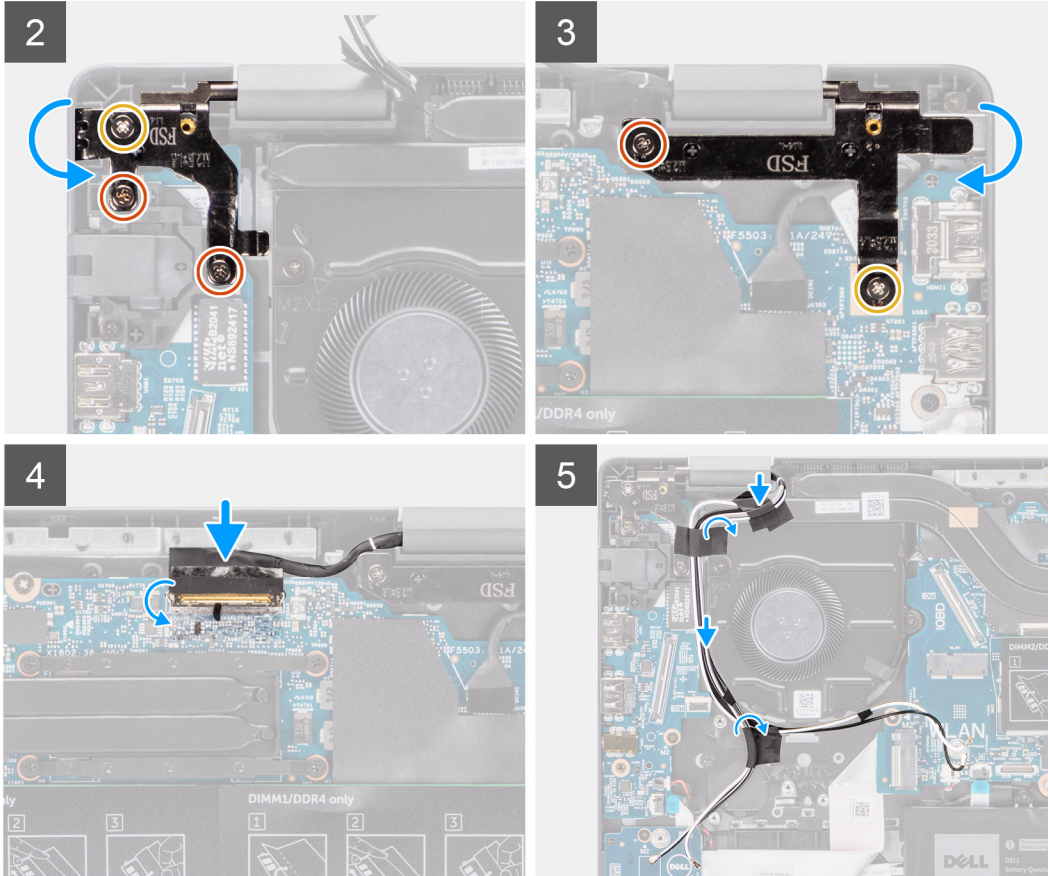
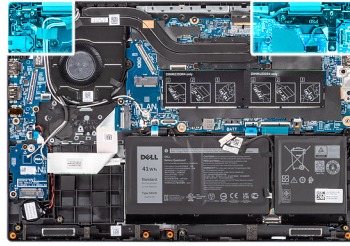
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 디스플레이 어셈블리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.





단계

1. 시스템 새시를 디스플레이 어셈블리의 힌지 아래에 맞추어 놓습니다.
2. 왼쪽 및 오른쪽 힌지를 팜레스트 어셈블리를 향해 아래로 누릅니다.
3. 3개의 M2.5x6 및 2개의 M2.5x4 나사를 설치하여 디스플레이 힌지를 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.
4. 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.
5. 디스플레이 케이블을 팜레스트 어셈블리의 라우팅 가이드를 통해 라우팅합니다.
6. 접착 테이프를 부착하여 디스플레이 케이블을 제자리에 고정합니다.

다음 단계

1. I/O 케이블을 설치합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 설치합니다.
3. WLAN 카드를 설치합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD 변환판을 설치합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD 변환 브래킷을 설치합니다.
6. 4G LTE 지원 시스템의 경우 M.2 SSD를 설치합니다.
7. 베이스 커버를 설치합니다.
8. 서비스 모드를 종료합니다.
9. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
10. microSD 카드를 설치합니다.

11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 패널

디스플레이 패널 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 서비스 모드로 전환합니다.
3. microSD 카드를 제거합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. WLAN 카드를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
8. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
10. 디스플레이 베젤을 분리합니다.

이 작업 정보

이 노트: 디스플레이 패널은 단일 서비스 부품으로 디스플레이 브래킷과 함께 사전 조립됩니다. SR(Stretch Release) 테이프를 당겨 디스플레이 패널에서 분리하지 말고 디스플레이 패널에서 브래킷을 분리하십시오.



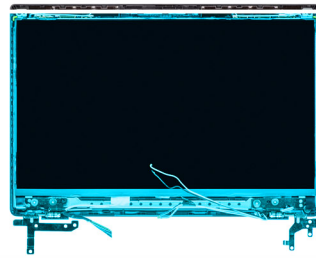
다음 이미지는 디스플레이 패널의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



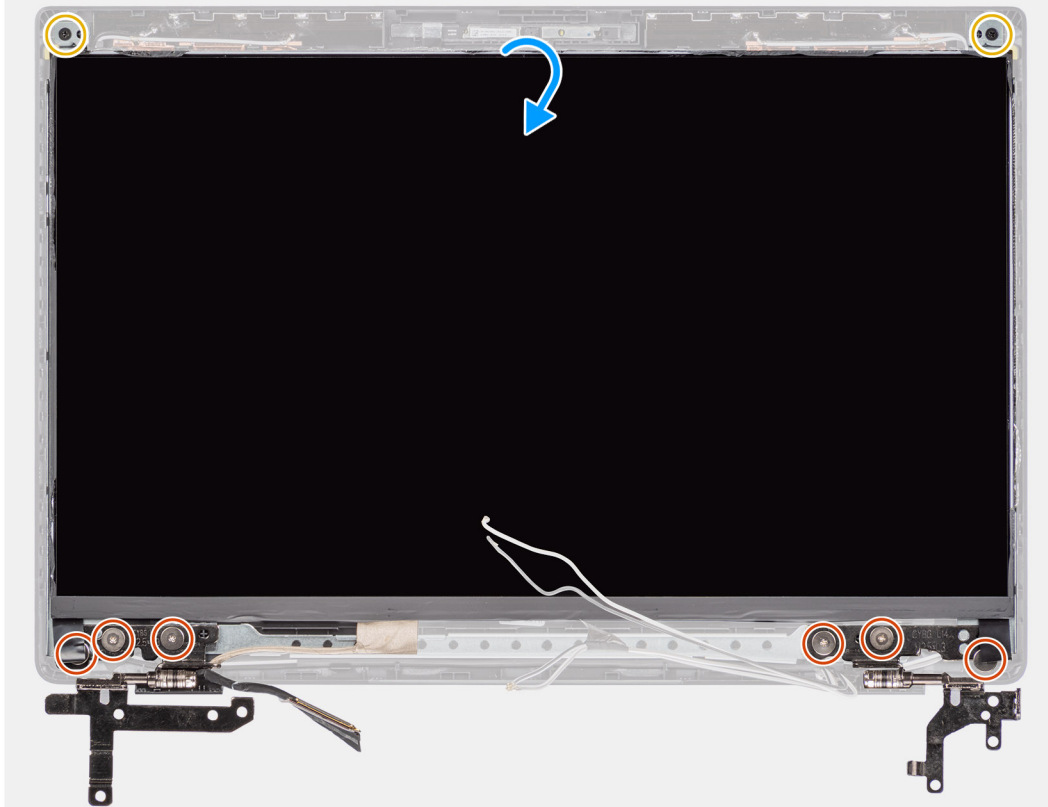
6x
M2.5x2.5



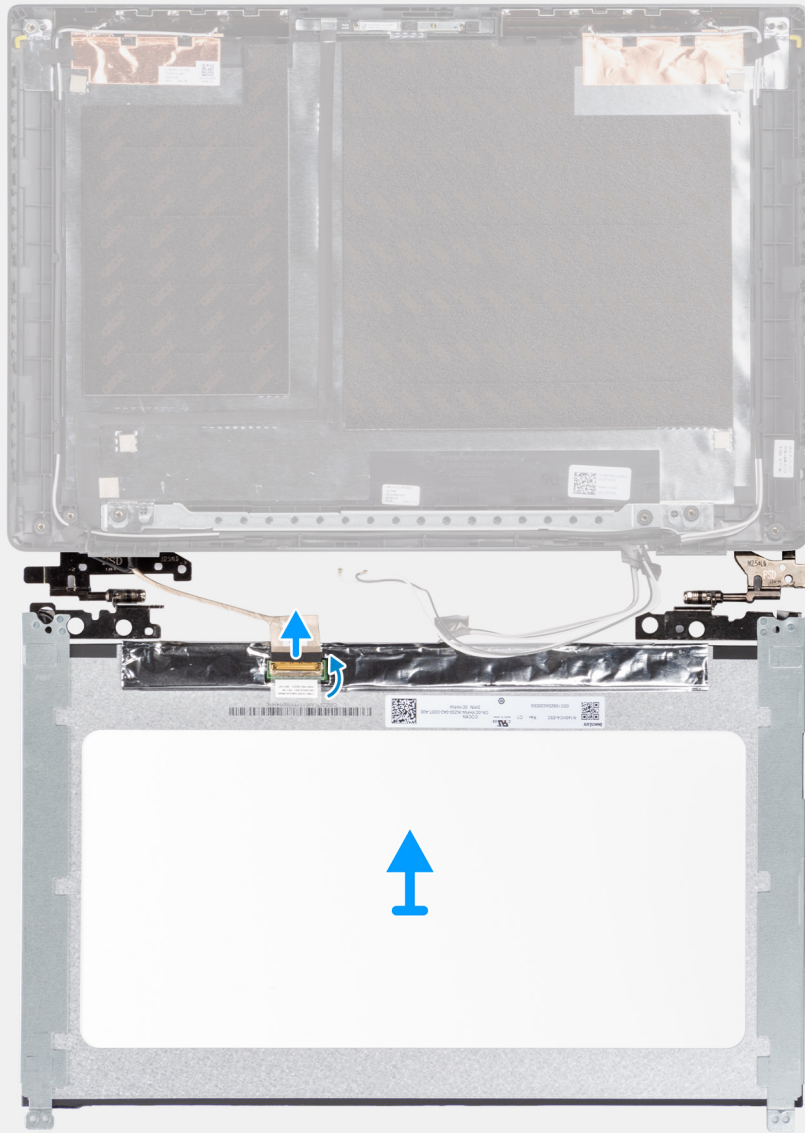
2x
M2.5x3



1



2





단계

1. 왼쪽 및 오른쪽 힌지 브래킷을 제자리에 고정하는 6개의 M2.5x2.5 및 2개의 M2.5x3 나사를 제거합니다.
2. 디스플레이 패널을 조심스럽게 뒤집습니다.
3. 접착 테이프를 떼어내고 래치를 연 다음 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. 디스플레이 패널을 들어 올려 디스플레이 어셈블리에서 제거합니다.

디스플레이 패널 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

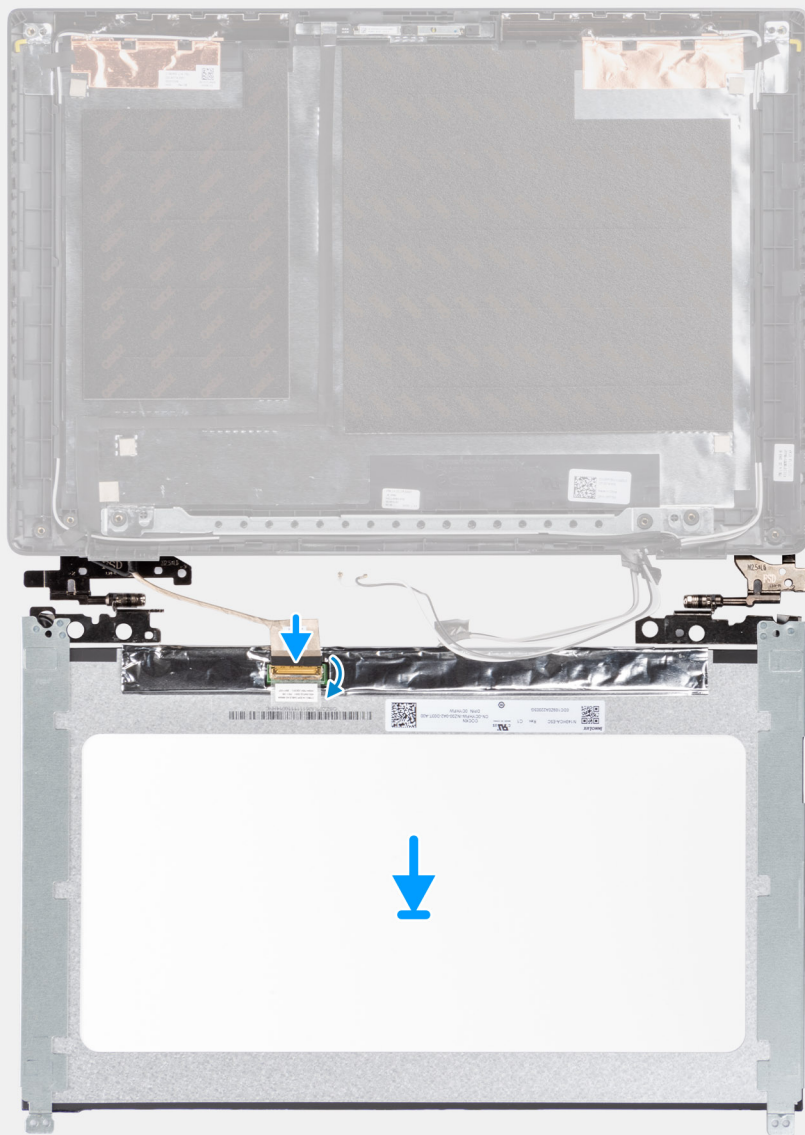
이 작업 정보

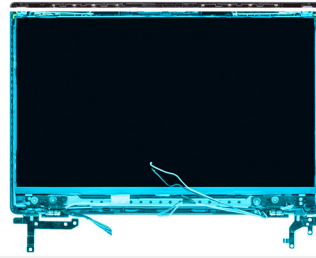
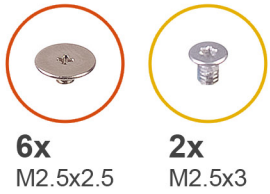
- ❗ 노트:** 디스플레이 패널은 단일 서비스 부품으로 디스플레이 브래킷과 함께 사전 조립됩니다. SR(Stretch Release) 테이프를 당겨 디스플레이 패널에서 분리하지 말고 디스플레이 패널에서 브래킷을 분리하십시오.



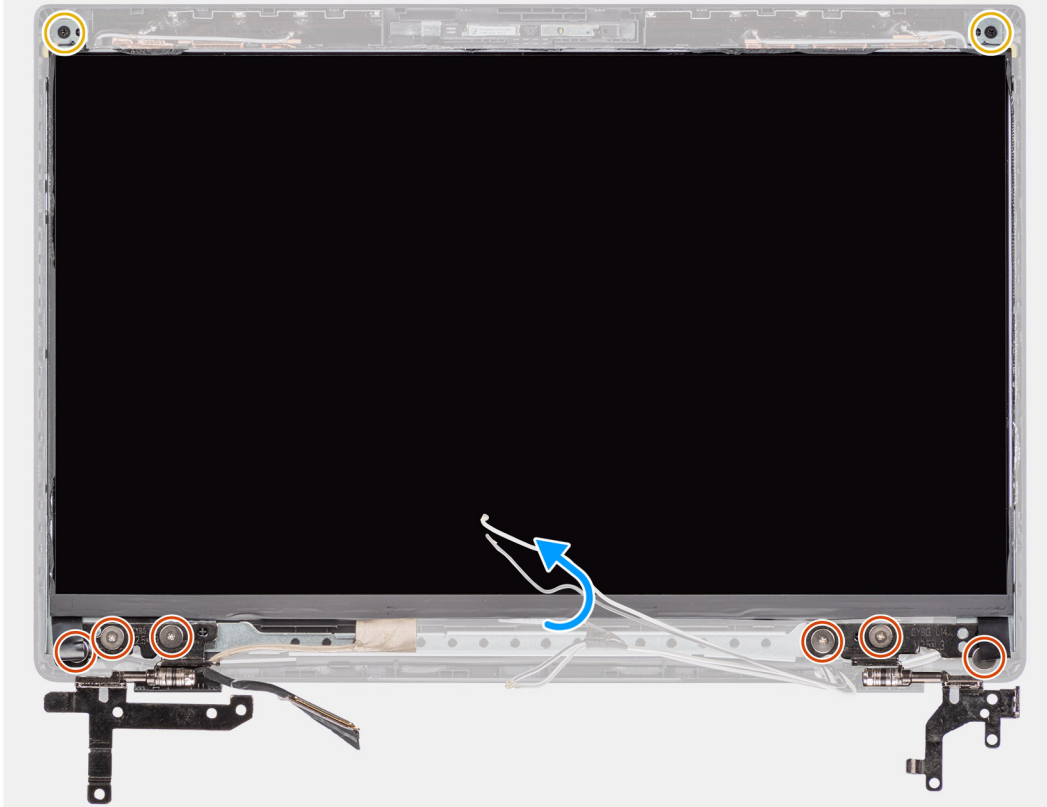
다음 이미지는 디스플레이 패널의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

1





2



단계

1. 디스플레이 패널을 디스플레이 어셈블리에 맞추어 놓습니다.
2. 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널의 커넥터에 연결하고 래치를 닫은 다음 접착 테이프를 부착합니다.
3. 6개의 M2.5x2.5 및 2개의 M2.5x3 나사를 설치하여 왼쪽 및 오른쪽 힌지 브래킷을 제자리에 고정합니다.
4. 디스플레이 패널을 조심스럽게 뒤집습니다.

다음 단계

1. **디스플레이 베젤**을 설치합니다.
2. **디스플레이 어셈블리**를 설치합니다.
3. **I/O 보드 케이블**을 설치합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **WWAN 카드**를 설치합니다.
5. **WLAN 카드**를 설치합니다.
6. **베이스 커버**를 설치합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
8. **microSD 카드**를 설치합니다.
9. **서비스 모드**를 종료합니다.
10. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

디스플레이 베젤

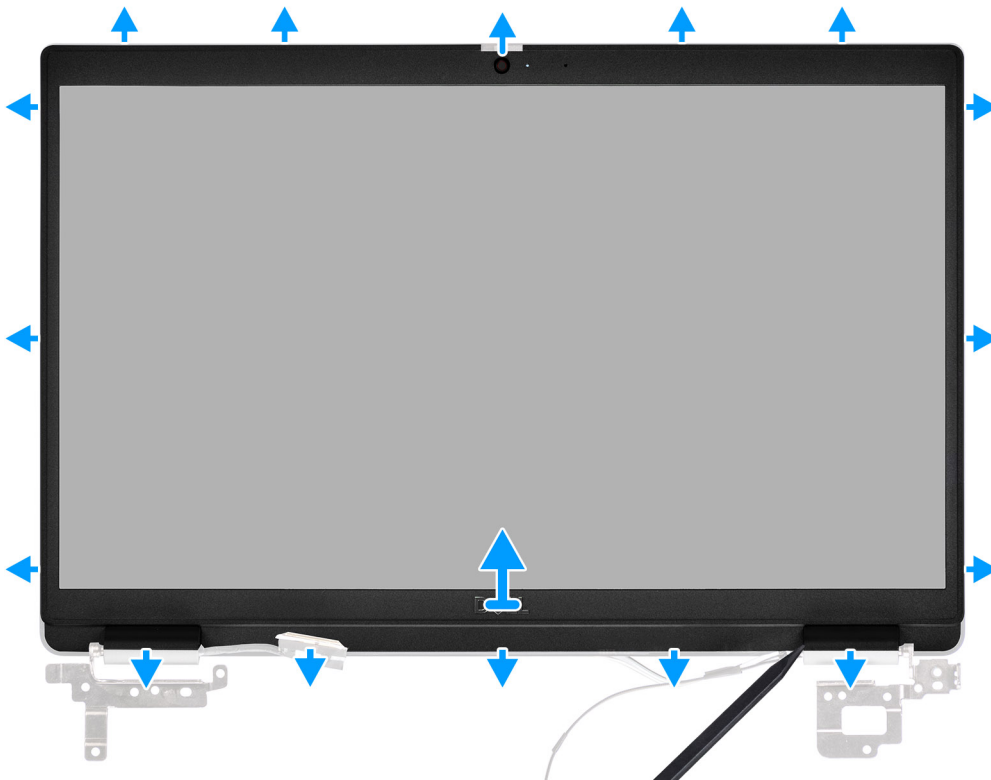
디스플레이 베젤 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. WLAN 카드를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
8. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 베젤의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 플라스틱 스크라이브를 사용하여 상단, 디스플레이 베젤의 왼쪽 및 오른쪽 측면을 조심스럽게 들어 올려 엽니다.
주의: 디스플레이 베젤을 들어 올려서 열 때 손이나 플라스틱 스크라이브로 디스플레이 베젤의 바깥쪽 가장자리를 따라 들어 올려야 합니다. 스크루 드라이버나 다른 날카로운 물체를 사용하면 디스플레이 커버가 손상될 수 있습니다.
2. 디스플레이 어셈블리에서 디스플레이 베젤을 들어 올려 제거합니다.

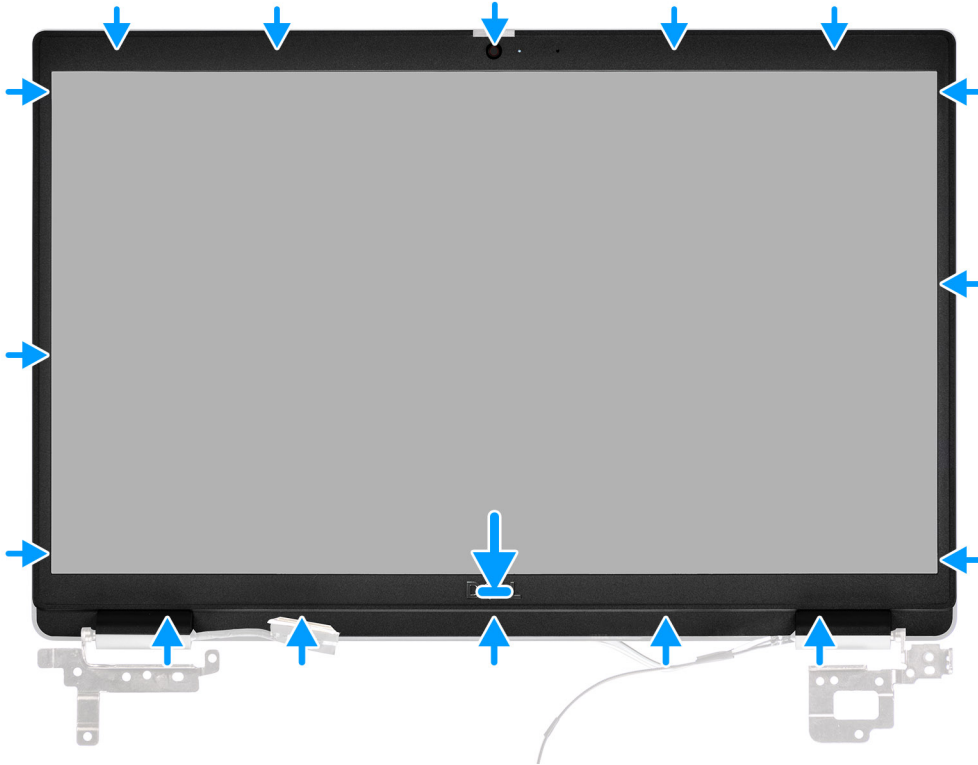
디스플레이 베젤 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 디스플레이 베젤의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

디스플레이 베젤을 디스플레이 어셈블리에 맞춰서 놓습니다. 조심스럽게 디스플레이 베젤을 제자리에 끼워 넣습니다.

다음 단계

1. [디스플레이 어셈블리](#)를 설치합니다.
2. [I/O 보드 케이블](#)을 설치합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [WWAN 카드](#)를 설치합니다.
4. [WLAN 카드](#)를 설치합니다.
5. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
6. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
8. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
9. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

방열판 조립품

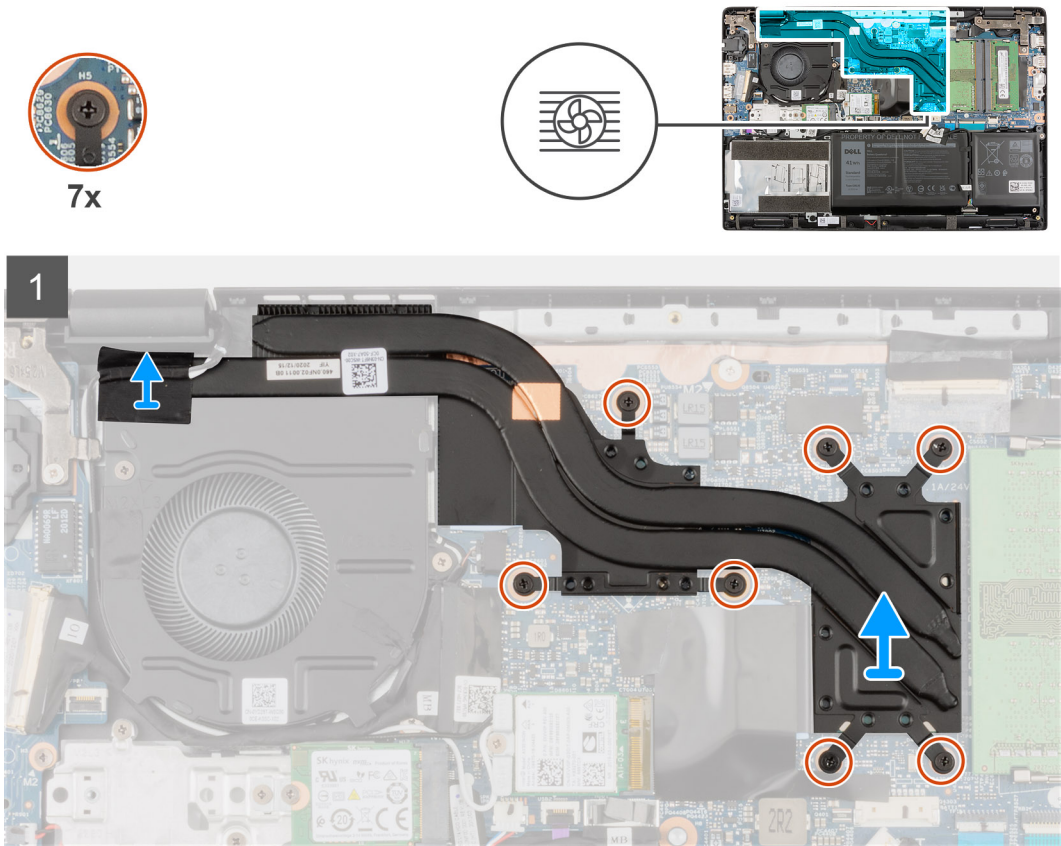
방열판 어셈블리 제거

전제조건

- 1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
- 2. microSD 카드를 제거합니다.
- 3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
- 4. 서비스 모드로 전환합니다.
- 5. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판 어셈블리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

- 1. 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 7개의 캡티브 나사를 역순으로(7>6>5>4->3->2->1) 풉니다.
- 2. 방열판 어셈블리를 들어 올려 시스템 보드에서 제거합니다.

방열판 어셈블리 설치

전제조건

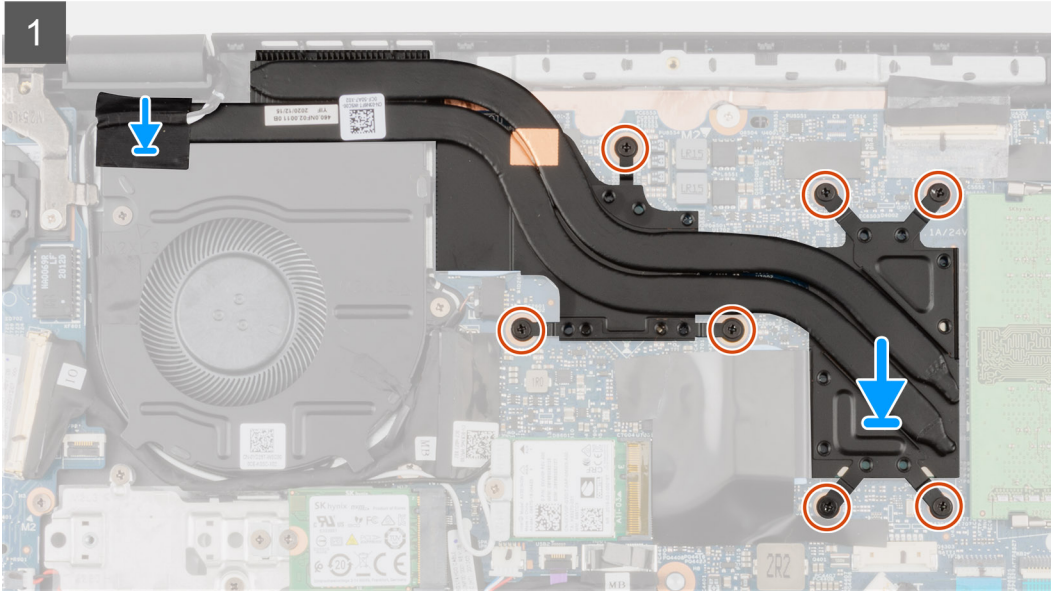
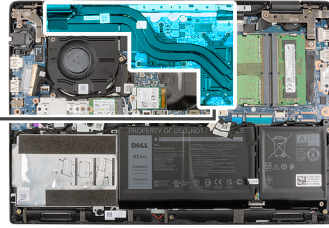
구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판 어셈블리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



7x



단계

1. 방열판 어셈블리를 시스템 보드의 해당 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 7개의 캡티브 나사를 순서대로(1>2>3>4>5>6>7) 조여서 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 서비스 모드를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
4. microSD 카드를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

전원 어댑터 포트

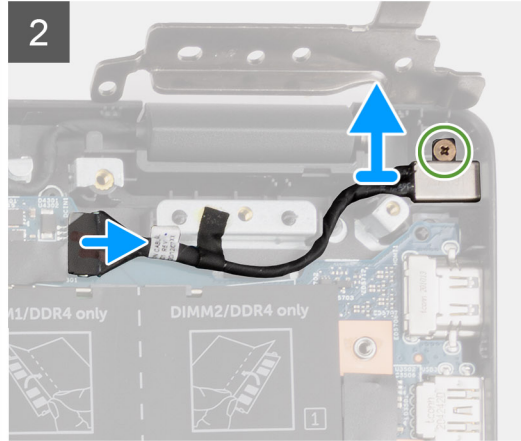
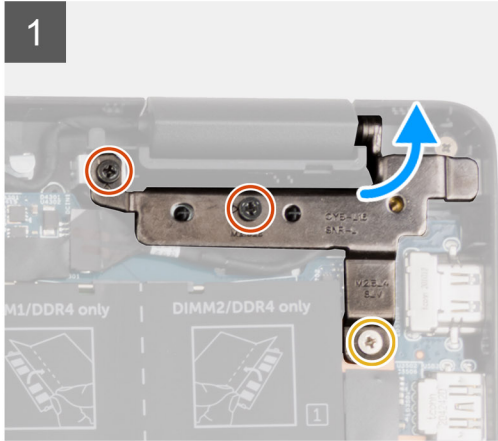
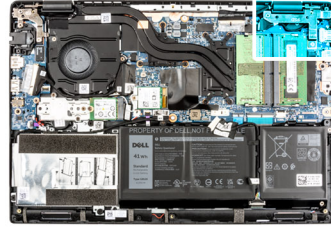
전원 어댑터 포트 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 전원 어댑터 포트의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



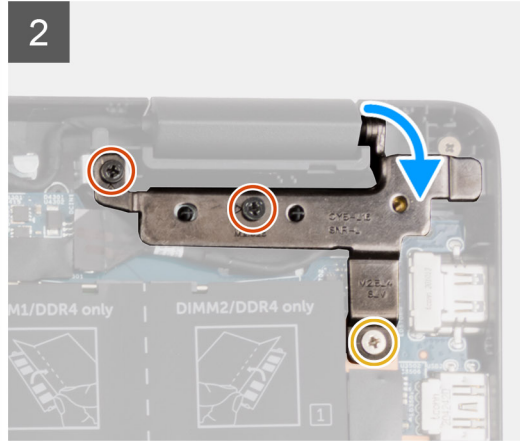
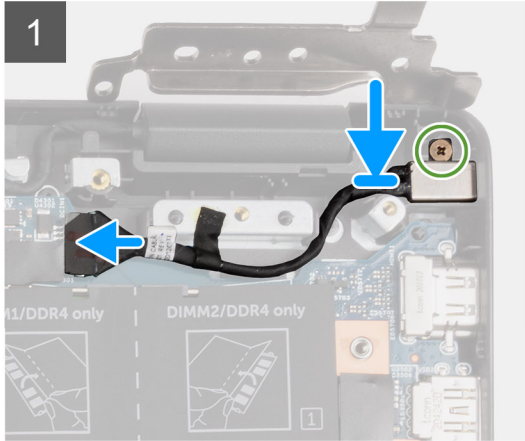
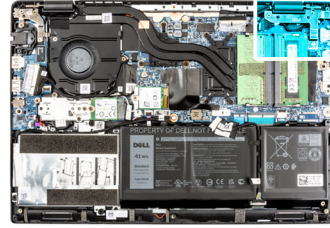
단계

1. 디스플레이 힌지를 시스템에 고정하는 M2.5x6 및 M2.5x4 나사를 제거합니다.
2. 전원 어댑터 포트를 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
3. 전원 어댑터 포트를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 M2x3 나사를 제거합니다.
4. 전원 어댑터 포트를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

전원 어댑터 포트 설치

이 작업 정보

다음 이미지는 전원 어댑터 포트의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 전원 어댑터 포트를 팜레스트 어셈블리에 맞추어 놓습니다.
2. M2x3 나사를 설치하여 전원 어댑터 포트를 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.
3. 전원 어댑터 포트를 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
4. M2.5x6 및 M2.5x4 나사를 설치하여 디스플레이 힌지를 시스템에 고정합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. **서비스 모드**를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
4. **microSD 카드**를 설치합니다.
5. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

코인 셀 배터리

코인 셀 배터리 제거

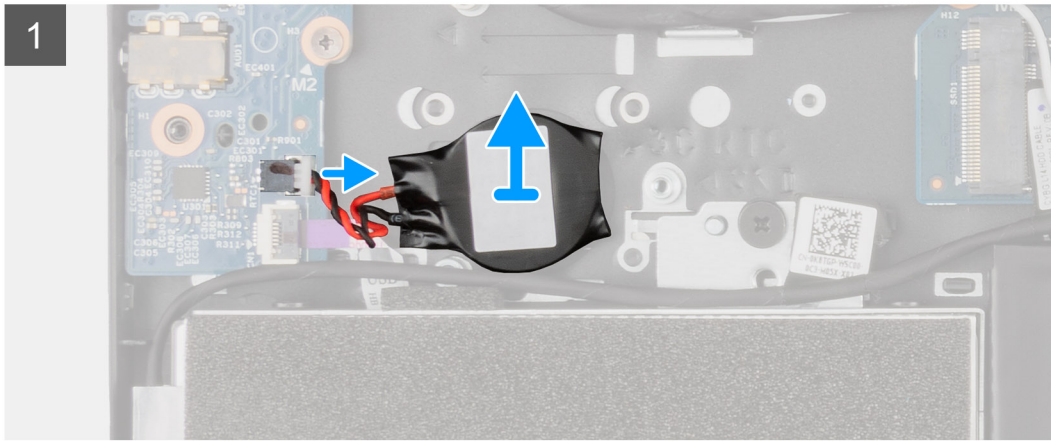
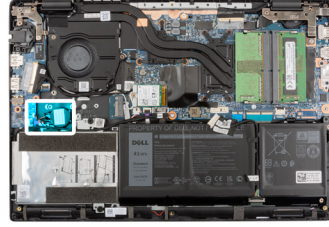
전제조건

1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.
4. **서비스 모드**로 전환합니다.
5. **베이스 커버**를 제거합니다.
6. **M.2 SSD**를 제거합니다.
7. **M.2 SSD 열판**을 제거합니다.
8. **M.2 SSD 변환 브래킷**을 제거합니다.

이 작업 정보

① 노트: CMOS 배터리가 서비스를 위해 시스템 보드에서 연결 해제된 경우 시스템이 RTC 배터리 재설정을 수행하며 시스템 부팅 중에는 지연이 발생합니다.

다음 그림은 코인 셀 배터리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 코인 셀 배터리 케이블을 I/O 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 코인 셀 배터리를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

코인 셀 배터리 설치

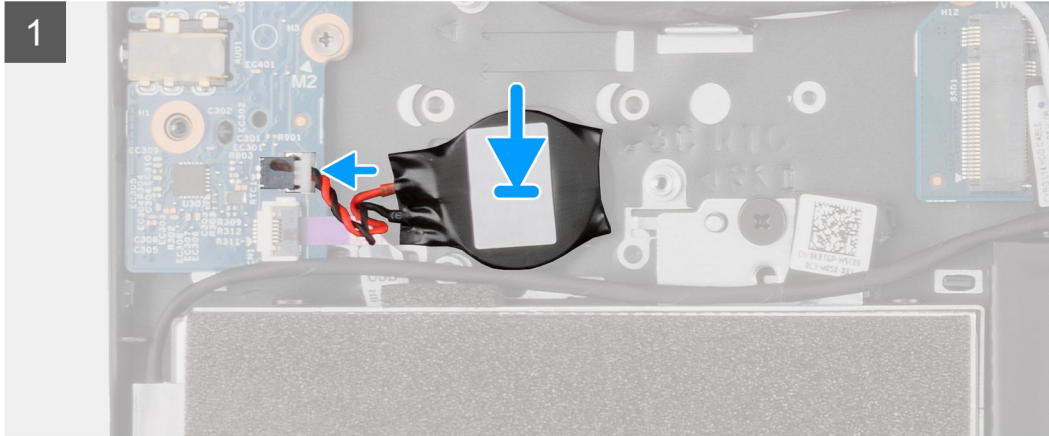
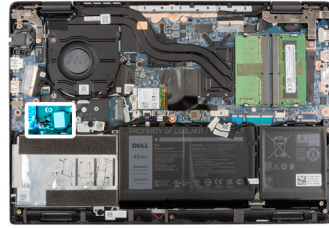
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

① 노트: CMOS 배터리가 서비스를 위해 시스템 보드에서 연결 해제된 경우 시스템이 RTC 배터리 재설정을 수행하며 시스템 부팅 중에는 지연이 발생합니다.

다음 그림은 코인 셀 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 코인 셀 배터리를 팜레스트 어셈블리에 맞추어 놓습니다.
2. 코인 셀 배터리 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. M.2 SSD 변환 브래킷을 설치합니다.
2. M.2 SSD 열판을 설치합니다.
3. M.2 SSD를 설치합니다.
4. 베이스 커버를 설치합니다.
5. 서비스 모드를 종료합니다.
6. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
7. microSD 카드를 설치합니다.
8. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

USB 케이블

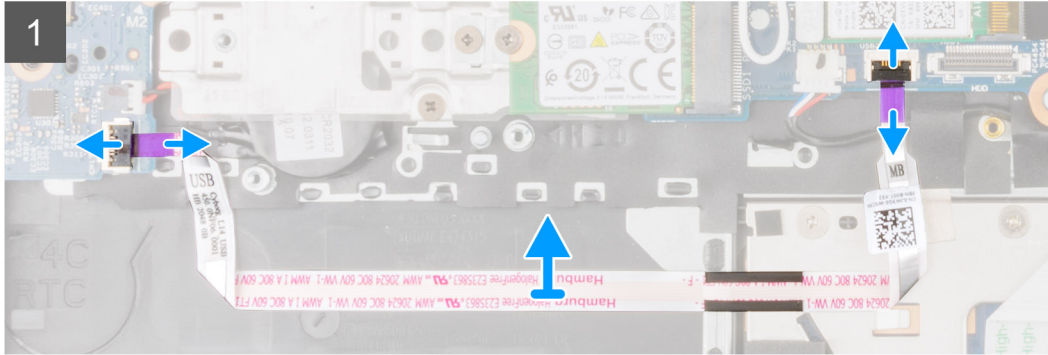
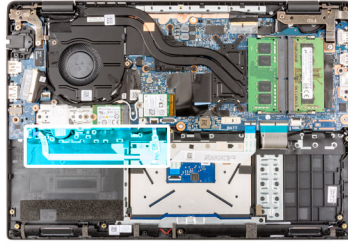
USB 케이블 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.
5. 배터리를 제거합니다.
6. 하드 디스크 드라이브를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 USB 케이블의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 래치를 열고 USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. USB 케이블을 팜레스트 어셈블리에서 조심스럽게 떼어냅니다.
3. 래치를 열고 USB 케이블을 I/O 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. USB 케이블을 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

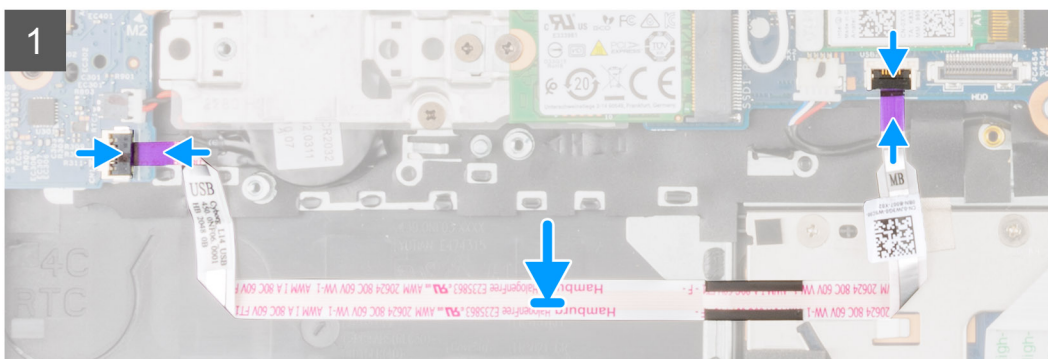
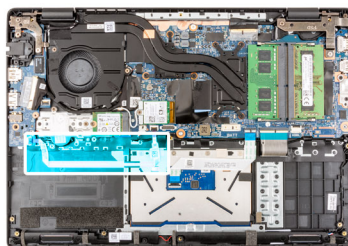
USB 케이블 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 USB 케이블의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.
2. USB 케이블을 팜레스트 어셈블리에 맞추어 부착합니다.
3. USB 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.

다음 단계

1. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **WWAN 카드**를 설치합니다.
2. **하드 디스크 드라이브**를 설치합니다.
3. **배터리**를 설치합니다.
4. **베이스 커버**를 설치합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
6. **microSD 카드**를 설치합니다.
7. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

이더넷 포트

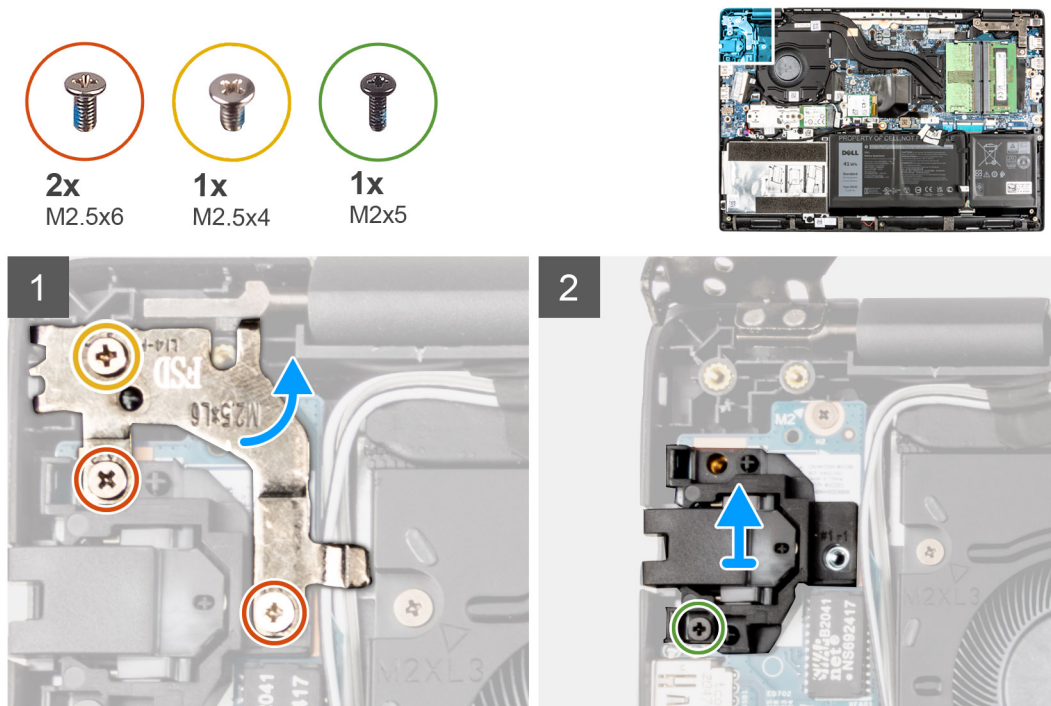
이더넷 포트 제거

전제조건

1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에**의 절차를 따릅니다.
2. **microSD 카드**를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 제거합니다.
4. **서비스 모드**로 전환합니다.
5. **베이스 커버**를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 이더넷 포트의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 힌지 브래킷을 팜레스트 어셈블리에 고정하는 M2.5x4 및 2개의 M2.5x6 나사를 제거합니다.
2. 힌지를 위로 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 분리합니다.
3. 이더넷을 I/O 보드에 고정하는 M2x5 나사를 제거합니다.
4. 이더넷을 들어 올려 I/O 보드에서 제거합니다.

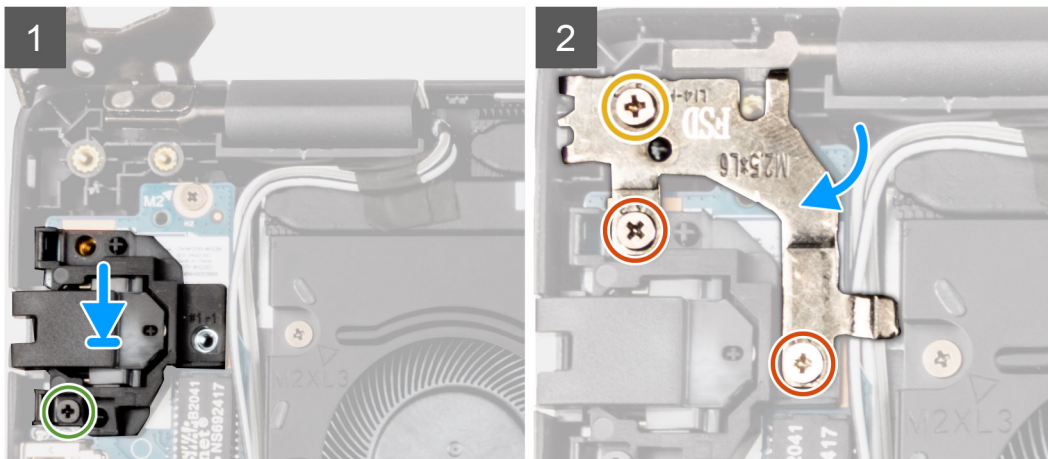
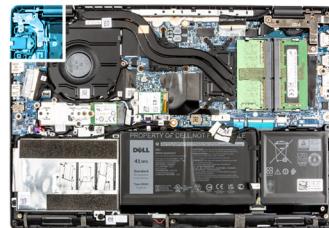
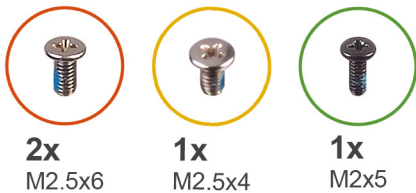
이더넷 포트 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 이더넷 포트의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 이더넷을 I/O 보드에 맞추어 놓습니다.
2. M2x5 나사를 설치하여 이더넷을 I/O 보드에 고정합니다.
3. 힌지를 팜레스트 어셈블리를 향해 아래로 누릅니다.
4. 힌지 브래킷을 팜레스트 어셈블리에 고정하는 M2.5x4 및 2개의 M2.5x6 나사를 설치합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. **서비스 모드**를 종료합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 **SIM 카드 트레이**를 설치합니다.
4. **microSD 카드**를 설치합니다.
5. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

I/O 보드

I/O 보드 제거

전제조건

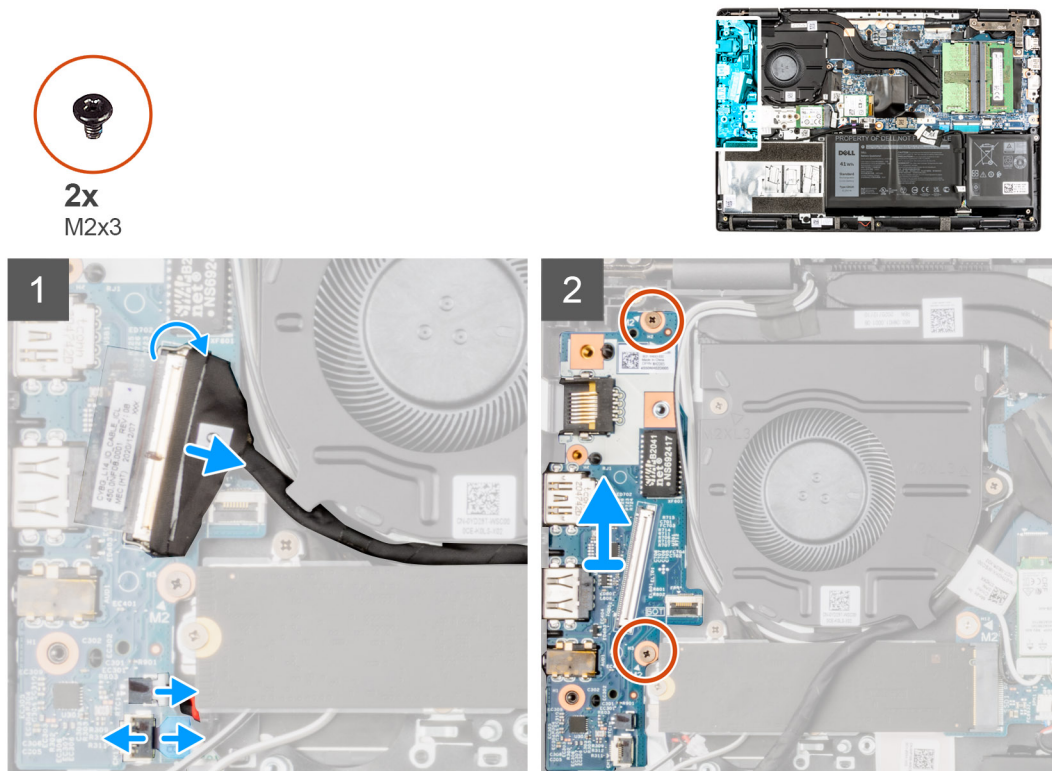
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. 이더넷 포트를 제거합니다.

이 작업 정보

 **노트:**

 **노트:** 다음 이미지는 전원 버튼 보드가 없는 시스템에 해당됩니다.

다음 이미지는 I/O 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 전원 버튼이 제공된 시스템의 경우 접착물을 떼어내고 래치를 연 다음 전원 버튼 케이블을 I/O 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 래치를 열고 I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
3. USB 케이블 및 코인 셀 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. I/O 보드를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x3 나사를 제거합니다.
5. I/O 보드를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

I/O 보드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

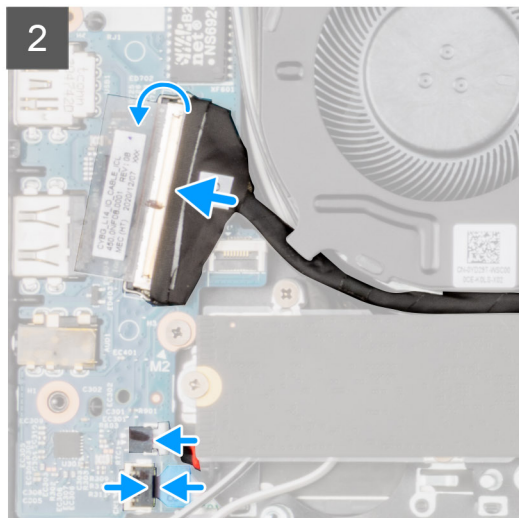
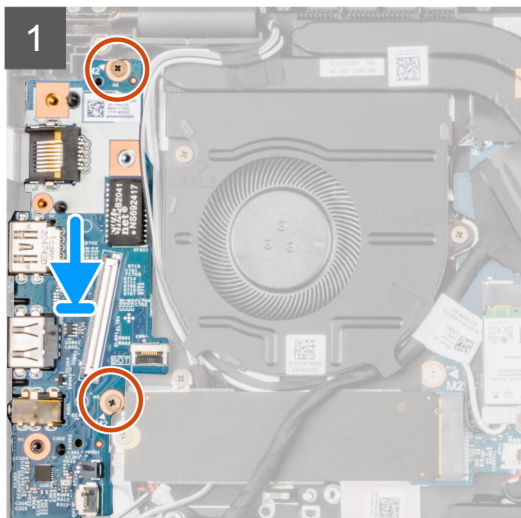
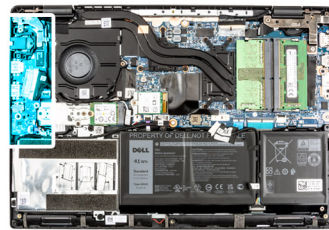
이 노트:

이 노트: 다음 이미지는 전원 버튼이 없는 시스템에 해당됩니다.

다음 이미지는 I/O 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



2x
M2x3



단계

1. I/O 보드를 팜레스트 어셈블리의 해당 슬롯에 맞추어 놓습니다.
2. I/O 보드를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x3 나사를 설치합니다.
3. USB 케이블 및 코인 셀 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
4. I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.
5. 전원 버튼이 함께 제공되는 시스템의 경우 전원 버튼 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫은 다음 접착 테이프를 부착합니다.

다음 단계

1. 이더넷 포트를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 서비스 모드를 종료합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
5. microSD 카드를 설치합니다.
6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

전원 버튼

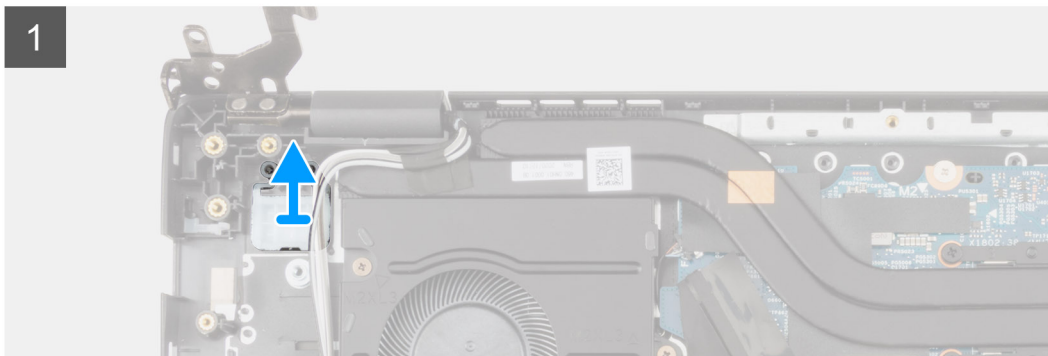
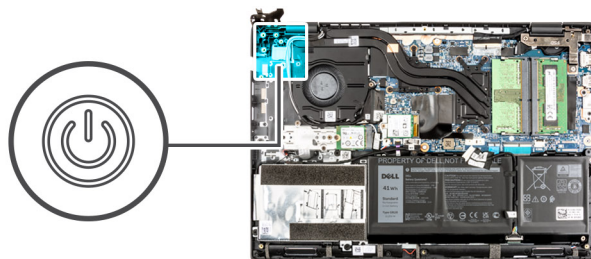
지문 인식기가 없는 전원 버튼 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. I/O 보드를 분리합니다.
7. 이더넷 포트를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 지문 인식기가 장착되지 않은 전원 버튼의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



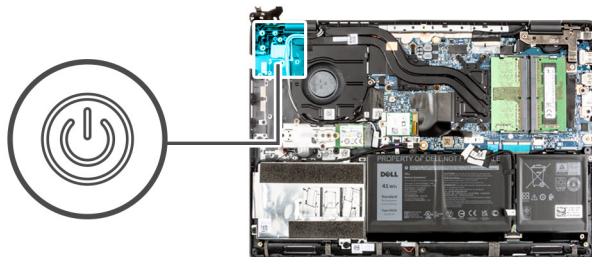
단계

전원 버튼을 팜레스트 어셈블리에서 들어냅니다.

지문 인식기가 없는 전원 버튼 설치

이 작업 정보

다음 이미지는 지문 인식기가 장착되지 않은 전원 버튼의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

전원 버튼을 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 놓습니다.

다음 단계

1. 이더넷 포트를 설치합니다.
2. I/O 보드를 설치합니다.
3. 베이스 커버를 설치합니다.
4. 서비스 모드를 종료합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
6. microSD 카드를 설치합니다.
7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

지문 인식기가 탑재된 전원 버튼 제거

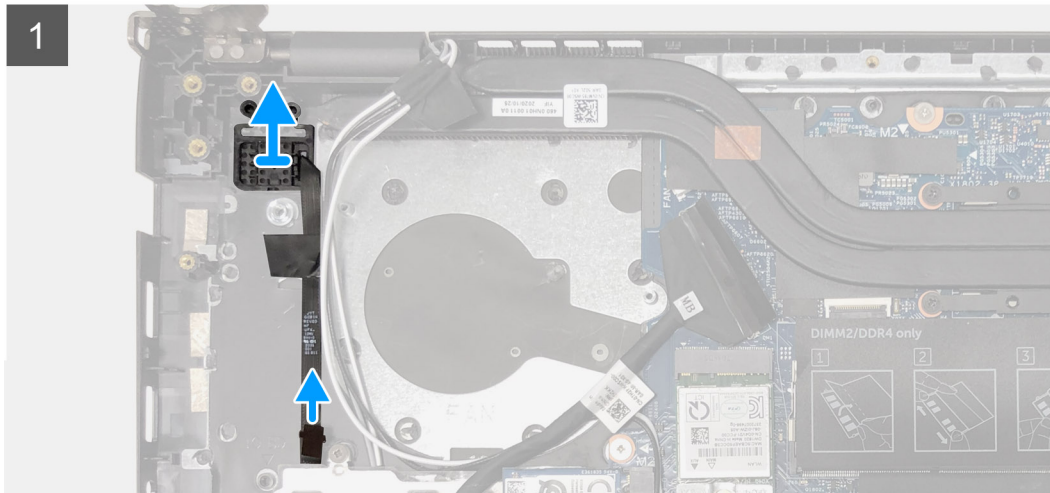
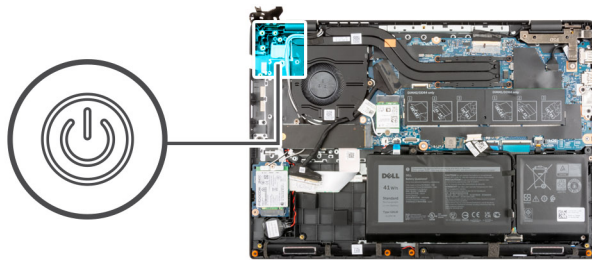
전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. I/O 보드를 분리합니다.
7. 이더넷 포트를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 지문 인식기가 장착된 전원 버튼의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

이 노트: 다음 이미지는 내장형 그래픽 카드와 함께 제공되는 시스템에 해당됩니다. 독립 그래픽 카드에 대한 시스템 보드의 구성은 다릅니다.



단계

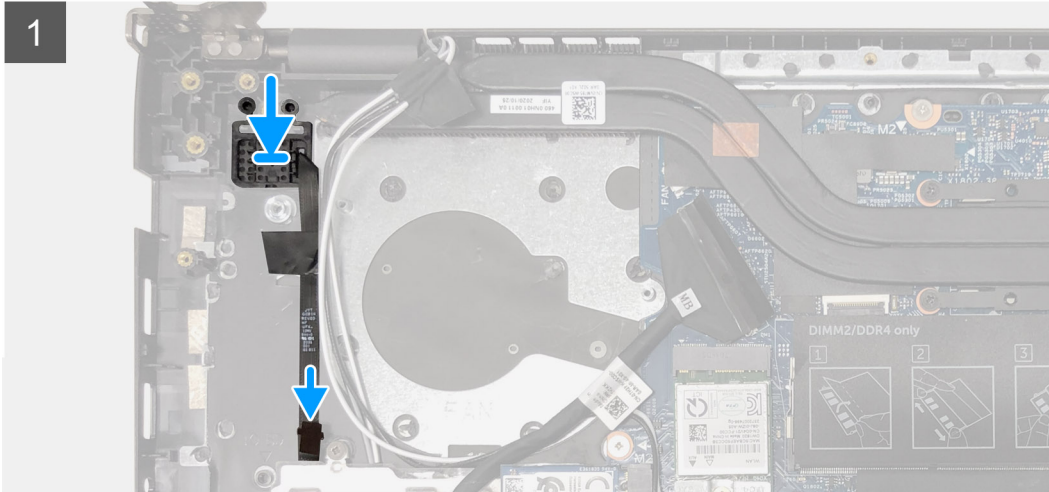
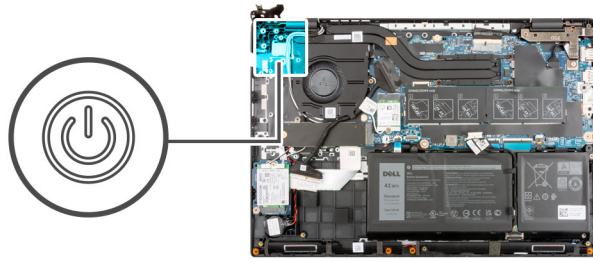
1. 접착 배킹이 있는 전원 버튼 케이블을 팜레스트 어셈블리에서 떼어냅니다.
2. 지문 인식기가 장착된 전원 버튼을 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 분리합니다.

지문 인식기가 장착된 전원 버튼 설치

이 작업 정보

다음 그림은 지문 인식기가 장착된 전원 버튼의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

① 노트: 다음 이미지는 내장형 그래픽 카드와 함께 제공되는 시스템에 해당됩니다. 독립 그래픽 카드에 대한 시스템 보드의 구성은 다릅니다.



단계

1. 접착 배경이 있는 전원 버튼 케이블을 부착합니다.
2. 지문 인식기가 탑재된 전원 버튼을 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.

다음 단계

1. [이더넷 포트](#)를 설치합니다.
2. [I/O 보드](#)를 설치합니다.
3. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
4. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
6. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
7. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

시스템 보드

시스템 보드 제거

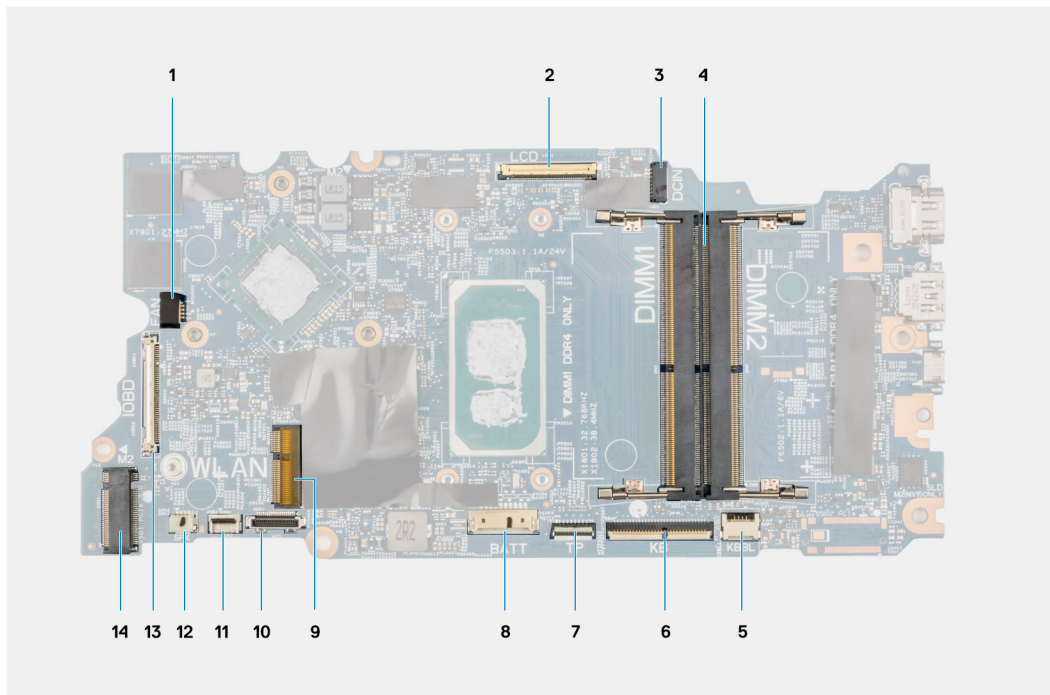
전제조건

1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [베이스 커버](#)를 제거합니다.
5. [배터리](#)를 제거합니다.
6. [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
7. [M.2 SSD](#)를 제거합니다.
8. 하드 디스크 드라이브와 함께 제공된 시스템의 경우 [하드 디스크 드라이브](#)를 제거합니다.
9. [WLAN 카드](#)를 제거합니다.
10. [방열판 어셈블리](#)를 제거합니다.

이 작업 정보

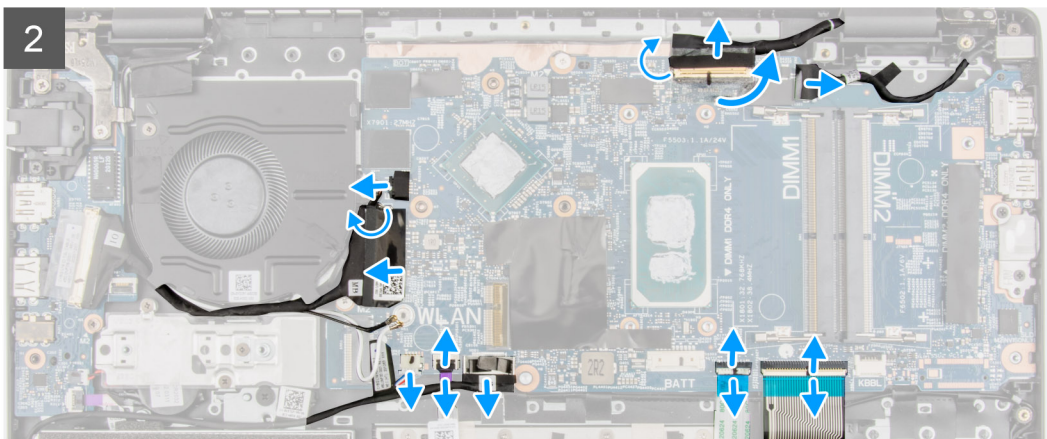
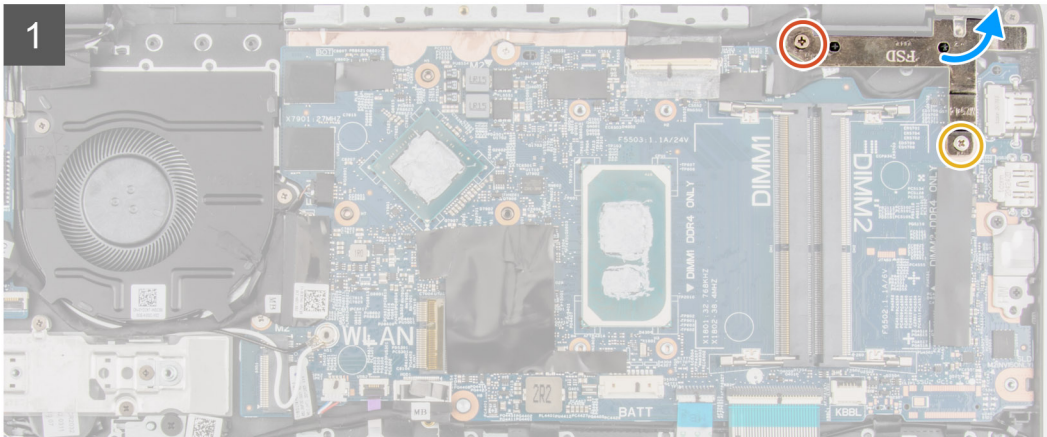
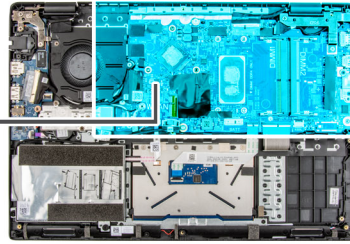
시스템 보드 커넥터

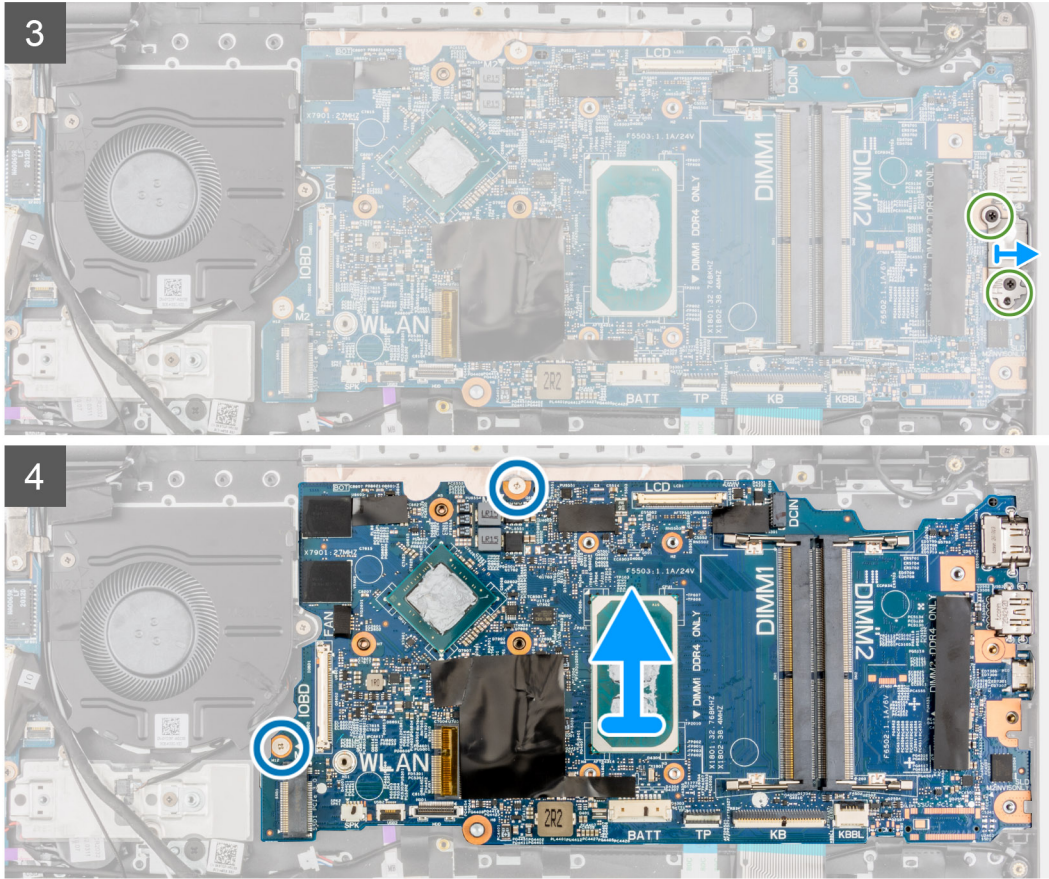
이 노트: 메모리 모듈의 위치는 시스템에 따라 다를 수 있습니다.



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 시스템 팬 케이블 커넥터 | 2. 디스플레이 케이블 커넥터 |
| 3. 전원 어댑터 포트 커넥터 | 4. 메모리 모듈 커넥터 |
| 5. 키보드 백라이트 LED 케이블 커넥터 | 6. 키보드 케이블 커넥터 |
| 7. 터치패드 케이블 커넥터 | 8. 배터리 케이블 커넥터 |
| 9. WLAN 카드 커넥터 | 10. 하드 디스크 드라이브 케이블 커넥터 |
| 11. USB 케이블 커넥터 | 12. 스피커 케이블 커넥터 |
| 13. I/O 케이블 커넥터 | 14. M.2 SSD 커넥터 |

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.





단계

1. 힌지를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 M2.5x6 및 M2.5x4 나사를 제거합니다.
2. 힌지를 위로 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 분리합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN I/O 보드 케이블을 팜레스트 어셈블리에서 떼어냅니다.
4. 스피커 케이블, 전원 어댑터 포트 케이블, 하드 디스크 드라이브 케이블, 시스템 팬 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
5. 래치를 열고 터치패드 케이블, 키보드 케이블 및 USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
6. 접착물을 떼어내고 래치를 연 다음 디스플레이 케이블 및 I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
7. Type-C 브래킷을 제자리에 고정하는 2개의 M2x5 나사를 제거합니다.
8. Type-C 브래킷을 들어 올려 시스템 보드에서 제거합니다.
9. 시스템 보드를 제자리에 고정하는 2개의 M2x2 나사를 제거합니다.
10. 시스템 보드를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

시스템 보드 설치

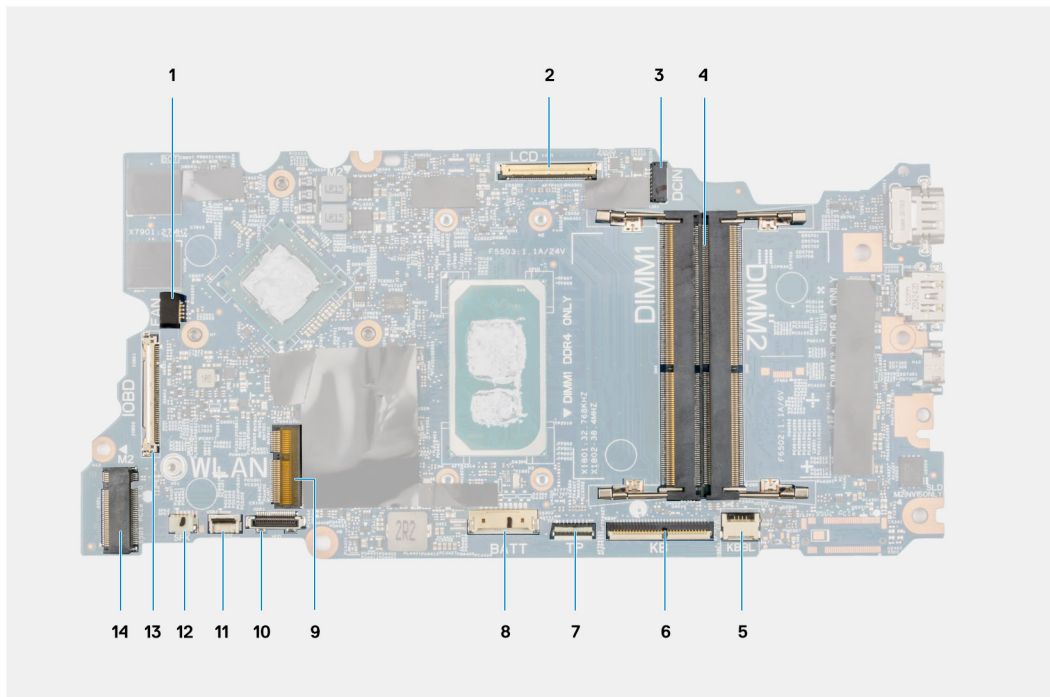
전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

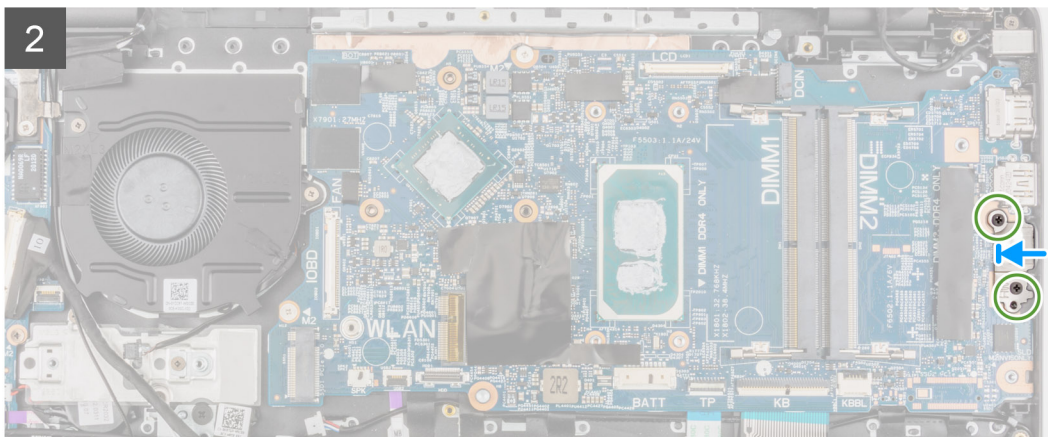
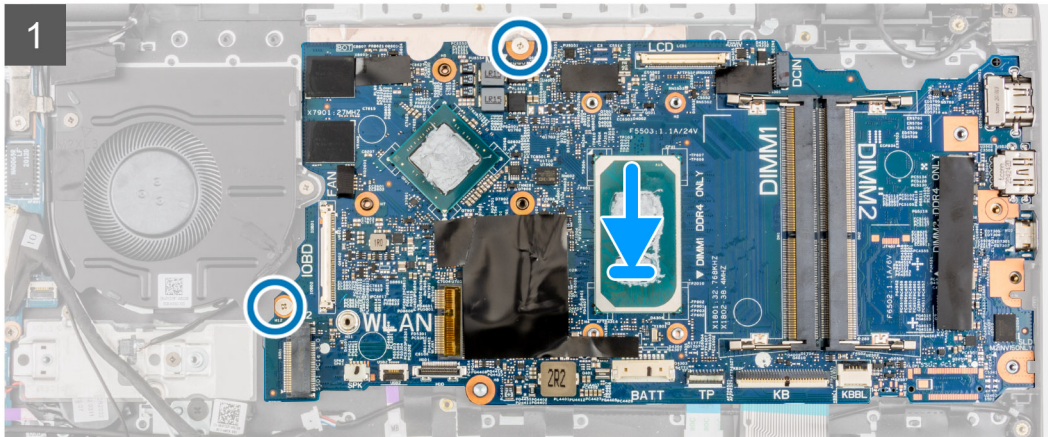
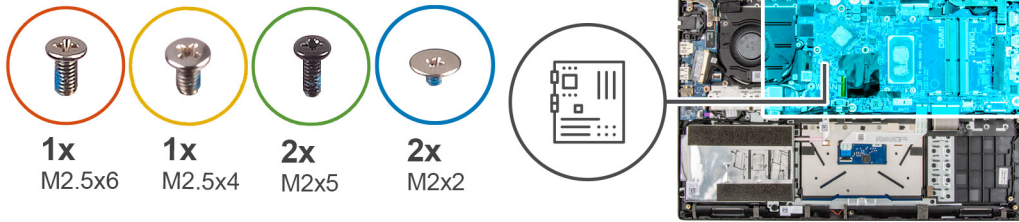
시스템 보드 커넥터

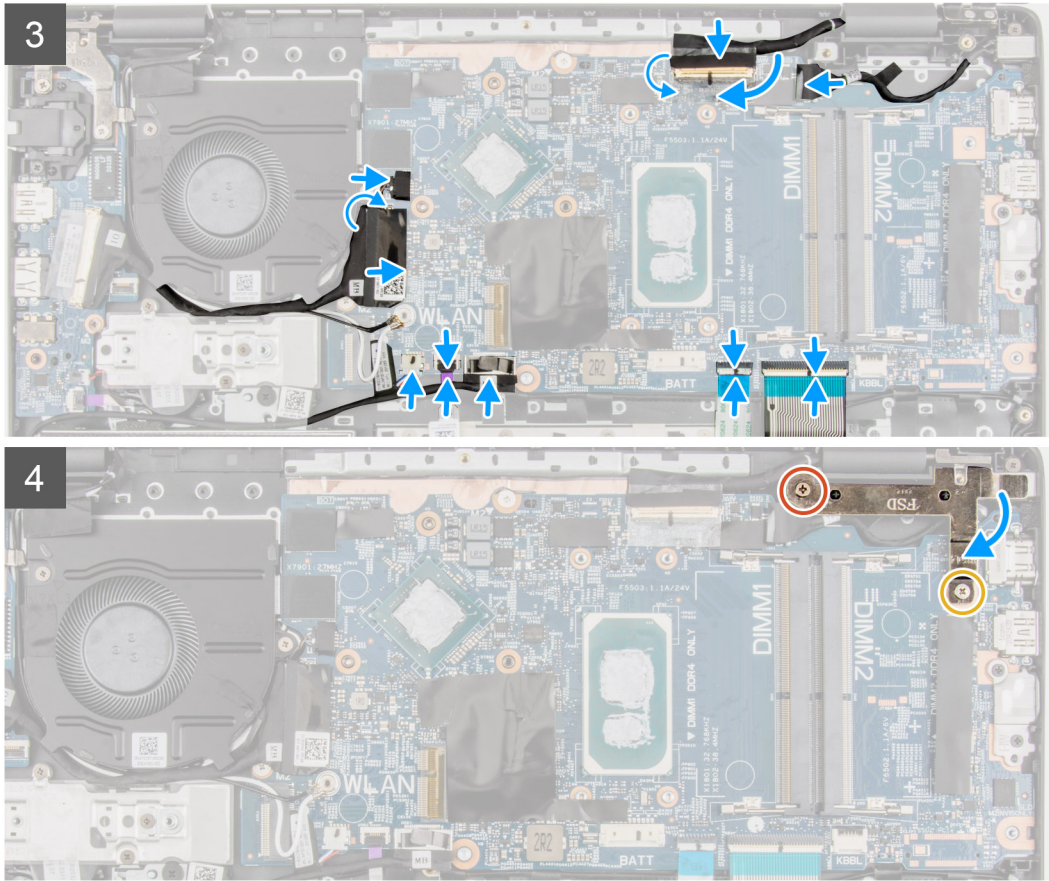
 **노트:** 메모리 모듈의 위치는 시스템에 따라 다를 수 있습니다.



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 시스템 팬 케이블 커넥터 | 2. 디스플레이 케이블 커넥터 |
| 3. 전원 어댑터 포트 커넥터 | 4. 메모리 모듈 커넥터 |
| 5. 키보드 백라이트 LED 케이블 커넥터 | 6. 키보드 케이블 커넥터 |
| 7. 터치패드 케이블 커넥터 | 8. 배터리 케이블 커넥터 |
| 9. WLAN 카드 커넥터 | 10. 하드 디스크 드라이브 케이블 커넥터 |
| 11. USB 케이블 커넥터 | 12. 스피커 케이블 커넥터 |
| 13. I/O 케이블 커넥터 | 14. M.2 SSD 커넥터 |

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.





단계

1. 시스템 보드를 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 2개의 M2x2 나사를 설치하여 시스템 보드를 제자리에 고정합니다.
3. Type-C 브래킷을 시스템 보드에 맞추어 놓습니다.
4. 2개의 M2x5 나사를 설치하여 Type-C 브래킷을 제자리에 고정합니다.
5. 디스플레이 케이블 및 I/O 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫은 다음 접착 테이프를 부착합니다.
6. 터치패드 케이블, 키보드 케이블 및 USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.
7. 스피커 케이블, 전원 어댑터 포트 케이블, 하드 디스크 드라이브 케이블, 시스템 팬 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
8. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN I/O 보드 케이블을 팜레스트 어셈블리에 부착합니다.
9. 힌지를 팜레스트 어셈블리를 향해 아래로 누릅니다.
10. M2.5x6 및 M2.5x4 나사를 설치하여 힌지를 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.

다음 단계

1. 방열판 어셈블리를 설치합니다.
2. WLAN 카드를 설치합니다.
3. 하드 디스크 드라이브와 함께 제공된 시스템의 경우 하드 디스크 드라이브를 설치합니다.
4. M.2 SSD를 설치합니다.
5. 메모리 모듈을 설치합니다.
6. 배터리를 설치합니다.
7. 베이스 커버를 설치합니다.
8. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
9. microSD 카드를 설치합니다.
10. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

스피커

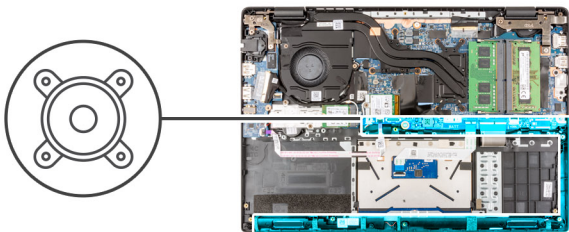
스피커 제거

전제조건

- 1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
- 2. microSD 카드를 제거합니다.
- 3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
- 4. 베이스 커버를 제거합니다.
- 5. 배터리를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 스피커의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

- 1. 하드 디스크 드라이브 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
- 2. 래치를 열고 터치패드 케이블, 키보드 케이블, 키보드 백라이트 LED 케이블 및 USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
- 3. 시스템 보드의 커넥터에서 스피커 케이블을 연결 해제합니다.

4. 스피커 케이블을 팜레스트 어셈블리의 라우팅 가이드에서 라우팅 해제합니다.
5. 접착 테이프를 떼어내고 스피커를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

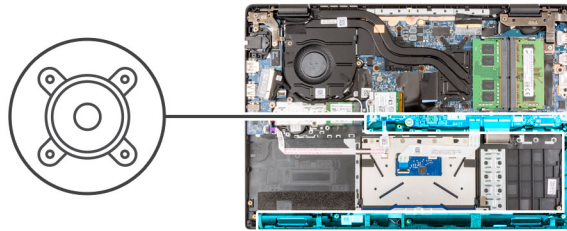
스피커 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 스피커의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 스피커를 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 스피커 케이블을 팜레스트 어셈블리의 라우팅 가이드를 통해 라우팅합니다.
3. 스피커 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
4. 접착 테이프를 부착하여 스피커를 제자리에 고정합니다.
5. 하드 디스크 드라이브 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
6. 터치패드 케이블, 키보드 케이블, 키보드 백라이트 LED 케이블 및 USB 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.

다음 단계

1. 배터리를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
4. microSD 카드를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

터치패드

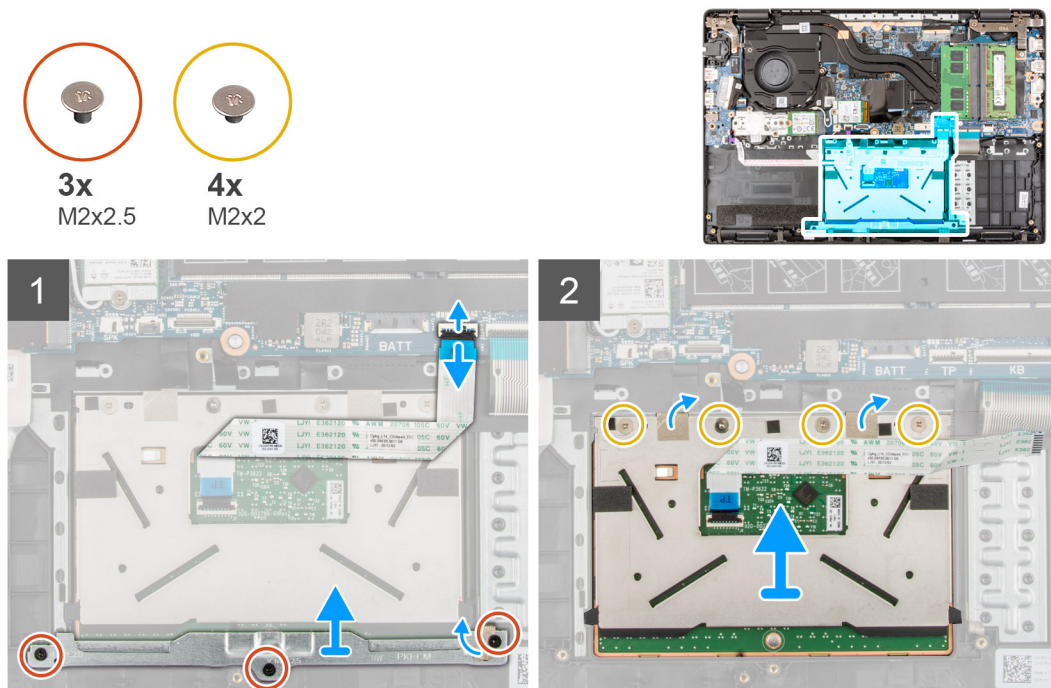
터치패드 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.
5. 배터리를 제거합니다.
6. 스피커를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 터치패드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 래치를 열고 터치패드 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 터치패드 모듈을 제자리에 고정하는 접착 테이프를 떼어냅니다.
3. 터치패드 브래킷을 터치패드 모듈에 고정하는 3개의 M2x2.5 나사를 제거합니다.
4. 터치패드 브래킷을 들어 올려 터치패드 모듈에서 제거합니다.
5. 터치패드 모듈을 팜레스트 어셈블리에 고정하는 4개의 M2x2 나사를 제거합니다.
6. 터치패드 모듈을 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

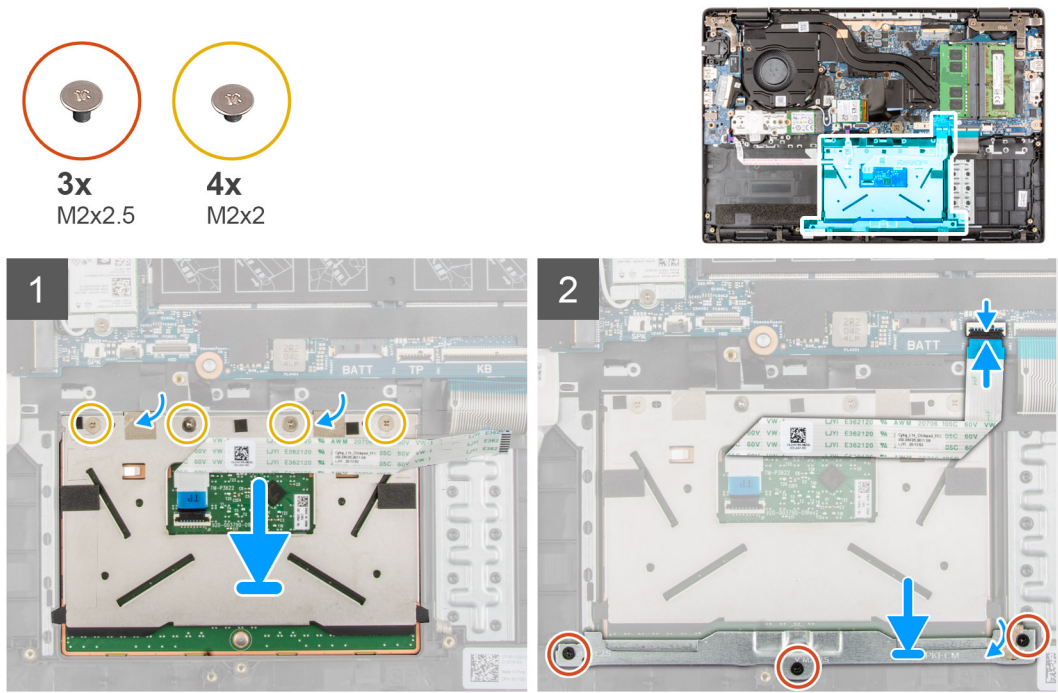
터치패드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 터치패드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 터치패드 모듈을 팜레스트 어셈블리의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 4개의 M2x2 나사를 설치하여 터치패드 모듈을 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.
3. 터치패드 브래킷을 터치패드 모듈에 맞추어 놓습니다.
4. 3개의 M2x2.5 나사를 설치하여 터치패드 브래킷을 터치패드 모듈에 고정합니다.
5. 접착 테이프를 부착하여 터치패드 모듈을 제자리에 고정합니다.
6. 터치패드 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.

다음 단계

1. [스피커](#)를 설치합니다.
2. [배터리](#)를 설치합니다.
3. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
4. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
5. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
6. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

WWAN I/O 보드

WWAN I/O 보드 제거

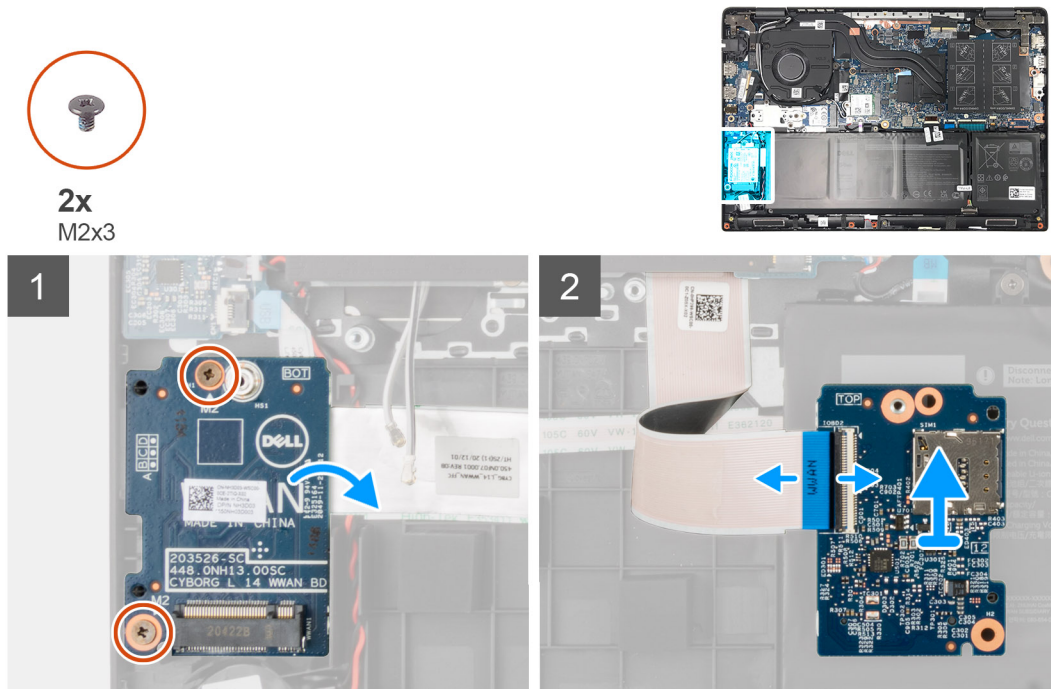
전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.
5. 배터리 케이블을 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 WWAN I/O 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

 **노트:** 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.



단계

1. WWAN I/O 보드를 팜레스트 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x3 나사를 제거합니다.
2. WWAN I/O 보드를 오른쪽으로 조심스럽게 뒤집습니다.
3. 래치를 열고 WWAN 케이블을 WWAN I/O 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
4. WWAN I/O 보드를 들어 올려 팜레스트 어셈블리에서 제거합니다.

WWAN I/O 보드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

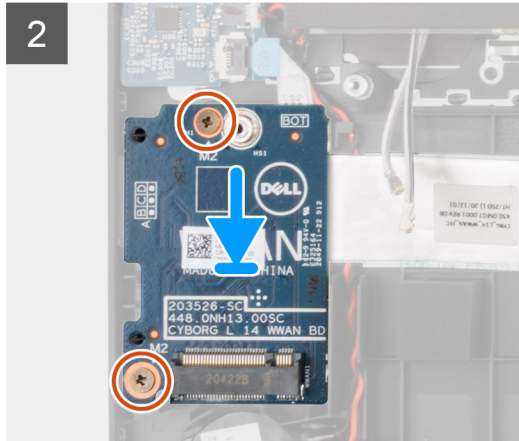
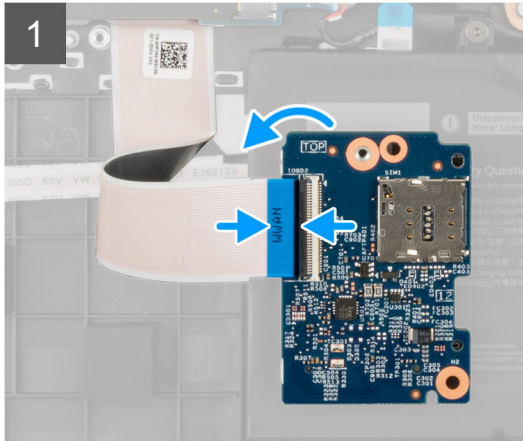
이 작업 정보

다음 이미지는 WWAN I/O 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

이 노트: 다음 단계는 4G LTE 지원 시스템에만 해당됩니다.



2x
M2x3



단계

1. WWAN 케이블을 WWAN I/O 보드의 커넥터에 연결하고 래치를 닫습니다.
2. WWAN I/O 보드를 오른쪽으로 조심스럽게 뒤집습니다.
3. WWAN I/O 보드를 팜레스트 어셈블리의 해당 슬롯에 맞추어 넣습니다.
4. 2개의 M2x3 나사를 설치하여 WWAN I/O 보드를 팜레스트 어셈블리에 고정합니다.

다음 단계

1. 배터리 케이블을 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
4. microSD 카드를 설치합니다.
5. 컴퓨터 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

팜레스트 어셈블리

팜레스트 어셈블리 제거

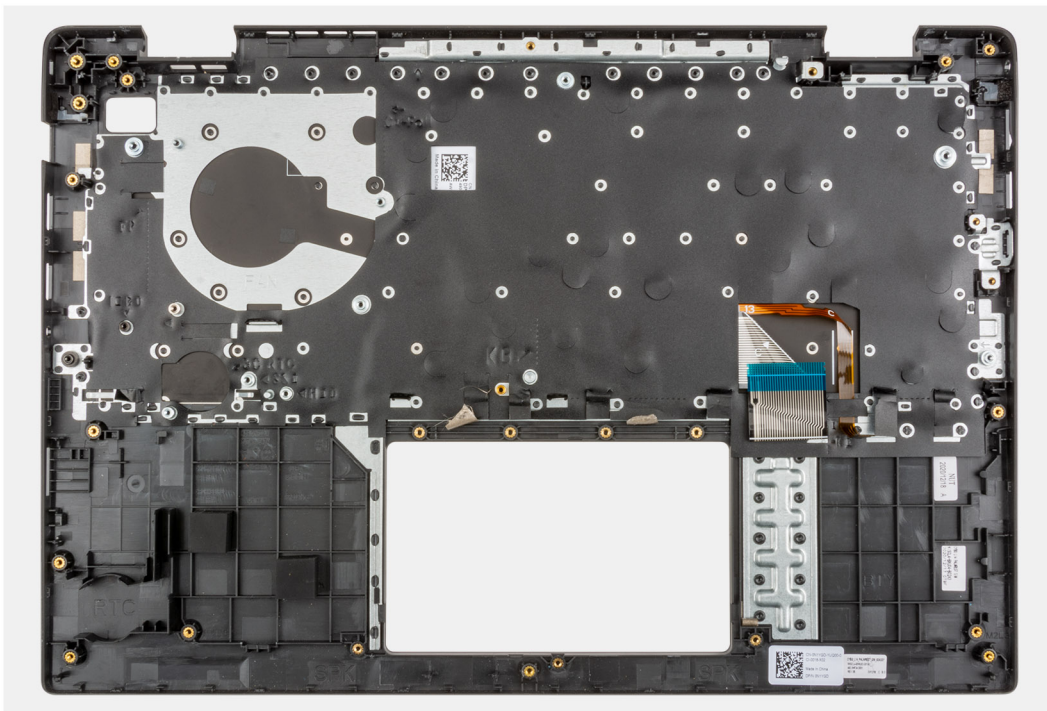
전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 베이스 커버를 제거합니다.
5. 배터리를 제거합니다.
6. 메모리 모듈을 분리합니다.
7. M.2 SSD를 제거합니다.
8. M.2 SSD 변환 브래킷을 제거합니다.
9. M.2 SSD 변환판을 제거합니다.
10. 하드 디스크 드라이브를 제거합니다.

11. WLAN 카드를 제거합니다.
 12. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
 13. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
 14. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
 15. 시스템 팬을 제거합니다.
 16. 방열판 어셈블리를 제거합니다.
 17. 전원 어댑터 포트를 제거합니다.
 18. I/O 보드를 분리합니다.
 19. 코인 셀 배터리를 제거합니다.
 20. USB 케이블을 제거합니다.
 21. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN I/O 보드를 제거합니다.
 22. 시스템 보드를 제거합니다.
- 이 노트:** 방열판과 함께 시스템 보드를 제거할 수 있습니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 팜레스트의 위치를 나타냅니다.



단계

앞 단계를 수행하고 나면 팜레스트 어셈블리가 남습니다.

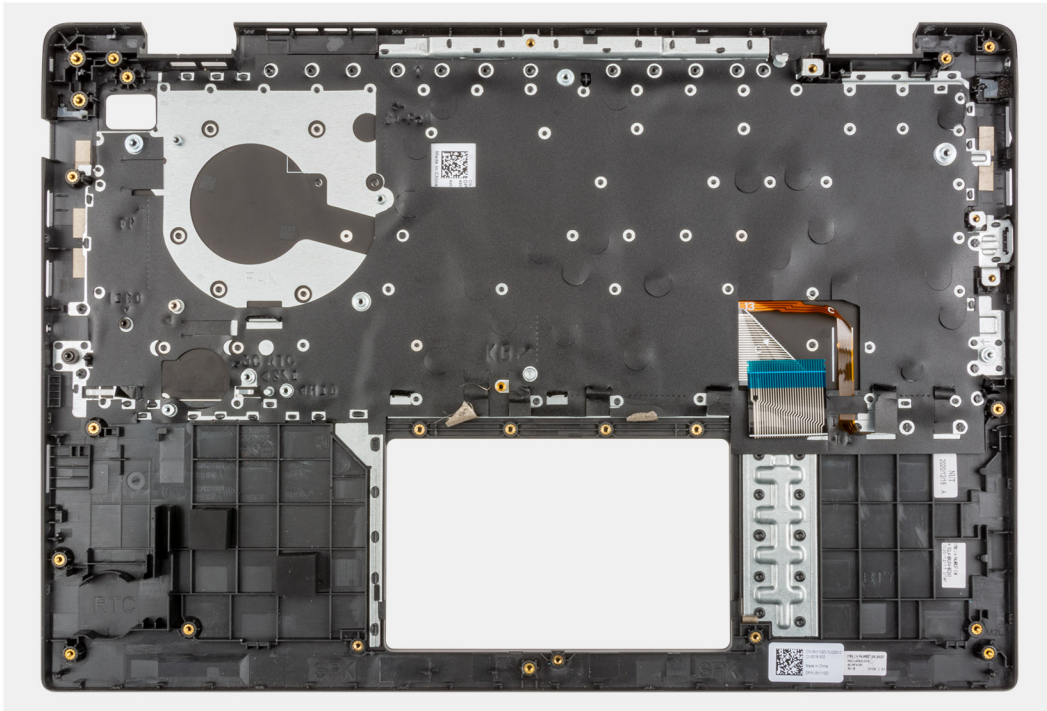
팜레스트 어셈블리 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 팜레스트 어셈블리를 나타냅니다.



단계

다음 단계를 수행하고 나면 팜레스트 어셈블리가 남습니다.

다음 단계

1. 시스템 보드를 설치합니다.
2. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN I/O 보드를 설치합니다.
3. USB 케이블을 설치합니다.
4. 코인 셀 배터리를 설치합니다.
5. I/O 보드를 설치합니다.
6. 전원 어댑터 포트를 설치합니다.
7. 방열판 어셈블리를 설치합니다.
8. 시스템 팬을 설치합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 설치합니다.
10. I/O 보드 케이블을 설치합니다.
11. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 설치합니다.
12. WLAN 카드를 설치합니다.
13. 하드 디스크 드라이브를 설치합니다.
14. M.2 SSD 변환판을 설치합니다.
15. M.2 SSD 변환 브래킷을 설치합니다.
16. M.2 SSD를 설치합니다.
17. 메모리 모듈을 설치합니다.
18. 배터리를 설치합니다.
19. 베이스 커버를 설치합니다.
20. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
21. microSD 카드를 설치합니다.
22. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에 절차를 따릅니다.

카메라

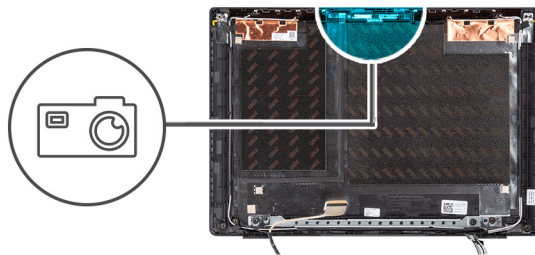
카메라 분리

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. WLAN 카드를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
8. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
10. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
11. 디스플레이 패널을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 카메라의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 카메라 케이블을 카메라 모듈의 커넥터에 고정하는 접착물을 떼어냅니다.
2. 카메라 모듈의 커넥터에서 카메라 케이블을 분리합니다.
3. 카메라 케이블을 디스플레이 후면 커버에서 떼어냅니다.
4. 카메라 모듈을 조심스럽게 들어 올려 디스플레이 후면 커버에서 제거합니다.

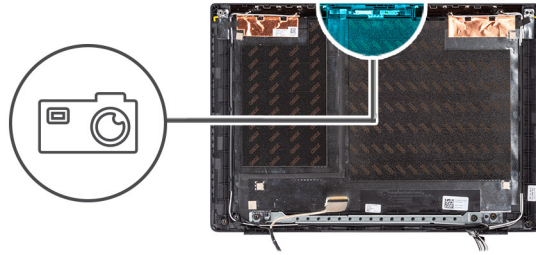
카메라 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 카메라의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 카메라 모듈을 디스플레이 후면 커버의 슬롯에 맞추어 넣습니다.
2. 카메라 케이블을 카메라 모듈의 커넥터에 연결합니다.
3. 접착 테이프를 부착하여 카메라 케이블을 카메라 모듈의 커넥터에 고정합니다.
4. 카메라 케이블을 디스플레이 후면 커버에 맞추어 부착합니다.

다음 단계

1. [디스플레이 패널](#)을 설치합니다.
2. [디스플레이 베젤](#)을 설치합니다.
3. [디스플레이 어셈블리](#)를 설치합니다.
4. [I/O 보드 케이블](#)을 설치합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [WWAN 카드](#)를 설치합니다.
6. [WLAN 카드](#)를 설치합니다.
7. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
8. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
9. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
10. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
11. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

디스플레이 케이블

디스플레이 케이블 제거

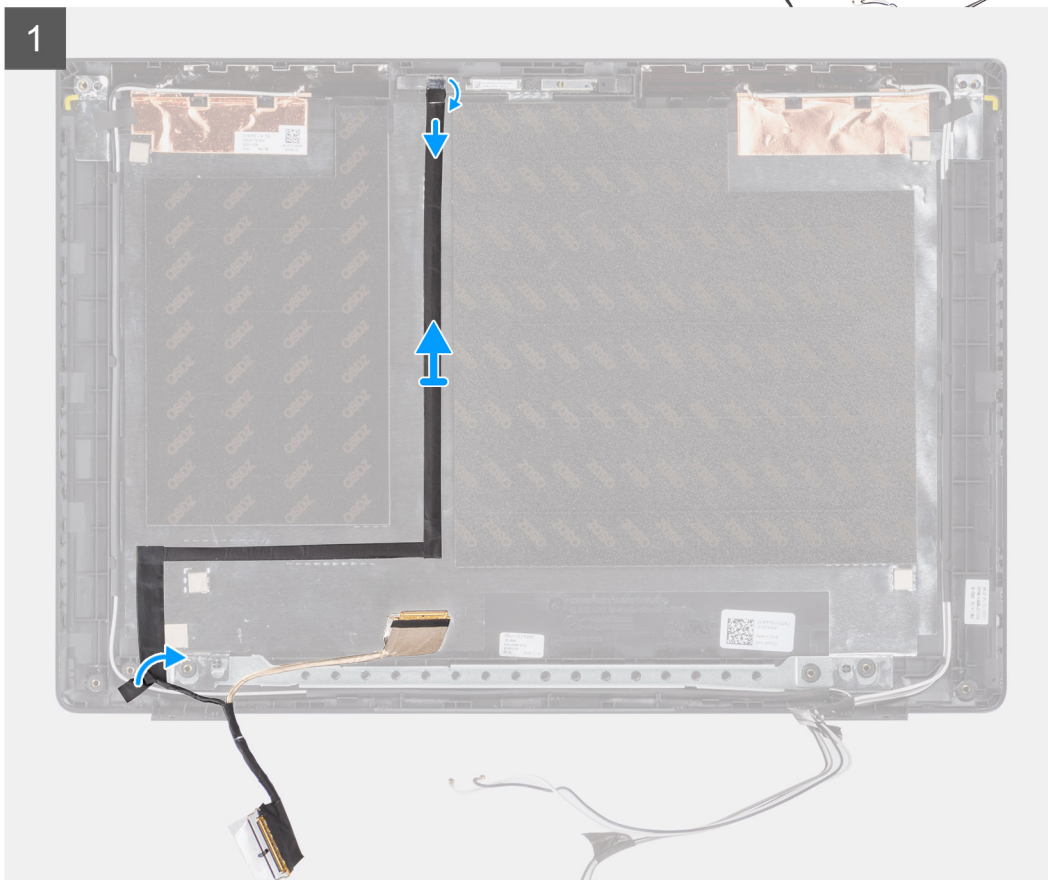
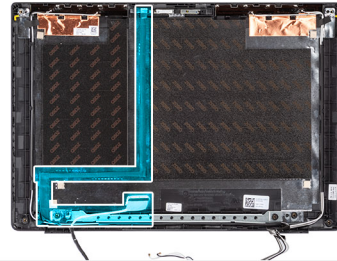
전제조건

1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. [microSD 카드](#)를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 제거합니다.
4. [서비스 모드](#)로 전환합니다.
5. [베이스 커버](#)를 제거합니다.
6. [WLAN 카드](#)를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [WWAN 카드](#)를 제거합니다.

8. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
10. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
11. 디스플레이 패널을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 케이블의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
2. 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널의 커넥터에서 연결 해제합니다.
3. 디스플레이 케이블을 카메라 모듈의 커넥터에서 연결 해제합니다.

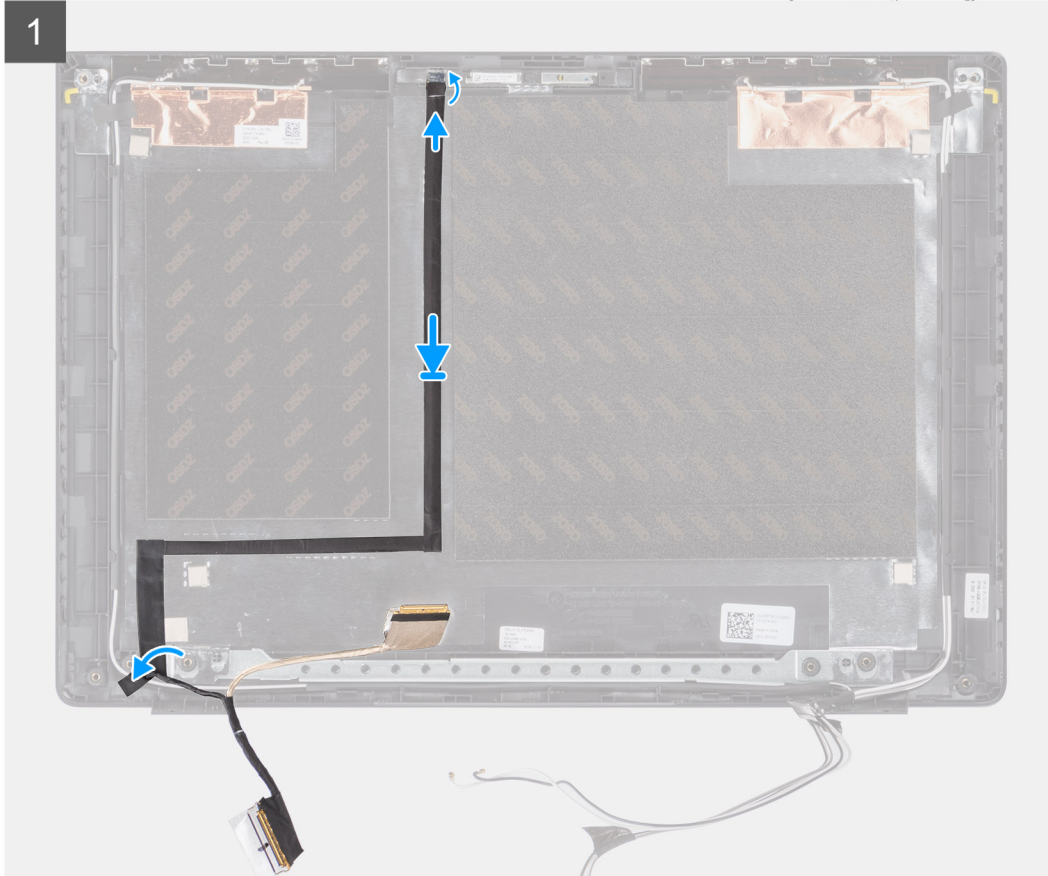
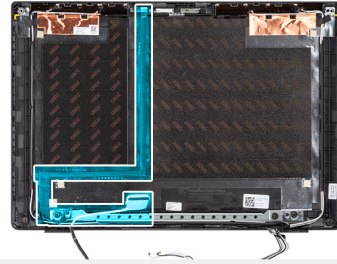
디스플레이 케이블 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 케이블의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 디스플레이 케이블을 카메라 모듈의 커넥터에 연결합니다.
2. 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널의 커넥터에 연결합니다.
3. 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. 디스플레이 패널을 설치합니다.
2. 디스플레이 베젤을 설치합니다.
3. 디스플레이 어셈블리를 설치합니다.
4. I/O 보드 케이블을 설치합니다.
5. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 설치합니다. .
6. WLAN 카드를 설치합니다.
7. 베이스 커버를 설치합니다.
8. 서비스 모드를 종료합니다.
9. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 설치합니다.
10. microSD 카드를 설치합니다.
11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

디스플레이 후면 커버

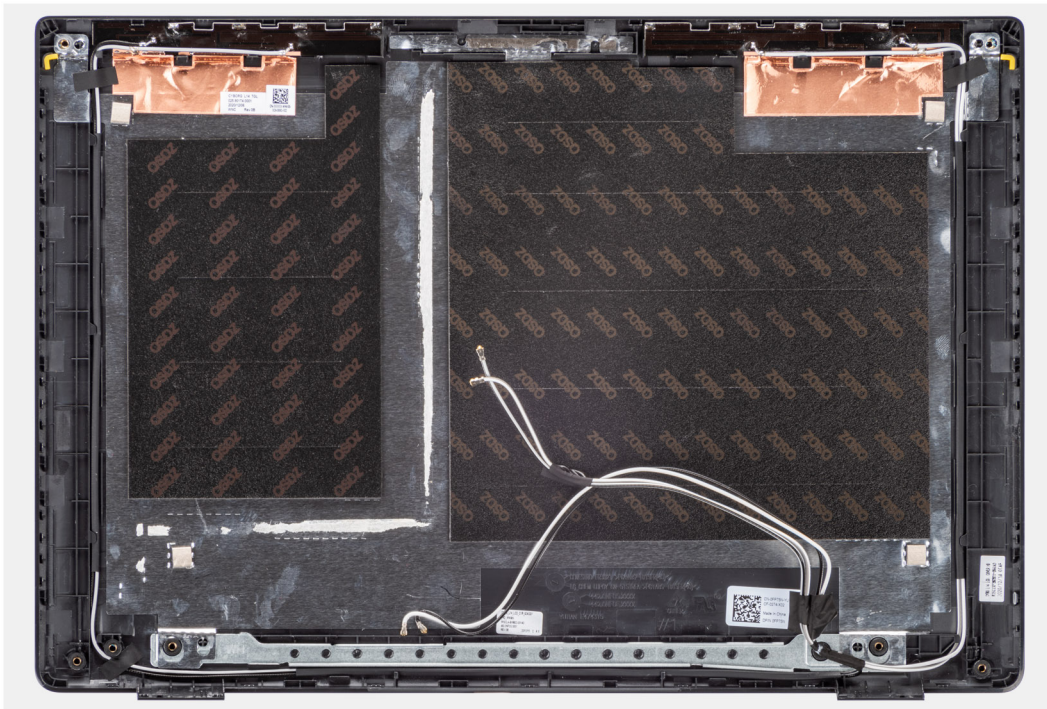
디스플레이 후면 커버 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. microSD 카드를 제거합니다.
3. 4G LTE 지원 시스템의 경우 SIM 카드 트레이를 제거합니다.
4. 서비스 모드로 전환합니다.
5. 베이스 커버를 제거합니다.
6. WLAN 카드를 제거합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 WWAN 카드를 제거합니다.
8. I/O 보드 케이블을 제거합니다.
9. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
10. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
11. 디스플레이 패널을 분리합니다.
12. 카메라를 분리합니다.
13. 디스플레이 케이블을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 후면 커버의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

앞 단계를 수행하고 나면 베이스 커버 어셈블리가 남습니다.

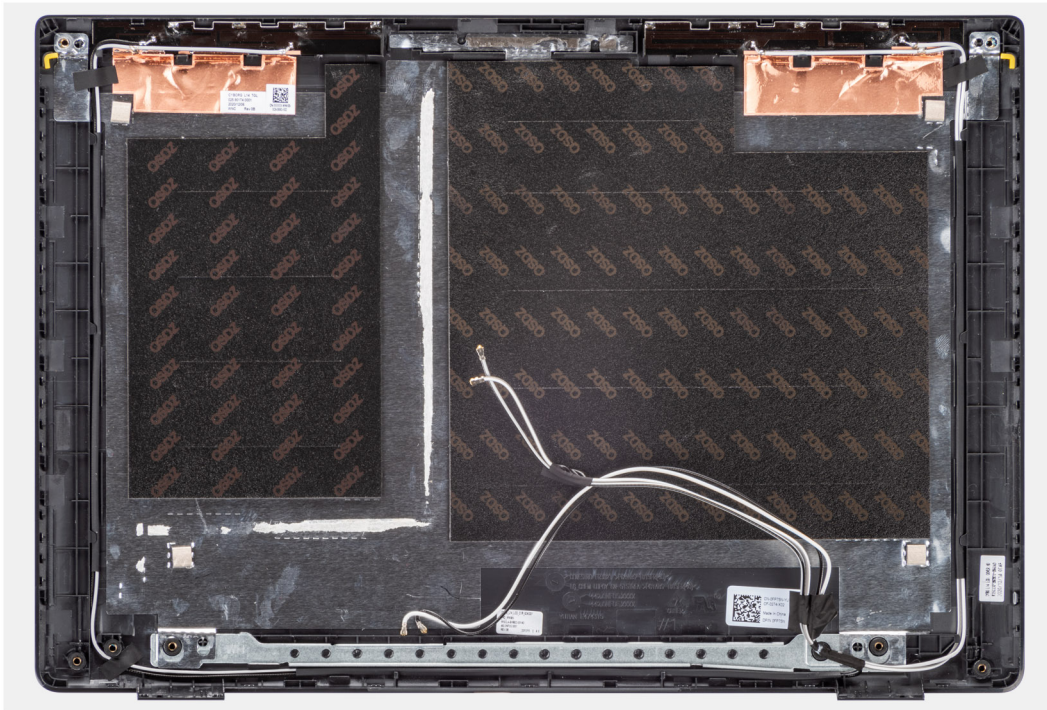
디스플레이 후면 커버 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 후면 커버의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

다음 단계를 수행하고 나면 베이스 커버 어셈블리가 남습니다.

다음 단계

1. [디스플레이 케이블](#)을 설치합니다.
2. [카메라](#)를 설치합니다.
3. [디스플레이 패널](#)을 설치합니다.
4. [디스플레이 베젤](#)을 설치합니다.
5. [디스플레이 어셈블리](#)를 설치합니다.
6. [I/O 보드 케이블](#)을 설치합니다.
7. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [WWAN 카드](#)를 설치합니다. .
8. [WLAN 카드](#)를 설치합니다.
9. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
10. [서비스 모드](#)를 종료합니다.
11. 4G LTE 지원 시스템의 경우 [SIM 카드 트레이](#)를 설치합니다.
12. [microSD 카드](#)를 설치합니다.
13. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

드라이버 및 다운로드

드라이버의 문제를 해결하거나 드라이버를 다운로드 또는 설치하는 경우 Dell 기술 자료 문서, 드라이버 및 다운로드 FAQ [000123347](#)을 숙지하는 것이 좋습니다.

BIOS 설정

△ 주의: 컴퓨터 전문가가 아닌 경우 BIOS 설정 프로그램의 설정을 변경하지 마십시오. 일부 변경 시 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

① 노트: 컴퓨터 및 장착된 디바이스에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시될 수도 있고, 표시되지 않을 수도 있습니다.

① 노트: BIOS 설정 프로그램을 변경하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 BIOS 설정 프로그램 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

BIOS 설정 프로그램은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

- 컴퓨터에 설치된 하드웨어의 정보 찾기(예: RAM 용량, 하드 드라이브 크기 등)
- 시스템 구성 정보를 변경합니다.
- 사용자 암호, 설치된 하드 드라이브 유형, 기본 디바이스 활성화 또는 비활성화와 같은 사용자 선택 옵션 설정 또는 변경

BIOS 개요

BIOS는 하드 디스크, 비디오 어댑터, 키보드, 마우스 및 프린터와 같은 컴퓨터의 운영 체제 및 연결된 장치 사이에서 일어나는 데이터 흐름을 관리합니다.

BIOS 설정 프로그램 시작하기

단계

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. BIOS 설정 프로그램을 시작하려면 즉시 <F2> 키를 누릅니다.

① 노트: 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 끄고 다시 시도하십시오.

탐색 키

① 노트: 대부분의 변경한 시스템 설정 옵션과 변경 사항은 기록되지만, 시스템을 다시 시작하기 전까지는 적용되지 않습니다.

표 4. 탐색 키

키	탐색기
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.
Enter	선택한 필드에서 값을 선택하거나(해당하는 경우) 필드의 링크로 이동합니다.
스페이스바	드롭다운 목록(있는 경우)을 확장하거나 축소합니다.
탭	다음 작업 영역으로 이동합니다. ① 노트: 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.
<Esc> 키	기본 화면이 보일 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 기본 화면에서 Esc 키를 누르면 저장하지 않은 변경 사항을 저장하고 시스템을 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.

원타임 부팅 메뉴

one time boot menu를 입력하려면 컴퓨터를 켜 다음 즉시 <F12> 키를 누릅니다.

이 노트: 컴퓨터가 켜져 있을 경우 컴퓨터를 종료하는 것이 좋습니다.

부팅할 수 있는 장치가 진단 옵션과 함께 원타임 부팅 메뉴에 표시됩니다. 부팅 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

- 이동식 드라이브(사용 가능한 경우)
- STXXXX 드라이브(사용 가능한 경우)
이 노트: XXX는 SATA 드라이브 번호를 표시합니다.
- 옵티컬 드라이브(사용 가능한 경우)
- SATA 하드 드라이브(사용 가능한 경우)
- 진단

시스템 설정에 액세스하기 위한 옵션도 부트 순서 화면에 표시됩니다.

시스템 설치 옵션

이 노트: 시스템이나 설치된 디바이스에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시되거나 표시되지 않을 수도 있습니다.

표 5. 시스템 설치 옵션- 시스템 정보 메뉴

개요	
Latitude 3420	
BIOS 버전	BIOS 버전 번호를 표시합니다.
서비스 태그	시스템의 서비스 태그를 표시합니다.
자산 태그	시스템의 자산 태그를 표시합니다.
Manufacture Date	시스템의 제조 날짜를 표시합니다.
Ownership Date	시스템의 소유권 날짜를 표시합니다.
익스프레스 서비스 코드	시스템의 익스프레스 서비스 코드를 표시합니다.
소유권 태그	시스템의 소유권 태그를 표시합니다.
서명된 펌웨어 업데이트	시스템에 있는 서명된 펌웨어 업데이트의 활성화 여부를 표시합니다.
Battery Information	
기본	주 배터리를 표시합니다.
배터리 레벨	시스템의 배터리 잔량을 표시합니다.
배터리 상태	시스템의 배터리 상태를 표시합니다.
상태	시스템의 배터리 노화 상태를 표시합니다.
AC 어댑터	AC 어댑터의 연결 여부를 표시합니다.
프로세서 정보	
프로세서 유형	프로세서 유형을 표시합니다.
최대 클럭 속도	프로세서의 최대 클럭 속도를 표시합니다.
최소 클럭 속도	프로세서의 최소 클럭 속도를 표시합니다.
현재 클럭 속도	프로세서의 현재 클럭 속도를 표시합니다.
코어 개수	프로세서의 코어 수를 표시합니다.
Processor ID	프로세서 확인 코드를 표시합니다.
프로세서 L2 캐시	프로세서 L2 캐시 크기를 표시합니다.
프로세서 L3 캐시	프로세서 L3 캐시 크기를 표시합니다.

표 5. 시스템 설치 옵션- 시스템 정보 메뉴 (계속)

개요	
마이크로코드 버전	마이크로코드 버전을 표시합니다.
인텔 하이퍼 스레딩 지원	프로세서가 HT(Hyper-Threading)를 지원하는지 여부를 표시합니다.
64비트 기술	64비트 기술을 사용하는지 여부를 표시합니다.
메모리 정보	
Memory Installed	설치된 총 시스템 메모리를 표시합니다.
Memory Available	사용할 수 있는 총 시스템 메모리를 표시합니다.
메모리 속도	메모리 속도를 표시합니다.
Memory Channel Mode	단일 모드 또는 듀얼 채널 모드를 표시합니다.
Memory Technology	메모리에 사용된 기술을 표시합니다.
DIMM 슬롯 1	DIMM 슬롯 정보를 표시합니다.
DIMM 슬롯 2	DIMM 슬롯 정보를 표시합니다.
디바이스 정보	
Panel Type	시스템의 패널 유형을 표시합니다.
비디오 컨트롤러	시스템의 비디오 컨트롤러 유형을 표시합니다.
비디오 메모리	시스템의 비디오 메모리 정보를 표시합니다.
Wi-Fi 디바이스	시스템의 무선 디바이스 정보를 표시합니다.
Native Resolution	시스템의 기본 해상도를 표시합니다.
Video BIOS Version	시스템의 비디오 BIOS 버전을 표시합니다.
Audio Controller	시스템의 오디오 컨트롤러 정보를 표시합니다.
Bluetooth 디바이스	시스템의 Bluetooth 디바이스 정보를 표시합니다.
LOM MAC 주소	시스템의 LOM(LAN On Motherboard) MAC 주소를 표시합니다.
패스스루 MAC 주소	시스템의 패스스루 MAC 주소를 표시합니다.
셀룰러 디바이스	시스템의 M.2 PCIe SSD 정보를 표시합니다.
dGPU 비디오 컨트롤러(독립 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	비디오 컨트롤러 정보를 표시합니다.

표 6. 시스템 설정 옵션 - 부팅 구성 메뉴

부팅 구성	
부트 순서	
Boot Mode(부팅 모드)	부팅 모드를 표시합니다. ① 노트: 레거시 부팅 모드는 이 플랫폼에서 지원되지 않습니다.
부트 순서	부트 순서를 표시합니다.
보안 디지털(SD) 카드 부팅	SD 카드 읽기 전용 부팅을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 SD(Secure Digital) 카드 부팅 옵션은 활성화되어 있지 않습니다.
보안 부팅	
보안 부팅 활성화	보안 부팅 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
보안 부팅 모드	보안 부팅 모드 옵션을 수정할 수 있습니다. 기본적으로 배포 모드 는 활성화되어 있습니다. 기본적으로 감사 모드 는 비활성화되어 있습니다.

표 6. 시스템 설정 옵션 - 부팅 구성 메뉴 (계속)

부팅 구성	
Expert Key Management	
Enable Custom Mode	사용자 지정 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 사용자 지정 모드 옵션은 활성화되어 있지 않습니다.
사용자 지정 모드 키 관리	전문 키 관리에 대한 사용자 지정 값을 선택할 수 있습니다.

표 7. 시스템 설정 옵션 - 내장형 디바이스 메뉴

내장형 장치	
Date/Time	현재 날짜를 MM/DD/YYYY 형식으로 표시하고 현재 시간을 HH:MM:SS AM/PM 형식으로 표시합니다.
카메라	카메라를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 카메라 활성화 옵션이 선택되어 있습니다.
오디오	
Enable Audio(오디오 사용)	통합형 오디오 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 오디오 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다. 기본적으로 마이크 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다. 기본적으로 내부 스피커 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다.
USB Configuration	- 외부 USB 포트에 연결된 USB 대용량 스토리지 디바이스에서의 부팅을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 외부 USB 포트 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다. - USB 대용량 스토리지 디바이스(예: 외부 하드 드라이브, 옵티컬 드라이브 및 USB 드라이브)에서의 부팅을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 USB 부팅 지원 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다.
USB4 PCIe 터널링 비활성화 (독립 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	USB4 PCIe 터널링 옵션을 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
비디오/전원 전용 Type-C 포트 (독립 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	Type-C 포트 기능을 비디오 또는 전원 전용으로 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Type-C 포트의 비디오/전원 전용 옵션은 비활성화되어 있습니다.

표 8. 시스템 설정 옵션 - 스토리지 메뉴

스토리지	
SATA/NVMe 작동	
SATA/NVMe 작동	내장형 스토리지 디바이스 컨트롤러의 운영 모드를 설정합니다. 기본적으로 RAID 켜짐 옵션은 활성화되어 있습니다.
스토리지 인터페이스	
포트 활성화	이 페이지를 사용하여 온보드 드라이브를 활성화할 수 있습니다. 기본적으로 SATA-1 옵션은 활성화되어 있습니다. 기본적으로 M.2 PCIe SSD-1 옵션은 활성화되어 있습니다.
SMART 보고	
Enable SMART Reporting(SMART 보고 사용)	시스템 시작 중에 자체 모니터링, 분석 및 보고 기술(SMART)를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 SMART 보고 활성화 옵션은 비활성화되어 있습니다.
드라이브 정보	

표 8. 시스템 설정 옵션 - 스토리지 메뉴 (계속)

스토리지	
SATA-1	
유형	시스템의 SATA 유형 정보를 표시합니다.
장치	시스템의 SATA 디바이스 정보를 표시합니다.
M.2 PCIe SSD-1	
유형	시스템의 M.2 PCIe SSD 유형 정보를 표시합니다.
장치	시스템의 M.2 PCIe SSD 디바이스 정보를 표시합니다.
하드 드라이브 자유 낙하 보호 사용	
하드 드라이브 자유 낙하 보호 사용	하드 드라이브 자유 낙하 보호 기능을 활성화할 수 있습니다. 기본적으로 하드 드라이브 자유 낙하 보호 활성화 옵션이 선택되어 있습니다.
Enable MediaCard	
	읽기 전용 상태의 미디어 카드를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 SD(Secure Digital) 카드 옵션은 활성화되어 있습니다.

표 9. 시스템 설정 옵션 - 디스플레이 메뉴

디스플레이	
디스플레이 밝기	
배터리 전원 밝기	배터리 전원으로 작동하는 중인 시스템의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
AC 전원 밝기	AC 전원으로 작동하는 중인 시스템의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
터치스크린	
	운영 체제에 대해 터치스크린을 활성화하거나 비활성화합니다. 터치스크린은 이 설정에 관계 없이 항상 BIOS 설정에서 작동합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.
EcoPower	
EcoPower 활성화	EcoPower 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.
전체 화면 로고	
	전체 화면 로고를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.

표 10. 시스템 설정 옵션 - 연결 메뉴

연결	
네트워크 컨트롤러 구성	
Integrated NIC	활성화된 경우 UEFI 네트워크 프로토콜이 설치되어 사용 가능하므로 사전 OS 및 조기 OS 네트워킹 기능이 활성화된 NIC를 모두 사용할 수 있습니다. 기본적으로 PXE로 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다.
무선 디바이스 활성화	
WWAN/GPS (내장 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	내부 WWAN/GPS 디바이스를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
WLAN	내부 WLAN 디바이스를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Bluetooth	내부 Bluetooth 디바이스를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Enable UEFI Network Stack	
	UEFI 네트워크 스택을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 UEFI 네트워크 스택 활성화 옵션은 활성화되어 있습니다.

표 10. 시스템 설정 옵션 - 연결 메뉴 (계속)

연결	
Wireless Radio Control	
WLAN 라디오 제어	유선 네트워크에 대한 시스템의 연결을 감지하고 이후에 선택된 무선 라디오 (WLAN)를 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
WWAN 라디오 제어	유선 네트워크에 대한 시스템의 연결을 감지하고 이후에 선택된 무선 라디오 (WWAN)를 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
HTTP 부팅 기능 (독립 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	
HTTP 부팅	HTTP 부팅 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 HTTP 부팅 옵션은 활성화되어 있습니다.

표 11. 시스템 설정 옵션 - 전원 메뉴

전원	
배터리 구성	피크 전원 사용 시간 동안 시스템을 배터리로 작동할 수 있습니다. 각 요일의 특정 시간 사이에 AC 전원 사용을 방지하려면 사용자 지정 충전 시작 및 사용자 지정 충전 중지 표를 사용합니다. 기본적으로 적용 옵션이 활성화되어 있습니다.
고급 구성	
고급 배터리 충전 구성 활성화	고급 배터리 충전 구성을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 고급 배터리 충전 구성 활성화 옵션은 비활성화되어 있습니다.
Peak Shift	피크 전원 사용 시간 동안 시스템을 배터리로 작동할 수 있습니다.
Enable Peak Shift(피크 전이 활성화)	기본적으로 피크 전이 활성화 옵션은 비활성화되어 있습니다.
USB PowerShare	
USB PowerShare 사용	USB PowerShare를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 USB PowerShare 활성화 옵션은 비활성화되어 있습니다.
열 관리	팬을 냉각하고 프로세서 열 관리를 활성화하여 시스템 성능, 소음 및 온도를 조정합니다. 기본적으로 최적화 옵션이 활성화되어 있습니다.
USB 대기 모드 해제 지원	
USB 대기 모드 해제 지원 활성화	USB 재개 지원을 활성화합니다. 기본적으로 USB 재개 지원 활성화 옵션은 비활성화되어 있습니다.
Dell USB-C 도킹 시 절전 모드 해제	활성화 시 Dell USB-C Dock를 연결하면 시스템이 대기 상태에서 재개됩니다. 기본적으로 Dell USB-C 도킹 시 절전 해제 옵션이 활성화되어 있습니다.
Block Sleep	운영 체제의 절전(S3) 모드로 전환되지 않게 차단할 수 있습니다. 기본적으로 Block Sleep(절전 차단) 옵션은 비활성화되어 있습니다.
덮개 스위치	덮개 스위치를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 덮개 스위치 옵션은 활성화되어 있습니다.
Power On Lid Open	덮개가 열릴 때 시스템이 꺼짐 상태에서 켜지도록 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 덮개를 열어 전원 켜기 옵션은 활성화되어 있습니다.

표 11. 시스템 설정 옵션 - 전원 메뉴 (계속)

전원	
인텔 Speed Shift Technology	인텔 스피드 시프트 기술 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 인텔 스피드 시프트 기술 옵션은 활성화되어 있습니다.

표 12. 시스템 설치 옵션—보안 메뉴

보안	
TPM 2.0 보안	
TPM 2.0 Security On	TPM 2.0 보안 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 TPM 2.0 보안 켜기 옵션은 활성화되어 있습니다.
활성화된 명령의 PPI 무시	TPM PPI(Physical Presence Interface)를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 활성화 명령의 PPI 무시 옵션은 비활성화되어 있습니다.
비활성화된 명령의 PPI 무시	TPM PPI(Physical Presence Interface)를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 비활성화 명령의 PPI 무시 옵션은 비활성화되어 있습니다.
증명 활성화	운영 체제에 대한 TPM(Trusted Platform Module) 인증 계층 사용 가능 여부를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 증명 활성화 옵션이 활성화되어 있습니다.
키 스토리지 활성화	운영 체제에 대한 TPM(Trusted Platform Module) 스토리지 계층 사용 가능 여부를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 키 스토리지 활성화 옵션이 활성화되어 있습니다.
SHA-256	BIOS 부팅 중 BIOS 및 TPM이 SHA-256 해시 알고리즘을 사용하여 측정을 TPM PCR로 확장합니다. 기본적으로 SHA-256 옵션은 활성화되어 있습니다.
지우기	TPM 소유자 정보를 지우고 TPM을 기본 상태로 되돌릴 수 있습니다. 기본적으로 지우기 옵션은 비활성화되어 있습니다.
지우기 명령의 PPI 무시	TPM PPI(Physical Presence Interface)를 제어합니다. 기본적으로 지우기 명령의 PPI 무시 옵션은 비활성화되어 있습니다.
TPM State	TPM을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
인텔 소프트웨어 가드 확장	
Intel SGX	인텔 SGX(Software Guard Extensions)가 기본 운영 체제의 컨텍스트에서 코드 실행과 기밀 정보 저장을 위한 보안 환경을 제공할 수 있습니다. 기본적으로 소프트웨어 제어 옵션은 활성화되어 있습니다.
SMM Security Mitigation	SMM Security Mitigation을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
다음 부팅 시 데이터 지우기	
데이터 지우기 시작	다음 부팅 시 데이터 지우기를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
Absolute	Absolute Software에서 제공하는 Absolute Persistence Module 서비스(선택 사항)의 BIOS 모듈 인터페이스를 활성화, 비활성화 또는 영구적으로 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
UEFI 부팅 경로 보안	F12 부팅 메뉴에서 UEFI 부팅 디바이스로 부팅할 때 시스템의 사용자에게 대한 관리자 암호(설정된 경우) 입력 프롬프트 표시 여부를 제어합니다.

표 12. 시스템 설치 옵션—보안 메뉴 (계속)

보안	
기본적으로 항상 , 내부 HDD 제외 옵션은 활성화되어 있습니다.	

표 13. 시스템 설정 옵션 - 암호 메뉴

암호	
관리자 암호	관리자 암호를 설정, 변경 또는 삭제합니다.
시스템 암호	시스템 암호를 설정, 변경 또는 삭제합니다.
Internal HDD-1 Password	내부 HDD-1 암호를 설정, 변경 또는 삭제합니다.
NVMe SSD0	NVMe SSD0 암호를 설정, 변경 또는 삭제합니다.
암호 구성	
대문자	암호에 최소 1개의 대문자가 포함되도록 강화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
소문자	최소 1개의 소문자가 포함되도록 암호를 강화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
숫자	최소 1개의 숫자가 포함되도록 암호를 강화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
특수 문자	최소 1개의 특수 문자가 포함되도록 암호를 강화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
최소 문자	암호에 허용되는 최소 문자를 설정합니다.
암호 우회	활성화된 경우 꺼짐 상태에서 켜질 때 시스템 및 내부 하드 드라이브 암호를 입력 하라는 프롬프트가 매번 표시됩니다. 기본적으로 Disabled(사용 안 함) 옵션이 선택되어 있습니다.
암호 변경	
비관리자 암호 변경 활성화	관리자 암호 없이 시스템 및 하드 드라이브 암호를 변경하도록 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
Admin Setup Lockout	
Enable Admin Setup Lockout(관리자 설정 잠금 사용)	사용자의 BIOS 설정에 대한 액세스 가능 여부를 관리자가 제어할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
마스터 암호 잠금	
Enable Master Password Lockout(마스터 암호 잠금 활성화)	활성화 시 마스터 암호 지원이 비활성화됩니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
관리자 외 PSID 되돌리기(독립 비디오 카드가 탑재된 시스템만 해당)	
관리자 외 PSID 되돌리기 허용을 활성화합니다.	Dell Security Manager 프롬프트에서 NVMe 하드 드라이브의 PSID(Physical Security ID) 되돌리기에 대한 액세스를 제어합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.

표 14. 시스템 설정 옵션 - 업데이트, 복구 메뉴

업데이트, 복구	
UEFI 캡슐 펌웨어 업데이트	UEFI 캡슐 업데이트 패키지를 통한 BIOS 업데이트를 활성화 또는 비활성화합니다.

표 14. 시스템 설정 옵션 - 업데이트, 복구 메뉴 (계속)

업데이트, 복구	
하드 드라이브에서 BIOS 복구	이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 사용자가 사용자 기본 하드 드라이브 또는 외부 USB 키의 복구 파일을 통해 손상된 BIOS 조건을 복구할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
BIOS Downgrade BIOS 다운그레이드 허용	이전 개정으로의 시스템 펌웨어 플래시 차단을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
SupportAssist OS 복구 BIOSConnect	특정 시스템 오류가 있는 경우 SupportAssist OS 복구 툴에 대한 자동 부팅 흐름을 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 기본 운영 체제가 자동 운영 체제 복구 임계값 설정 옵션에 지정된 값을 초과하는 장애 횟수로 부팅에 실패하고 로컬 서비스 운영 체제가 부팅되지 않거나 설치되지 않은 경우 클라우드 서비스 운영 체제 복구를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Dell 자동 운영 체제 복구 임계값	SupportAssist 시스템 해결 콘솔 및 Dell 운영 체제 복구 툴에 대한 자동 부팅 흐름을 제어합니다. 기본적으로 임계값은 2로 설정됩니다.

표 15. 시스템 설정 옵션 - 시스템 관리 메뉴

시스템 관리	
서비스 태그	시스템의 서비스 태그를 표시합니다.
자산 태그	시스템 자산 태그를 생성합니다.
AC Behavior AC 연결 시 재개	AC 연결 시 절전 해제 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.
Wake on LAN Wake on LAN	WLAN에서 절전 해제 신호를 받을 때 특수 LAN 신호에 의해 시스템이 켜지는 것을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Disabled(사용 안 함) 옵션이 선택되어 있습니다.
Auto On Time	매일 또는 미리 선택한 날짜 및 시간에 시스템이 자동으로 켜지도록 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 Auto On Time(자동 켜짐 시간)이 매일, 평일 또는 선택한 요일에 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있습니다.

표 16. 시스템 설정 옵션 - 키보드 메뉴

키보드	
Numlock 옵션	기본적으로 Numlock 옵션은 활성화되어 있습니다.
Fn Lock Options	기본적으로 Fn 잠금 옵션은 활성화되어 있습니다.
잠금 모드	기본적으로 잠금 모드 보조는 활성화되어 있습니다.
키보드 조명	키보드 조명 설정을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 밝음 옵션이 활성화되어 있습니다.

표 16. 시스템 설정 옵션 - 키보드 메뉴 (계속)

키보드	
AC에서의 키보드 백라이트 시간 초과	AC 어댑터가 시스템에 연결되어 있는 경우의 키보드 백라이트의 시간 초과 값을 설정합니다. 기본적으로 1분 옵션이 활성화되어 있습니다.
배터리에서의 키보드 백라이트 시간 초과	배터리 전원으로만 작동 중인 경우의 키보드 백라이트의 시간 초과 값을 설정합니다. 기본적으로 1분 옵션이 활성화되어 있습니다.

표 17. 시스템 설정 옵션 - 사전 부팅 동작 메뉴

사전 부팅 동작	
어댑터 경고	
어댑터 경고 활성화	부팅 중 전원 용량이 적은 어댑터가 감지되는 경우의 경고 메시지를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Warning and Errors	경고 또는 오류가 발생한 경우 작업을 수행하거나 수행하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 경고 및 오류 시 프롬프트 옵션은 활성화되어 있습니다.
USB-C Warnings	
도크 경고 메시지 활성화	이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Fastboot	부팅 프로세스의 속도를 설정합니다. 기본적으로 전체 옵션은 활성화되어 있습니다.
BIOS POST 시간 연장	BIOS POST 시간을 설정합니다. 기본적으로 0초 옵션이 활성화되어 있습니다.
MAC 주소 Pass-Through	외부 NIC MAC 주소를 시스템에서 선택한 MAC 주소로 교체합니다. 기본적으로 시스템 고유 MAC 주소 옵션이 활성화되어 있습니다.

표 18. 시스템 설정 옵션 - 가상화 메뉴

가상화	
인텔 가상화 기술	
인텔 VT(Virtualization Technology) 활성화	VMM(Virtual Machine Monitor)이 인텔 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 사용할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
VT for Direct I/O	VMM(Virtual Machine Monitor)이 Direct I/O용 인텔 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 활용할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

표 19. 시스템 설치 옵션—성능 메뉴

성능	
멀티 코어 지원	
Active Cores	운영 체제에서 사용할 수 있는 CPU 코어의 수를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 모든 코어 옵션이 활성화되어 있습니다.
인텔 SpeedStep	
인텔 SpeedStep 기술 활성화	시스템이 프로세서 전압 및 코어 주파수를 동적으로 조정하여 평균 소비 전력 및 발열을 줄일 수 있습니다.

표 19. 시스템 설치 옵션—성능 메뉴 (계속)

성능	
	이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
C-States Control	
Enable C-State Control	추가 프로세서 절전 상태를 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
독립 그래픽에 대한 적응형 C 상태 활성화	독립 그래픽 사용을 활성화하거나 비활성화하고 더 높은 에너지 소비로 인해 AC 어댑터가 필요합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
인텔 TurboBoost 기술	
인텔 TurboBoost 기술 활성화	프로세서의 인텔 TurboBoost 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
인텔 하이퍼 스레딩 기술	
인텔 하이퍼 스레딩 기술 활성화	프로세서의 하이퍼 스레딩을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

표 20. 시스템 설치 옵션—시스템 로그 메뉴

시스템 로그	
BIOS 이벤트 로그	
BIOS 이벤트 로그 지우기	BIOS 이벤트를 표시합니다. 기본적으로 유지 옵션이 활성화되어 있습니다.
열 이벤트 로그	
열 이벤트 로그 지우기	열 이벤트를 표시합니다. 기본적으로 유지 옵션이 활성화되어 있습니다.
전원 이벤트 로그	
전원 이벤트 로그 지우기	전원 이벤트를 표시합니다. 기본적으로 유지 옵션이 활성화되어 있습니다.
라이선스 정보	시스템의 라이선스 정보를 표시합니다.

BIOS 업데이트

Windows에서 BIOS 업데이트

이 작업 정보

 **주의:** BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

단계

1. www.dell.com/support로 이동합니다.
2. 제품 지원을 클릭합니다. 지원 검색 상자에서 컴퓨터의 서비스 태그를 입력한 다음 검색을 클릭합니다.

 **노트:** 서비스 태그가 없는 경우 SupportAssist 기능을 사용하여 자동으로 컴퓨터를 식별합니다. 제품 ID를 사용하거나 컴퓨터 모델을 수동으로 찾아볼 수도 있습니다.

3. **Drivers & Downloads**(드라이버 및 다운로드)를 클릭합니다. **드라이버 찾기**를 확장합니다.
4. 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
5. **범주** 드롭다운 목록에서 **BIOS**를 선택합니다.
6. 최신 BIOS 버전을 선택하고 **다운로드**를 클릭하여 컴퓨터에 대한 BIOS 파일을 다운로드합니다.
7. 다운로드가 완료된 후 BIOS 업데이트 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
8. BIOS 업데이트 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.
자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 [000124211](#)을 참조하십시오.

Linux 및 Ubuntu에서 BIOS 업데이트

Linux 또는 Ubuntu가 설치되어 있는 컴퓨터에서 시스템 BIOS를 업데이트하려면 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 [000131486](#)을 참조하십시오.

Windows에서 USB 드라이브를 사용하여 BIOS 업데이트

이 작업 정보

 **주의:** BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

단계

1. [Windows에서 BIOS 업데이트](#)의 1~6단계 절차에 따라 최신 BIOS 설치 프로그램 파일을 다운로드합니다.
2. 부팅 가능한 USB 드라이브를 생성합니다. 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 [000145519](#)를 참조하십시오.
3. BIOS 설정 프로그램 파일을 부팅 가능한 USB 드라이브에 복사합니다.
4. 부팅 가능한 USB 드라이브를 BIOS 업데이트가 필요한 컴퓨터에 연결합니다.
5. 컴퓨터를 재시작하고 **F12** 키를 누릅니다.
6. **One Time Boot Menu**(원타임 부팅 메뉴)에서 USB 드라이브를 선택합니다.
7. BIOS 설정 프로그램 파일 이름을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
BIOS Update Utility(BIOS 업데이트 유틸리티)가 나타납니다.
8. 화면의 지침에 따라 BIOS 업데이트를 완료합니다.

F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS 업데이트

FAT32 USB 드라이브에 복사된 BIOS update.exe 파일로 시스템 BIOS를 업데이트하고 F12 원타임 부팅 메뉴에서 부팅합니다.

이 작업 정보

 **주의:** BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

BIOS 업데이트

부팅 가능한 USB 드라이브를 사용하여 Windows에서 BIOS 업데이트 파일을 실행하거나 컴퓨터의 F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS를 업데이트할 수도 있습니다.

2012년 이후에 제작된 Dell 컴퓨터는 대부분 이 기능을 가지고 있으며, F12 원타임 부팅 메뉴로 컴퓨터를 부팅해서 BIOS 플래시 업데이트가 컴퓨터의 부팅 옵션으로 등록되어 있는지 확인하는 방식으로 기능을 확인할 수 있습니다. 옵션이 등록되어 있다면 해당 BIOS는 이 BIOS 업데이트 옵션을 지원합니다.

 **노트:** F12 원타임 부팅 메뉴에 BIOS 플래시 업데이트 옵션이 있는 컴퓨터만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

원타임 부팅 메뉴에서 업데이트

F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS를 업데이트하려면 다음이 필요합니다.

- FAT32 파일 시스템으로 포맷된 USB 드라이브(키 자체가 부팅용일 필요는 없음)
- Dell 지원 웹사이트에서 다운로드하여 USB 드라이브의 루트에 복사한 BIOS 실행 파일
- 컴퓨터에 연결된 AC 전원 어댑터
- 정상 작동하는 BIOS 플래시용 컴퓨터 배터리

F12 메뉴에서 BIOS 업데이트 플래시 프로세스를 실행하려면 다음 단계를 수행합니다.

 **주의:** BIOS 업데이트가 진행 중일 때 컴퓨터의 전원을 끄지 마십시오. 컴퓨터를 끄면 컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 꺼진 상태에서 플래시를 복사한 USB 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다.
2. 컴퓨터의 전원을 켜고 F12 키를 눌러 원타임 부팅 메뉴에 액세스합니다. 마우스 또는 화살표 키를 사용하여 BIOS 업데이트를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
플래시 BIOS 메뉴가 표시됩니다.
3. **파일에서 플래시**를 클릭합니다.
4. 외부 USB 디바이스를 선택하십시오.
5. 파일을 선택하고 플래시 타겟 파일을 두 번 클릭한 다음 **제출**을 클릭합니다.
6. **BIOS 업데이트**를 클릭합니다. 컴퓨터가 재시작되며 BIOS를 플래시합니다.
7. BIOS 업데이트가 완료된 후에 컴퓨터가 재시작됩니다.

시스템 및 설정 암호

표 21. 시스템 및 설정 암호

암호 유형	설명
시스템 암호	시스템에 로그인하기 위해 입력해야 하는 암호입니다.
설정 암호	컴퓨터의 BIOS 설정에 액세스하고 변경하기 위해 입력해야 하는 암호.

컴퓨터 보안을 위해 시스템 및 설정 암호를 생성할 수 있습니다.

 **주의:** 암호 기능은 컴퓨터 데이터에 기본적인 수준의 보안을 제공합니다.

 **주의:** 컴퓨터가 잠겨 있지 않고 사용하지 않는 경우에는 컴퓨터에 저장된 데이터에 아무나 액세스할 수 있습니다.

 **노트:** 시스템 및 설정 암호 기능은 비활성화되어 있습니다.

시스템 설정 암호 할당

전제조건

설정 안 됨 상태일 때만 새 시스템 또는 관리자 암호를 할당할 수 있습니다.

이 작업 정보

시스템 설정에 들어가려면 전원이 켜진 직후 또는 재부팅 직후에 <F12> 키를 누릅니다.

단계

1. **System BIOS** 또는 **System Setup** 화면에서 **Security**를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
Security 화면이 표시됩니다.
2. **System/Admin Password**를 선택하고 **Enter the new password** 필드에서 암호를 생성합니다.

다음 지침을 따라 시스템 암호를 할당합니다.

- 암호 길이는 최대 32글자입니다.
- 암호에는 0부터 9까지의 숫자가 포함될 수 있습니다.
- 소문자만 유효하며 대문자는 유효하지 않습니다.
- 다음 특수 문자만 유효합니다: 공백, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (^).

3. **새 암호 확인** 필드에 입력했던 시스템 암호를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
4. <Esc> 키를 누르고 변경 사항을 저장하라는 프롬프트를 누릅니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 Y를 누릅니다.
컴퓨터가 다시 시작됩니다.

기존 시스템 설정 암호 삭제 또는 변경

전제조건

기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경하려 시도하기 전에 **Password Status**가 시스템 설정에서 Unlocked인지 확인합니다. 암호 상태가 잠금인 경우에는 기존 시스템 또는 설정 암호를 삭제하거나 변경할 수 없습니다.

이 작업 정보

시스템 설정에 들어가려면 전원이 켜진 직후 또는 재부팅 직후에 <F12> 키를 누릅니다.

단계

1. **System BIOS** 또는 **System Setup** 화면에서 **System Security**를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
System Security(시스템 보안) 화면이 표시됩니다.
2. **System Security**(시스템 보안) 화면에서 **Password Status(암호 상태)**를 **Unlocked(잠금 해제)**합니다.
3. **System Password**를 선택하고, 기존 시스템 암호를 업데이트하거나 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
4. **Setup Password**를 선택하고, 기존 설정 암호를 업데이트하거나 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
 **노트:** 시스템 및/또는 설정 암호를 변경하는 경우 프롬프트가 나타나면 새 암호를 다시 입력합니다. 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하는 경우 프롬프트가 나타나면 삭제를 확인합니다.
5. <Esc> 키를 누르면 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
6. 변경 내용을 저장하고 시스템 설정에서 나가려면 Y를 누릅니다.
컴퓨터가 다시 시작됩니다.

CMOS 설정 지우기

이 작업 정보

 **주의:** CMOS 설정 지우기를 통해 컴퓨터의 BIOS 설정을 재설정할 수 있습니다.

단계

1. **베이스 커버**를 제거합니다.
2. 시스템 보드에서 배터리 케이블을 분리합니다.
3. **코인 셀 배터리**를 제거합니다.
4. 1분간 기다립니다.
5. **코인 셀 배터리**를 장착합니다.
6. 배터리 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
7. **베이스 커버**를 장착합니다.

BIOS(시스템 설정) 및 시스템 암호 지우기

이 작업 정보

시스템 또는 BIOS 암호를 지우려면 www.dell.com/contactdell에 설명된 대로 Dell 기술 지원에 문의하십시오.

 **노트:** Windows 또는 애플리케이션 암호를 재설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Windows 또는 애플리케이션과 함께 제공되는 문서 자료를 참조하십시오.

문제 해결

부풀어 오른 리튬 이온 배터리 취급

대부분의 노트북 컴퓨터와 같이 Dell 노트북은 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 리튬 폴리머 배터리는 리튬 이온 폴리머 배터리의 한 유형입니다. 리튬 이온 폴리머 배터리는 슬림형 폼 팩터(특히 최신 울트라 씬 노트북 컴퓨터에 사용)와 긴 배터리 지속 시간 때문에 최근 들어 인기가 높아졌고 전자 업계에서 표준이 되었습니다. 리튬 이온 폴리머 배터리 기술에는 배터리 셀이 부풀어 오를 가능성이 있습니다.

부풀어 오른 배터리는 노트북 컴퓨터의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르면, 오작동이 발생할 수 있는 디바이스 인클로저 또는 내부 구성 요소의 추가 손상 가능성을 방지하기 위해 노트북 컴퓨터의 사용을 중단하고, AC 어댑터를 연결 해제하고 배터리를 방전합니다.

부풀어 오른 배터리는 사용하지 않아야 하고 적절하게 교체 및 폐기해야 합니다. Dell 승인 서비스 기술 지원 담당자가 수행하는 교체 옵션을 포함하여, 적용 가능한 보증 또는 서비스 계약의 약관에 따라 부풀어 오른 배터리를 교체하는 옵션에 대해 Dell 제품 지원에 문의하는 것이 좋습니다.

리튬 이온 배터리를 취급하고 교체하는 지침은 다음과 같습니다.

- 리튬 이온 배터리를 다룰 때는 주의하십시오.
- 배터리를 시스템에서 제거하기 전에 방전합니다. 배터리를 방전하려면 시스템에서 AC 어댑터를 뽑고 시스템을 배터리 전원으로만 작동합니다. 전원 버튼을 눌러도 시스템이 더 이상 켜지지 않으면 배터리가 완전히 방전된 것입니다.
- 배터리를 찌그러뜨리거나 떨어뜨리거나 훼손하거나 외부 개체로 배터리에 구멍을 뚫지 마십시오.
- 고온에 배터리를 노출하거나 배터리 팩과 셀을 분해하지 마십시오.
- 배터리 표면에 압력을 가하지 마십시오.
- 배터리를 구부리지 마십시오.
- 툴을 사용해 배터리를 꺼내려 하거나 배터리에 힘을 가하지 마십시오.
- 배터리가 부풀어 디바이스에서 분리되지 않을 경우, 위험할 수 있으니 배터리에 구멍을 뚫거나 배터리를 구부리거나 찌그러뜨려 분리하려고 하지 마십시오.
- 손상되거나 부풀어 오른 배터리를 노트북에 다시 조립하지 마십시오.
- 보증 대상에 포함되는 부풀어 오른 배터리는 (Dell에서 제공하는) 승인된 배송 컨테이너로 Dell에 반품해야 합니다. 이는 운송 규정을 준수하기 위한 것입니다. 보증 대상에 포함되지 않는 부풀어 오른 배터리는 승인된 재활용 센터에서 폐기해야 합니다. 지원 및 추가 지침이 필요하면 <https://www.dell.com/support>에서 Dell 제품 지원에 문의하십시오.
- Dell 제품이 아닌 배터리 또는 호환되지 않는 배터리를 사용하면 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다. 배터리를 교체할 때는 해당 Dell 컴퓨터에 사용하도록 제조된 Dell 호환 배터리만 사용하십시오. 타 컴퓨터 배터리를 본 컴퓨터에 사용하지 마십시오. 항상 <https://www.dell.com>에서 정품 배터리를 구입하거나 다른 방식으로 Dell의 제품을 직접 구입하십시오.

리튬 이온 배터리는 사용 기간, 충전 주기 수 또는 고열 노출과 같은 다양한 이유로 인해 부풀어 오를 수 있습니다. 노트북 배터리의 성능 및 수명을 향상하고 문제 발생 가능성을 최소화하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Dell 노트북 컴퓨터 배터리 - 자주 묻는 질문](#)을 참조하십시오.

Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단

이 작업 정보

SupportAssist 진단(시스템 진단이라고도 함)은 하드웨어 전체 검사를 수행합니다. Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단 진단은 BIOS에 내장되어 있으며 BIOS에 의해 내부적으로 시작됩니다. 내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 디바이스 그룹 또는 디바이스에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 디바이스에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 보냅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 보냅니다.

이 노트: 특정 디바이스를 위한 일부 테스트는 사용자 상호 작용을 요구합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 항상 컴퓨터 터미널 앞을 지켜야 합니다.

자세한 내용은 <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971>를 참조하십시오.

SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 실행

단계

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터가 부팅될 때 Dell 로고가 나타나면 F12 키를 누릅니다.
3. 부팅 메뉴 화면에서 **Diagnostics(진단)** 옵션을 선택합니다.
4. 왼쪽 하단의 화살표를 클릭합니다.
진단 전면 페이지가 표시됩니다.
5. 오른쪽 하단 모서리의 화살표를 클릭하여 페이지 목록으로 이동합니다.
감지된 항목이 나열됩니다.
6. 특정 디바이스에서만 진단 테스트를 실행하려면 Esc를 누른 다음 **Yes(예)**를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.
7. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 **Run Tests(테스트 실행)**을 클릭합니다.
8. 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.
오류 코드와 검증 번호를 메모해둔 후 Dell에 문의하십시오.

BIST(Built-in Self Test)

M-BIST

M-BIST(Built In Self-Test)는 시스템 보드 EC(Embedded Controller) 장애에 대한 진단 정확도를 향상시키는 시스템 보드 내장 자체 테스트 진단 툴입니다.

이 노트: M-BIST는 POST(Power On Self Test) 전에 수동으로 시작할 수 있습니다.

M- BIST 실행 방법

이 노트: M-BIST는 AC 전원에 연결되거나 배터리만 있는 전원 꺼짐 상태로 시스템에서 시작해야 합니다.

1. 키보드의 **M** 키와 **전원 버튼**을 모두 길게 눌러 M-BIST를 시작합니다.
2. **M** 키와 **전원 버튼**을 모두 누른 상태에서 배터리 표시등 LED가 2개의 상태를 표시할 수 있습니다.
 - a. 꺼짐: 시스템 보드에 오류가 감지되지 않음
 - b. 주황색: 시스템 보드에 문제가 있음을 나타냄
3. 시스템 보드에 장애가 있는 경우 배터리 상태 LED가 30초 동안 다음 오류 코드 중 하나를 표시합니다.

표 22. LED 오류 코드

깜박임 패턴		잠재적인 문제점
주황색	흰색	
2	1	CPU 오류
2	8	LCD 전원 레일 장애
1	1	TPM 탐지 장애
2	4	복구할 수 없는 SPI 장애

4. 시스템 보드에 장애가 없는 경우 LCD는 30초 동안 LCD-BIST 섹션에 설명된 단색 화면을 전환하여 표시한 후 전원이 꺼집니다.

LCD 전원 레일 테스트(L-BIST)

L-BIST는 단일 LED 오류 코드 진단에 대한 개선 사항이며 POST 중에 자동으로 시작됩니다. L-BIST에서 LCD 전원 레일을 확인합니다. LCD에 공급되는 전원이 없는 경우(즉, L-BIST 회로 실패 시) 배터리 상태 LED에서 오류 코드[2, 8] 또는 오류 코드[2, 7]를 표시합니다.

❗ | 노트: L-BIST가 실패하면 LCD에 공급되는 전원이 없으므로 LCD-BIST가 작동할 수 없습니다.

L-BIST 테스트 호출 방법:

- 전원 버튼을 눌러 시스템을 시작합니다.
- 시스템이 정상적으로 시작되지 않으면 배터리 상태 LED를 확인합니다.
 - 배터리 상태 LED가 오류 코드[2, 7]를 표시하는 경우 디스플레이 케이블이 제대로 연결되어 있지 않을 수 있습니다.
 - 배터리 상태 LED가 오류 코드 [2,8]을 깜박이는 경우 시스템 보드의 LCD 전원 레일에 장애가 발생하여 LCD에 전원이 공급되지 않습니다.
- 경우에 따라 [2, 7] 오류 코드가 표시되면 디스플레이 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 경우에 따라, [2, 8] 오류 코드가 표시되면 시스템 보드를 교체합니다.

LCD BIST(Built-in Self Test)

Dell 노트북 컴퓨터에는 발생한 화면 이상이 LCD(화면)에 내재된 문제인지 혹은 비디오 카드(GPU)와 PC 설정의 문제인지 확인하도록 돕는 내장형 진단 툴이 포함되어 있습니다.

깜박임, 왜곡, 선명도 문제, 흐릿하거나 희미한 이미지, 수평 또는 수직으로 나타나는 선, 색 바램 등의 화면 이상을 발견하면 항상 BIST(Built-in Self Test)를 실행해서 LCD를 격리하는 것이 좋습니다.

LCD BIST 호출 방법

- Dell 노트북 컴퓨터의 전원을 끕니다.
- 노트북 컴퓨터에 연결된 모든 주변 기기를 연결 해제합니다. AC 어댑터(충전기)만 노트북 컴퓨터에 연결합니다.
- LCD(화면)가 깨끗한지 확인합니다(화면 표면에 먼지 입자가 없음).
- D** 키를 누른 상태로 노트북 컴퓨터의 **전원을 켜** LCD BIST(Built-in Self Test) 모드에 들어갑니다. 시스템이 부팅될 때까지 D 키를 계속 누르고 있습니다.
- 화면에 단색이 표시되고 화면 전체가 흰색, 검은색, 빨간색, 녹색, 파란색으로 두 번씩 변합니다.
- 그런 다음 흰색, 검정색, 빨간색이 표시됩니다.
- 화면에 이상(모든 선, 흐릿한 색 또는 화면 왜곡)이 없는지 주의깊게 점검합니다.
- 마지막 단색(빨간색)에서 시스템이 종료됩니다.

❗ | 노트: Dell SupportAssist 사전 부팅 진단이 실행되면 사용자가 개입하여 LCD 기능을 확인할 것을 기다리며 LCD BIST를 먼저 시작합니다.

시스템 - 진단 표시등

표 23. 시스템 - 진단 표시등

깜박임 패턴		문제 설명	권장 조치사항
주황색	흰색		
1	1	TPM 탐지 장애	시스템 보드를 장착합니다.
1	2	복구할 수 없는 SPI 플래시 장애	시스템 보드를 장착합니다.
1	5	EC에서 i-Fuse 프로그래밍 불가	시스템 보드를 장착합니다.
1	6	비정상 EC 코드 흐름 오류에 대한 일반 범용	모든 전원(AC, 배터리, 코인 셀)을 연결 해제하고 전원 버튼을

표 23. 시스템 - 진단 표시등 (계속)

깜박임 패턴		문제 설명	권장 조치사항
주황색	흰색		
			3~5초 동안 눌러 잔류 전원을 방전시킵니다.
2	1	CPU 오류	- Dell Support Assist/Dell Diagnostics 툴을 실행합니다. - 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
2	2	시스템 보드 장애(BIOS 손상 또는 ROM 오류 등)	- 최신 BIOS 버전 플래시 - 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
2	3	메모리/RAM이 발견되지 않음	- 메모리 모듈이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. - 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합니다.
2	4	메모리/RAM 장애	- 메모리 모듈을 재설정하고 슬롯 간에 맞바꿉니다. - 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합니다.
2	5	잘못된 메모리 설치	- 메모리 모듈을 재설정하고 슬롯 간에 맞바꿉니다. - 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합니다.
2	6	시스템 보드/칩셋 오류	시스템 보드를 장착합니다.
2	7	LCD 장애(SBIOS 메시지)	LCD 모듈을 교체합니다.
2	8	LCD 장애(전원 레일 장애의 EC 감지)	시스템 보드를 장착합니다.
3	1	CMOS 배터리 오류	- 기본 배터리 연결을 재설정합니다. - 문제가 지속되면 기본 배터리를 교체합니다.
3	2	PCI 또는 비디오 카드/칩 장애	시스템 보드를 장착합니다.
3	3	BIOS 복구 이미지를 찾을 수 없음	- 최신 BIOS 버전 플래시 - 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
3	4	BIOS 복구 이미지를 찾았지만 유효하지 않음	- 최신 BIOS 버전 플래시 - 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
3	5	전원 레일 장애	시스템 보드를 장착합니다.
3	6	SBIOS에서 감지한 플래시 손상	- 전원 버튼을 25초 이상 눌러 RTC 재설정을 수행합니다. 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다. - 모든 전원(AC, 배터리, 코인 셀)을 연결 해제하고 전원 버튼을 3~5초 동안 눌러 잔류 전원을 방전시켜 모든 전

표 23. 시스템 - 진단 표시등 (계속)

깜박임 패턴		문제 설명	권장 조치사항
주황색	흰색		
			원이 방전되었는지 확인합니다. "BIOS recovery from USB"를 실행합니다. 지침은 Dell 지원 웹사이트를 참조하십시오. - 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
3	7	ME에서 HECI 메시지에 대한 회신을 기다리다 시간 초과되었습니다.	시스템 보드를 장착합니다.

노트: 잠금 LED(Caps-Lock 또는 Nums-Lock), 전원 버튼 LED(지문 인식기 없음), 진단 LED의 3-3-3 깜박임 LED는 Dell SupportAssist 사전 부팅 시스템 성능 검사 진단의 LCD 패널 테스트 중 입력 제공 실패를 나타냅니다.

운영 체제 복구

컴퓨터가 반복 시도 후에도 운영 체제로 부팅할 수 없는 경우, Dell SupportAssist OS 복구를 자동으로 시작합니다.

Dell SupportAssist OS Recovery는 Windows 운영 체제와 함께 설치되는 모든 Dell 컴퓨터에 사전 설치되어 있는 독립 실행형 툴입니다. 컴퓨터가 운영 체제로 부팅하기 전에 발생할 수 있는 문제를 진단하고 해결할 수 있는 툴로 구성됩니다. 이 툴을 통해 하드웨어 문제를 진단하거나, 컴퓨터를 수리하거나, 파일을 백업하거나, 출하 시 상태로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

소프트웨어 또는 하드웨어 장애로 인해 컴퓨터가 기본 운영 체제로 부팅할 수 없을 때 컴퓨터 문제를 해결하고 수정하기 위해 Dell Support 웹사이트에서 이 툴을 다운로드할 수도 있습니다.

Dell SupportAssist OS Recovery에 대한 자세한 내용은 *Dell SupportAssist OS Recovery 사용자 가이드*(www.dell.com/serviceabilitytools)를 참조하십시오. **SupportAssist**를 클릭한 후 **SupportAssist OS Recovery**를 클릭합니다.

실시간 클럭(RTC 재설정)

RTC(Real Time Clock) 재설정 기능을 사용하면 사용자 또는 서비스 기술 지원 담당자가 POST 없음/전원 없음/부팅 불가 상황에서 Dell Latitude 시스템을 복구할 수 있습니다. 이러한 모델에서 기존의 점퍼 활성화 RTC 재설정이 사용 중지되었습니다.

전원이 꺼져 있고 AC 전원에 연결되어 있는 시스템에서 RTC 재설정을 시작합니다. 전원 버튼을 30초간 길게 누릅니다. 시스템 RTC 리셋은 전원 버튼을 놓은 후에 발생합니다.

백업 미디어 및 복구 옵션

Windows에 발생할 수 있는 문제를 해결하고 수정하려면 복구 드라이브를 생성하는 것이 좋습니다. Dell은 사용자의 Dell PC에서 Windows 운영 체제를 복구하기 위해 여러 옵션을 제안합니다. 자세한 정보는 [Dell Windows 백업 미디어 및 복구 옵션](#)을 참조하십시오.

Wi-Fi 전원 주기

이 작업 정보

Wi-Fi 연결 문제로 인해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 Wi-Fi 전원 주기 절차를 수행할 수 있습니다. 다음 절차는 Wi-Fi 전원 주기를 수행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

노트: 일부 ISP(Internet Service Providers)는 모뎀/라우터 콤보 디바이스를 제공합니다.

단계

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 모뎀을 끕니다.
3. 무선 라우터를 끕니다.
4. 약 30초간 기다립니다.
5. 무선 라우터를 켵니다.
6. 모뎀을 켵니다.
7. 컴퓨터를 켵니다.

잔류 전원 방전(하드 리셋 수행)

이 작업 정보

잔류 전원은 전원을 끄고 배터리가 제거된 후에도 컴퓨터에 남아 있는 정전기입니다.

안전성을 위해 그리고 컴퓨터에서 중요한 전자 구성 요소를 보호하기 위해 컴퓨터의 구성 요소를 제거하거나 교체하기 전에 잔류 전원을 방전해야 합니다.

컴퓨터 전원을 켜지 않거나 운영 체제로 부팅하지 않는 경우에도 "하드 리셋" 수행이라고도 하는 잔류 전원 방전은 일반적인 문제 해결 단계이기도 합니다.

잔류 전원을 방전하려면(하드 리셋 수행)

단계

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 전원 어댑터를 컴퓨터에서 연결 해제합니다.
3. 베이스 커버를 제거합니다.
4. 배터리를 제거합니다.
5. 20초간 전원 버튼을 길게 눌러 잔류 전원을 방전시킵니다.
6. 배터리를 설치합니다.
7. 베이스 커버를 설치합니다.
8. 전원 어댑터를 컴퓨터에 연결합니다.
9. 컴퓨터를 켵니다.

 **노트:** 하드 리셋 수행에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000130881을 참조하십시오.

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

표 24. 자체 도움말 리소스

자체 도움말 리소스	리소스 위치
Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
My Dell 애플리케이션	
추가 정보	
지원 문의	Windows 검색에서 Contact Support를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows
비디오, 매뉴얼 및 문서를 통해 상위 솔루션, 진단, 드라이버 및 다운로드에 액세스하고 컴퓨터에 대해 자세히 알아봅니다.	Dell 컴퓨터는 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드로 고유하게 식별됩니다. Dell 컴퓨터에 대한 관련 지원 리소스를 보려면 www.dell.com/support 에서 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드를 입력합니다. 컴퓨터의 서비스 태그를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터의 서비스 태그 찾기 를 참조하십시오.
다양한 컴퓨터 우려 사항에 대한 Dell 기술 자료	1. www.dell.com/support로 이동합니다. 2. 지원 페이지 상단의 메뉴 표시줄에서 지원 > 기술 자료를 선택합니다. 3. 기술 자료 페이지의 검색 필드에 키워드, 항목 또는 모델 번호를 입력하고 검색 아이콘을 클릭 또는 탭하여 관련 문서를 봅니다.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.

① 노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 국가/지역에 제공되지 않을 수 있습니다.

① 노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.